



计算机维修技术精解

# 显卡维修 知识 精 解

迅维网 赵中秋 编著



电子工业出版社

Publishing House of Electronics Industry  
<http://www.phei.com.cn>



# 目 录

<b>第1章 显卡概述 .....</b>	<b>1</b>
<b>1.1 发展历程 .....</b>	<b>2</b>
1.1.1 CGA 显卡 .....	2
1.1.2 MGA/MCGA 显卡 .....	2
1.1.3 VGA 接口显卡 .....	3
1.1.4 3D AGP 接口显卡 .....	3
1.1.5 PCI Express 接口显卡 .....	5
1.1.6 nVIDIA 的崛起 .....	6
1.1.7 nVIDIA/ATI 上演铁面双雄 .....	7
<b>1.2 基本结构 .....</b>	<b>9</b>
1.2.1 GPU .....	10
1.2.2 显存 .....	11
1.2.3 BIOS .....	11
1.2.4 PCB .....	12
1.2.5 供电电路 .....	13
1.2.6 输出接口 .....	14
1.2.7 其他 .....	15
<b>1.3 产品分类 .....</b>	<b>16</b>
1.3.1 PCI 接口 .....	16
1.3.2 AGP 接口 .....	17
1.3.3 PCI Express 接口 .....	17
<b>1.4 主要参数 .....</b>	<b>20</b>
1.4.1 显示芯片 .....	20
1.4.2 显存 .....	23
1.4.3 显卡采用的技术 .....	26
<b>1.5 显卡品牌及 BIOS 下载 .....</b>	<b>28</b>
1.5.1 艾尔莎 .....	29
1.5.2 丽台 .....	30
1.5.3 耕升 .....	31
1.5.4 微星 .....	31



---

1.5.5 华硕	32
1.5.6 蓝宝石	33
1.5.7 迪兰恒进	33
1.5.8 七彩虹	34
1.5.9 影驰	35
1.5.10 讯景	35
结语	36
<b>第2章 显卡电路原理</b>	<b>37</b>
2.1 工作原理	38
2.2 供电电路	39
2.2.1 供电来源	39
2.2.2 供电方式	42
2.3 GPIO、显存电路	47
2.3.1 GPIO 定义	47
2.3.2 DDR 显存	49
2.3.3 DDR2 显存	51
2.3.4 DDR3 显存	53
2.4 BIOS 电路	55
2.5 接口电路	56
2.5.1 VGA 接口	57
2.5.2 DVI 接口	60
2.5.3 S 端子	62
2.5.4 RCA 接口	62
2.5.5 HDMI	62
2.6 其他电路	64
2.6.1 AGP 显卡识别电路	64
2.6.2 PCI-E 总线时钟复位电路	65
2.6.3 显卡晶振电路	66
2.6.4 散热风扇供电电路	66
<b>第3章 显卡维修工具和方法</b>	<b>67</b>
3.1 维修工具	68
3.1.1 热风枪	68
3.1.2 恒温烙铁	69
3.1.3 万用表	70
3.1.4 示波器	70
3.1.5 BGA 拆焊机	71
3.1.6 PCI 显卡	72
3.1.7 主板	72



3.1.8 硬盘	72
3.1.9 测试软件	73
3.2 维修方法	73
3.2.1 观察法	73
3.2.2 实测法	73
3.2.3 加焊法	75
3.2.4 比较替换法	75
3.3 无显示的检修	76
3.3.1 无显示的检修流程	76
3.3.2 供电部分的检修	76
3.3.3 时钟复位的检修	78
3.3.4 金手指信号线检修	79
3.3.5 巧用 BIOS 刷新程序	80
3.3.6 输出接口电路检修	81
3.4 花屏的检修	83
3.4.1 MATS 的使用	83
3.4.2 RxMEMID 的使用	85
3.4.3 显存数据位排列	90
3.4.4 花屏的检修思路	95
3.5 其他故障检修	96
3.5.1 nVIDIA 显卡降频	97
3.5.2 ATI 显卡降频	99
3.6 显卡 BIOS 刷写	101
3.6.1 ATI 显卡 BIOS 刷写	101
3.6.2 nVIDIA 显卡 BIOS 刷写	102
<b>第4章 焊接技巧</b>	<b>105</b>
4.1 电解电容焊接	106
4.2 PCB 断线修补	107
4.3 金手指修补	108
4.4 TSOP 封装的焊接	110
4.5 mBGA 封装的焊接	113
4.6 GPU 加焊	116
4.7 GPU 植株	119
<b>第5章 维修实例</b>	<b>125</b>
5.1 无显示故障的维修实例	126
5.1.1 显卡无供电故障	126
5.1.2 显卡不亮, 需刷 BIOS 解决的故障	128
5.1.3 7300PCI-E 显卡 GPU 损坏故障	131



---

5.1.4 七彩虹 GeForce 6500 显卡空焊故障 .....	136
5.1.5 影驰 8500GT 显卡空焊故障 .....	140
5.1.6 杂牌 GeForce7300 显卡无显示故障 .....	142
5.2 “花屏”故障的维修实例 .....	146
5.2.1 5200 显卡“小花”故障 .....	146
5.2.2 技嘉 6600 显卡空焊的“小花”故障 .....	150
5.2.3 9550 显卡花屏故障 .....	152
5.2.4 铭瑄 8500GT 显卡空焊故障 .....	156
5.2.5 微星 X550 显卡花屏故障 .....	158
5.2.6 讯景 7600GT 显卡空焊故障 .....	164

# 第 1 章 显卡概述

- 发展历程
- 基本结构
- 产品分类
- 主要参数
- 显卡品牌及 BIOS 下载
- 结语



显卡全称显示接口卡（英文为 Video Card 或 Graphics Card），又称显示适配器（Video Adapter），是个人电脑最基本的组成部分之一。

显卡的用途是将计算机系统所需要的显示信息进行转换驱动，并向显示器提供行扫描信号，控制显示器的正确显示。显卡是连接显示器和个人电脑主板的重要组件，是“人机对话”的重要设备之一。显卡作为计算机主机里的一个重要组成部分，承担输出显示图形的任务，对于喜欢玩游戏和从事专业图形设计的人来说显卡非常重要。目前，民用显卡图形芯片供应商主要包括 nVIDIA（其产品称 nVIDIA 显卡或 N 卡，其标志见图 1-1）和 AMD（ATi）（其产品称 ATi 显卡或 A 卡，其标志见图 1-2）两家。



图 1-1 nVIDIA 标志



图 1-2 ATI 标志

## 1.1 发展历程

### 1.1.1 CGA 显卡

民用显卡的起源可以追溯到 20 世纪 80 年代。在 1981 年，IBM 推出了个人电脑时，它提供了两种显卡，一种是“单色显卡”（简称 MDA），一种是“彩色绘图卡”（简称 CGA）。从名字上就可以看出，MDA 是与单色显示器配合使用的，它可以显示 80 行 x25 列的文数字；CGA 则可以用在 RGB 的显示屏上，它可以绘制的图形和文数字资料。在当时来讲，计算机的用途主要是文字数据处理，虽然 MDA 分辨率为宽 752 点、高 504 点，不足以满足多大的显示要求，不过对于文字数据处理还是绰绰有余的了。而 CGA 就具有彩色和图形能力，能胜任一般的显示图形数据的需要了，不过其分辨率只有 640×350，自然不能与现在的彩色显示同日而语。

### 1.1.2 MGA/MCGA 显卡

1982 年，IBM 又推出了 MGA（Monochrome Graphic Adapter），又称 Hercules Card（大力士卡），除了能显示图形外，还保留了原来 MDA 的功能。当年不少游戏都需要这款卡才能显示动画效果。而当时风行市场的还有 Genoa 公司做的 EGA（Enhanced Graphics Adapter），即加强型绘图卡，可以模拟 MDA 和 CGA，而且可以在单色屏幕上一点一点画



成图形。EGA 分辨率为  $640\times 350$ ，可以产生 16 色的图形和文字。不过这些显卡都是采用数字方式的，直到 MCGA（Multi-Color Graphics Array）的出现，才揭开了采用模拟方式的显卡的序幕。MCGA 是整合在 PS/2 Model 25 和 30 上的影像系统。它采用了模拟 RGB 影像信号，分辨率可高达  $640\times 480$ 。数字 RGB 和模拟 RGB 不同的地方就像是 ON-OFF 式切换和微调式切换之间的差别。用模拟 RGB 信号的显示屏，会将每一个信号的电压值转换成符合色彩明暗的范围。只有模拟显示屏可以和 MCGA 一起使用，才可以提供最多的 256 种颜色。另外，IBM 还提供了一个模拟单色显示屏，在此显示屏上可以显示出 64 种明暗度。

### 1.1.3 VGA 接口显卡

VGA（Video Graphic Array）即显示绘图阵列，它是 IBM 在其 PS/2 的 Model 50、60 和 80 内建的影像系统。它的数字模式可以达到  $720\times 400$  色，绘图模式则可以达到  $640\times 480\times 16$  色及  $320\times 200\times 256$  色，这是显卡首次可以同时最高显示 256 种色彩。而这些模式更成为其后所有显卡的共同标准。VGA 显卡的盛行把计算机带进了 2D 显卡显示的辉煌时代。在以后一段时期里，许多 VGA 显卡设计的公司不断推陈出新，追求更高的分辨率和位色。与此同时，IBM 推出了 8514/A 的 Monitor 显示屏规格，主要用来支持  $1024\times 768$  的分辨率。

在 2D 时代向 3D 时代推进的过程中，有一款不能忽略的显卡就是 Trident 8900/9000 显卡，它第一次使显卡成为一个独立的配件出现在计算机里，而不再是集成的一块芯片。而后其推出的 Trident 9685 更是第一代 3D 显卡的代表。不过真正称得上开启 3D 显卡大门的却应该是 GLINT 300SX，虽然其 3D 功能极其简单，但却具有里程碑的意义。

### 1.1.4 3D AGP 接口显卡

时间推移到 1995 年，对于显卡来说，绝对是里程碑的一年，3D 图形加速卡正式走入玩家的视野。那个时候游戏刚刚步入 3D 时代，大量 3D 游戏的出现，也迫使显卡发展为真正的 3D 加速卡。而这一年也成就了一家公司，它就是 3Dfx。1995 年，3Dfx 还是一家小公司，不过作为一家老资格的 3D 技术公司，它推出了业界的第一块真正意义的 3D 图形加速卡——VooDoo。在当时最为流行的游戏摩托英豪里，VooDoo 在速度及色彩方面的表现都让喜欢游戏的用户为之疯狂，不少游戏狂热分子都有过拿一千多元到计算机城买上一块杂牌的 VooDoo 显卡的经历。3Dfx 的专利技术 Glide 引擎接口一度称霸了整个 3D 世界，直至 D3D 和 OpenGL 的出现才改变了这种局面。VooDoo 标配为 4MB 显存，能够提供在  $640\times 480$  分辨率下 3D 显示速度和最华丽的画面。当然，VooDoo 也有硬伤，它只是一块具有 3D 加速功能的子卡，使用时需搭配一块具有 2D 功能的显卡，相信不少老 EDO 资格的玩家都还记得 S3 765+ VooDoo 这个为人津津乐道的黄金组合。讲到 S3 765，就不得不提到昔日王者 S3 显卡了。

S3 765 显卡是当时兼容机的标准配置，最高支持 2MB EDO 显存，能够实现高分辨率显示，这在当时属于高端显卡的功效，这一芯片真正将 SVGA 发扬光大。能够支持  $1024\times 768$  的分辨率，并且在低分辨率下支持最高 32 位真彩色，而且性价比也较强。因此，S3 765 实际上为 S3 显卡带来了第一次的辉煌。



而后在 1996 年又推出了 S3 Virge，它是一块融合了 3D 加速的显卡，支持 DirectX，并包含许多先进的 3D 加速功能，如 Z-buffering、Doubling buffering、Shading、Atmospheric effect、Lighting，实际成为 3D 显卡的开路先锋，成就了 S3 显卡的第二次辉煌。可惜后来在 3Dfx 的追赶下，S3 的 Virge 系列没有再继辉煌，最终被市场抛弃。

此后，为了修复 VooDoo 没有 2D 显示这个硬伤，3Dfx 继而推出了 VooDooRush，在其中加入了 Z-Buffer 技术。可惜相对于 VooDoo，VooDooRush 的 3D 性能却没有任何提升，更可怕的是带来不少兼容性的问题，而且价格居高不下的因素也制约了 VooDooRush 显卡的推广。

当然，当时的 3D 图形加速卡市场也不是 3Dfx 一手遮天，高高在上的价格给其他厂商留下了不少生存空间，像堪称当时性价比之王的 Trident 9750/9850，以及提供了 MPEG-II 硬件解码技术的 SiS6326，还有在显卡发展史上第一次出场的 nVIDIA 推出的 Riva128/128zx，都得到不少玩家的宠爱，这也促进了显卡技术的发展和市场的成熟。1997 年是 3D 显卡初露头脚的一年，而 1998 年则是 3D 显卡如雨后春笋激烈竞争的一年。1998 年的 3D 游戏市场风起云涌，大量更加精美的 3D 游戏集体上市，从而让用户和广商都期待出现更快更强的显卡。

在 VooDoo 带来的巨大荣誉和耀眼的光环下，3Dfx 以高屋建瓴之势推出了又一划时代的产品——VooDoo2。VooDoo2 自带 8MB/12MB EDO 显存，PCI 接口，卡上有双芯片，可以实现单周期多纹理运算。当然 VooDoo2 也有缺点，它的卡身很长，并且芯片发热量非常大，也是一个烦恼，而且 VooDoo2 依然作为一块 3D 加速子卡，需要一块 2D 显卡的支持。但是不可否认，VooDoo2 的推出已经使得 3D 加速又到达了一个新的里程碑，凭借 VooDoo2 的效果、画面和速度，征服了不少当时盛行一时的 3D 游戏，如 Fifa98、NBA98、Quake2 等。也许不少用户还不知道，最为流行的 SLI 技术也是当时 VooDoo2 的一个新技术，VooDoo2 第一次支持双显卡技术，让两块 VooDoo2 并联协同工作获得双倍的性能。

1998 年虽然是 VooDoo2 大放异彩的一年，但其他厂商也有一些经典之作。Matrox MGA G200 在继承了自己超一流的 2D 水准以外，3D 方面有了革命性的提高，不但可以提供与 VooDoo2 差不多的处理速度和特技效果，另外还支持 DVD 硬解码和视频输出，并且独一无二地首创了 128 位独立双重总线技术，大大提高了性能。配合当时相当走红的 AGP 总线技术，G200 也赢得了不少用户的喜爱。

Intel 的 I740 是搭配 Intel 当时的 440BX 芯片组推出的，它支持 AGP 2X 技术，标配 8MB 显存，可惜 I740 的性能并不好，2D 性能只能和 S3 Virge 看齐，而 3D 方面也只有 Riva128 的水平，不过价格方面就有明显优势，让它在低端市场站住了脚。

Riva TNT 是 nVIDIA 推出的意在阻击 VooDoo2 的产品，它标配 16MB 的大显存，完全支持 AGP 技术，首次支持 32 位色彩渲染，还有快于 VooDoo2 的 D3D 性能和低于 VooDoo2 的价格，让其成为不少玩家的新宠。而一直在苹果电脑世界闯荡的 ATI 也出品了一款名为 Rage Pro 的显卡，速度比 VooDoo 稍快。

而 1998 年的一个悲剧英雄是来自王者 S3 的野人系列 Savage 系列显卡。Savage3D 采用 128 位总线结构及单周期三线性多重贴图技术，最大像素填充率达到了 125MPixel/s，三角形



生成速率也达到了每秒 500 万个。通过 S3 新设计的 AGP 引擎和 S3TC 纹理压缩技术，支持 Direct3D 与 OpenGL，最大显存容量可达 8MB SGRAM 或 SDRAM，支持 AGP 4X 规范。同时也支持当时流行的如反射和散射、Alpha 混合、多重纹理、衬底纹理、边缘抗锯齿、16/24 位 Z-buffering、Tri-linear Filtering（三线性过滤技术）、S3TC 纹理压缩技术等技术。可惜就是受到驱动程序不兼容的严重影响，最终在 1999 年时惨淡收场。



## 小知识

MPixel/s 是像素单位，指兆像素/秒。

2000 年 8 月，Intel 推出 AGP 3.0 规范，工作电压降到 0.8V，并增加了 8X 模式，这样它的数据传输带宽达到了 2133MB/s，数据传输能力相对于 AGP 4X 成倍增长，能较好地满足当前显示设备的带宽需求。其发展已经经历了 AGP 1X、AGP 2X、AGP 4X、AGP 8X 几个阶段。

AGP 是当前已经淘汰的图形系统接口。

### 1.1.5 PCI Express 接口显卡

PCI Express 总线是为将来的计算机和通信平台定义的一种高性能通用 I/O 互连总线。

在 2001 年春季的 IDF 上，Intel 正式公布了 PCI Express 标准，是取代 PCI 总线的第三代 I/O 技术，也称为 3GIO。该总线的规范由 Intel 支持的 AWG (Arapahoe Working Group) 负责制定。2002 年 4 月 17 日，AWG 正式宣布 3GIO 1.0 规范草稿制定完毕，并移交 PCI-SIG 进行审核。受到串行 ATA 的影响，开始的时候大家都以为它会被命名为 Serial PCI，但最后却被正式命名为 PCI Express。2006 年正式推出 Spec 2.0 (2.0 规范)。

PCI Express 总线技术的演进过程，实际上是计算系统 I/O 接口速率演进的过程。PCI 总线是一种 33MHz@32bit 或者 66MHz@64bit 的并行总线，总线带宽为 133~533MB/s，连接在 PCI 总线上的所有设备共享 133~533MB/s 带宽。这种总线用来应付声卡、10/100Mb/s 网卡及 USB 1.1 等接口基本不成问题。随着计算机和通信技术的进一步发展，新一代的 I/O 接口大量涌现，如千兆位 (GE) 和万兆位 (10GE) 以太网技术、4Gb/8Gb 的 FC 技术，使得 PCI 总线的带宽已经无力应付计算系统内部大量高带宽并行读/写的要求，PCI 总线也成为系统性能提升的瓶颈，于是就出现了 PCI Express (简称 PCI-E) 总线。PCI Express 总线技术在当今新一代的存储系统中得到已经普遍的应用。PCI Express 总线能够提供极高的带宽，来满足系统的需求。

目前，PCI Express 3.0 规范也已经确定，其编码数据速率，比同等情况下 PCI Express 2.0 规范提高了一倍，32X 端口的双向速率高达 320Gb/s。

#### 1. PCI 总线的缺点

PCI 总线的最大优点是总线结构简单、成本低、设计简单，但是缺点也比较明显：

(1) 并行总线无法连接太多设备，总线扩展性比较差，线间干扰将导致系统无法正常工作；



- (2) 当连接多个设备时，总线有效带宽将大幅降低，传输速率变慢；  
 (3) 为了降低成本和尽可能减少相互间的干扰，需要减少总线带宽，或者地址总线和数据总线采用复用方式设计，这样降低了带宽利用率。

## 2. PCI Express 相比 PCI 的技术优势

(1) PCI Express 总线是串行总线，进行点对点传输，每个传输通道独享带宽。

(2) PCI Express 总线支持双向传输模式和数据分信道传输模式。其中的数据分信道传输模式即 PCI Express 总线的 1X、2X、4X、8X、12X、16X 和 32X 多通道连接。1X 单向传输带宽即可达到 250MB/s，双向传输带宽更能够达到 500MB/s，这已经不是普通 PCI 总线所能相比的了。

(3) PCI Express 总线充分利用先进的点到点互连、基于交换的技术、基于包的协议来实现新的总线性能和特征。电源管理、服务质量 (QoS)、热插拔支持、数据完整性、错误处理机制等也是 PCI Express 总线所支持的高级特性。

(4) 与 PCI 总线良好的继承性，可以保持软件的继承和可靠性。PCI Express 总线关键的 PCI 特征，如应用模型、存储结构、软件接口等与传统 PCI 总线保持一致，但是并行的 PCI 总线被一种具有高度扩展性的、完全串行的总线所替代。

(5) PCI Express 总线充分利用先进的点到点互连，降低了系统硬件平台设计的复杂性和难度，从而大大降低了系统的开发制造设计成本，极大地提高系统的性价比和健壮性。系统总线带宽提高同时，减少了硬件脚位的数量，硬件的成本直接下降。

PCI-E 接口是目前显卡的主流接口。

### 1.1.6 nVIDIA 的崛起

1999 年，20 世纪末的显卡市场出现了百花齐开的局面，而且这一年也让市场摆脱了 3Dfx 的一家独霸局面。由于战略的失误，让 3Dfx 失去了市场。3Dfx 推出了 VooDoo3，配备了 16MB 显存，支持 16 色渲染。虽然在画质上无可挑剔，但是高昂的价格及与市场格格不入的标准让它难掩颓势。20 世纪末的这一年，显卡的辉煌留给了 nVIDIA。

在 1999 年，nVIDIA 挟 TNT 的全威推出 TNT2 Ultra、TNT2 和 TNT2 M64 三个版本的芯片，后来又有 Pro 和 VANTA 两个版本。这种分类方式也促使后来各个生产厂家对同一芯片进行高、中、低端的划分，以满足不同层次的消费需求。TNT 系列配备了 8~32MB 的显存，支持 AGP 2X/4X，支持 32 位渲染等众多技术，虽然 16 位色下画面大大逊色于 VooDoo3，但是在 32 位色下，表现却可圈可点；另外，在 16 位色下，TNT2 的性能已经略微超过 VooDoo3 了。不过客观地说，在 32 位色下，TNT 系列显卡性能损失相当多，速度上跟不上 VooDoo3 了。当然，nVIDIA 能战胜 VooDoo3，与 3Dfx 公司推行的策略迫使许多厂商投奔 nVIDIA 也不无关系，促进了 TNT 系列的推广。显卡市场上出现了 nVIDIA 与 3Dfx 两家争霸的局面。

1999 年的显卡市场不可遗忘的产品还有 Matrox MGA G400，它拥有 16MB/32MB 的显存容量，支持 AGP 2X/4X，还支持大纹理及 32 位渲染等，都是当时业界非常流行和肯定的技术，除此之外，独特、漂亮的 EMBM 硬件凹凸贴图技术，营造出的完美凹凸感并能实现



动态光影效果的技术确实让无数游戏玩家为其疯狂。在 3D 方面，其速度和画面基本都是介于 VooDoo3 和 TNT2 之间，并且 G400 拥有优秀的 DVD 回放能力，不过由于价格及它注重于 OEM 和专业市场，因此，在民用显卡市场所占的比例并不大。

从 1999 年到 2000 年，nVIDIA 终于爆发了。它在 1999 年年末推出了一款革命性的显卡——GeForce 256，彻底打败了 3Dfx。代号 NV10 的 GeForce 256 支持 Cube-Environment Mapping，完全的硬件 T&L (Transform & Lighting)，把原来由 CPU 计算的数据直接交给显示芯片处理，大大解放了 CPU，也提高了芯片的使用效率。GeForce 256 拥有 4 条图形纹理信道，单周期每条信道处理两个像素纹理，工作频率 120MHz，全速可以达到 480MPixel/s，支持 SDRAM 和 DDR RAM，使用 DDR 的产品能更好地发挥 GeForce 256 的性能。其不足之处就在于采用了 0.22μm 的工艺技术，发热量比较高。

2000 年，nVIDIA 开发出了第五代的 3D 图形加速卡——GeForce2，采用了 0.18μm 的工艺技术，不仅大大降低了发热量，而且使得 GeForce2 的工作频率可以提高到 200MHz。GeForce2 拥有四条图形纹理信道，单周期每条信道处理两个像素纹理，并且使用 DDR RAM 解决显存带宽不足的问题。在 GeForce 256 的基础上，GeForce2 还拥有的 NSR (nVIDIA Shading Rasterizer)，支持 Per-Pixel Shading 技术，同时支持 S3TC、FSAA、Dot-3 Bump Mapping 及硬件 MPEG-2 动态补偿功能，完全支持微软的 DirectX 7。而面对不同的市场分级，它相继推出了低端的 GeForce2 MX 系列及面向高端市场的 GeForce2 Pro 和 GeForce GTS，全线的产品线让 nVIDIA 当之无愧地成为显卡的霸主。

3Dfx 在被 nVIDIA 收购之前还推出了 VooDoo4/5，VooDoo4 4500 使用一颗 VSA-100 芯片，VooDoo5 5500 使用两颗 VSA-100 芯片，而 VooDoo5 6000 使用四颗 VSA-100 芯片。可惜由于各方面的原因，VooDoo4/5 并不能让没落的 3Dfx 有一丝起色，最终难逃被 nVIDIA 收购的命运。

而现在作为 nVIDIA 主要竞争对手的 ATI，也在 2000 年凭借 T&L 技术打开市场。在经历“曙光女神”的失败后，ATI 也推出了自己的 T&L 芯片 Radeon 256。Radeon 也和 nVIDIA 一样具有高低端的版本，完全硬件 T&L，Dot3 和环境映射凹凸贴图，还有两条纹理流水线，可以同时处理三种纹理。但最出彩的是 Hyper-Z 技术，大大提高了 Radeon 显卡的 3D 速度，拉近了与 GeForce2 系列的距离，ATI 的显卡也开始在市场占据主导地位。

2000 年的低端市场还有来自 Trident 的 Blade T64 和 Blade XP。Blade XP 核心属于 Trident 第一款 256 位的绘图处理器，采用 0.18μm 的制造工艺，核心时钟频率为 200MHz，像素填充率达到 1.6GPixel/s，与 GeForce2 GTS 处于同一等级，支持 DirectX7.0 等。可惜由于驱动程序及性能等方面的原因，这两款显卡并没有得到用户的支持。

### 1.1.7 nVIDIA/ATI 上演铁面双雄

踏入 2001 年以后，如同桌面处理器市场的 Intel 和 AMD 一样，显卡市场演变为 nVIDIA 与 ATI 两雄争霸的局势。nVIDIA 方面，凭借刚刚推出的 GeForce3 系列占据了不小市场，GeForce3 Ti 500、GeForce2 Ti 和 GeForce3 Ti、GeForce MX 分别定位于高、中、低三线市场。与 GeForce2 系列显卡相比，GeForce3 显卡最主要的改进之处就是增加了可编程 T&L 功能，能够对几乎所有的画面效果提供硬件支持。GeForce3 总共具有 4 条像素管道，



填充速率最高可以达到 800MPixel/s。GeForce3 系列还拥有 nfiniteFX 顶点处理器、nfiniteFX 像素处理器及 Quincunx 抗锯齿系统等技术。

而作为与之相抗衡的 ATI Radeon 8500/7500 系列，采用 0.15μm 工艺制造，包括 6000 万只晶体管，采用了不少新技术（如 Truform、Smartshader 等）。并根据显卡的核心/显存工作频率分成不同的档次——核心/显存分别为 275/550MHz 的标准版，核心/显存分别为 250/500MHz 的 Radeon 8500LE，生产核心/显存频率分别为 300/600MHz 的 Ultra 版，以及中端的 Radeon 7500，低端的 Radeon 7200、Radeon 7000 等产品。值得一提的是，Radeon 8500 还支持双显示技术。

2002 年，nVIDIA 与 ATI 的竞争更加白热化。为巩固其图形芯片市场霸主地位，nVIDIA 推出了 GeForce4 系列，分别为 GeForce4 Ti 4800、GeForce4 Ti 4600、GeForce4 Ti 4400、GeForce4 Ti 4200、GeForce4 MX 460、GeForce4 MX 440 和 GeForce4 MX 420。GeForce4 Ti 系列无疑是具性价比的，其代号是 NV25，它主要针对当时的高端图形市场，是 DirectX 8 时代下最强劲的 GPU 图形处理器。芯片内部包含的晶体管数量高达 6 千 3 百万只，使用 0.15μm 工艺生产，采用了新的 PBGA 封装，运行频率达到了 300MHz，配合频率为 650MHz DDR 显存，可以实现每秒 49 亿次的采样。GeForce4 Ti 核心内建 4 条渲染流水线，每条流水线包含两个 TMU（材质贴图单元）。GeForce4 系列从高到低，横扫了整个显卡市场。

作为反击，ATI 出品了 Radeon 9700/9000/9500 系列，首次支持 DirectX 9，使其在与 nVIDIA 的竞争中抢得先机。而 Radeon 9700 更是在速度与性能方面首次超越 nVIDIA。Radeon 9700 支持 AGP 8X、DirectX 9，核心频率是 300MHz，显存时钟是 550MHz。Radeon 9700，实现了可程序化的革命性硬件架构。AGP 8X 最新标准符合绘图要求，配有 8 个平等处理的彩绘管线，每秒可处理 25 亿像素，4 个并列的几何处理引擎更能处理每秒 3 亿个形迹及光效多边形。而 Radeon 9000 是面向低端的产品，Radeon 9500 则直挑 GeForce4 Ti 4200。

同年，SiS 发布了 Xabre 系列。它是第一款 AGP 8X 显卡，全面支持 DirectX 8.1，在发布之时是相当抢眼的。Xabre 系列图形芯片采用 0.15μm 工艺，具备 4 条像素渲染流水线，并且每条流水线拥有两个贴图单元。理论上可提供高达 1200MPixel/s 的像素填充率和 2400MTexel/s 的材质填充率。随后发布的 Xabre600，采用 0.13μm 工艺，主频和显存频率都提高了不少，性能与 GeForce4 Ti 4200 差不多。

2003 年的显卡市场依旧为 N 系与 A 系所统治。nVIDIA 的 GeForce FX 5800 (NV30) 系列拥有 32 位着色，颜色画面有质的提高。在其基础上推出的 GeForce FX 5900，提高了晶体管数，降低了核心频率与显存频率，改用了 256B99v DDR 以提高了显存带宽。后半年还推出了 GeForce FX 5950/5700 系列，以取代 GeForce FX 5900/5600。而 ATI 推出了 Radeon 9800/Pro/SE/XT，凭借其超强的性能及较低的售价，再次打败 GeForce GX 5800。这一年市场上的主流产品还有 GeForce FX 5600、GeForce FX 5200 和 Radeon 9600 和 Radeon 9200。

2004 年也是 ATI 大放异彩的一年，不过其最大的功臣却是来自于面向中低端的 Radeon 9550。这款 2004 年最具性价比的显卡，让 ATI 在低端市场呼风唤雨。Radeon 9550 基于 RV350 核心，采用 0.13μm 工艺，核心频率为 250MHz，显存频率为 400MHz，4 条渲染管



道，1个纹理单元，同时兼容64位和128位。这款产品是9600的降频版，但是通过改造，都可以变成Radeon 9600，性价比极强。而老对手的nVIDIA显卡方面，却只推出了一款新品GeForce FX 5900 XT/SE，而与Radeon 9550处于同一竞争线的5200、5500与5700LE系列，虽然性能不错，可惜价格却没有优势，被Radeon 9550彻底打败。2004年让nVIDIA郁闷了一整年。

ATI从2005年开始就一直被nVIDIA压制。无论是1950XTX对抗7900GTX，2900XT对抗8800GTX，3870X2对抗9800GX2，在旗舰产品上，ATI一直属于劣势，但在2008年6月发生了转机。ATI发布了RV770，无论是从市场定价还是从性能上都是十分让人满意的，RV770的中端产品4850的价格更是让nVIDIA措手不及，无奈在一周内9800GTX降价1000元，但无论是性能还是价格依旧挡不住4850的攻势。4870紧接着发布了采用DDR5显存的RV770，其浮点运算能力更是达到了1TB/s。nVIDIA发布的新核心GT200的旗舰版本GTX280虽然在性能上暂时取得了暂时的领先，但是和4870相比只有10%的性能差距，而且由于工艺较落后，导致成本过高，没有性价比。就在人们以为ATI放弃旗舰，准备走性价比路线时，ATI推出了R700，也就是4870X2，并且大幅度改良了桥接芯片的性能，领先GTX280高达50%~80%，而GTX280的核心面积已经太大了，不可能衍生出单卡双芯，所以ATI依靠单卡双芯重新夺得了性能之王。但是在2009年年初，nVIDIA凭借其新推出的GTX295，重新夺回显卡性能之王宝座。GeForce GTX 295流处理器和纹理过滤单元的数量相当于GeForce GTX 280的翻番，光栅操作单元数量和显存配置则是两倍于GeForce GTX 260，而各种频率都和GeForce GTX 260保持一致，这显然是出于控制功耗的考虑。如果能换用水冷等更强劲的散热器，肯定还会有不小的超频空间。

## 1.2 基本结构

显卡主要的组成部分有GPU（在散热片下面）、显存、BIOS、PCB、供电电路、输出接口、散热片和散热风扇、晶振等，如图1-3所示。

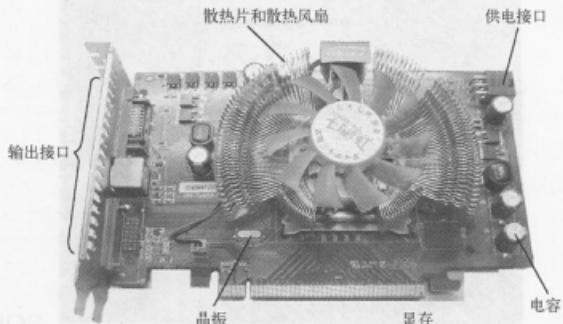


图1-3 显卡基本结构



### 1.2.1 GPU

Graphic Processing Unit 简称 GPU，中文翻译为“图形处理器”。nVIDIA 公司在发布 GeForce 256 图形处理芯片时首先提出该概念。GPU 使显卡降低了对 CPU 的依赖，并承担部分原本 CPU 的工作，尤其是在 3D 图形处理时。GPU 所采用的核心技术有硬件 T&L（几何转换和光照处理）、立方环境材质贴图和顶点混合、纹理压缩和凹凸映射贴图、双重纹理四像素 256 位渲染引擎等，而硬件 T&L 技术可以说是 GPU 的标志。GPU 主要由 nVIDIA（见图 1-4）与 ATI（见图 1-5）两家厂商生产。



图 1-4 nVIDIA 芯片



图 1-5 ATI 芯片



### 1.2.2 显存

显存是显示内存的简称。顾名思义，其主要功能就是暂时存储显示芯片要处理的数据和处理完毕的数据。图形核心的性能越强，需要的显存也就越大。以前的显存主要是 SDR 的，容量也不大。而现在市面上基本采用的都是 DDR3 规格的，在某些高端卡上更是采用了性能更为出色的 DDR4 或 DDR5 内存。显存主要有三星（SAMSUNG）、海力士（Hynix）、奇梦达（Qimonda）等品牌。显存的封装形式主要有 MBGA 封装（见图 1-6）和 TSOP 封装（见图 1-7）。

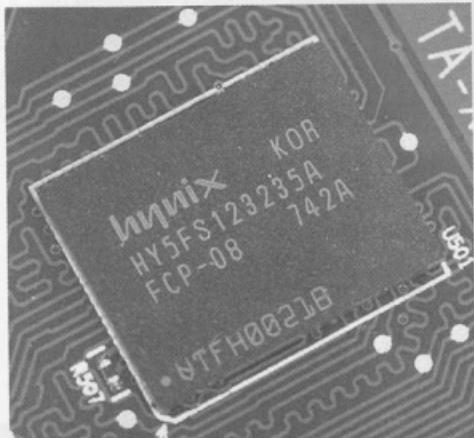


图 1-6 MBGA 封装的显存



图 1-7 TSOP 封装的显存

### 1.2.3 BIOS

BIOS 是 Basic Input Output System 的简称，也就是“基本输入/输出系统”。



显卡 BIOS 主要用于存放显示芯片与驱动程序之间的控制程序，另外还保存显卡的型号、规格、生产厂家及出厂时间等信息。打开计算机时，通过显卡 BIOS 内的一段控制程序，将这些信息反馈到屏幕上。早期显卡 BIOS 是固化在 ROM 中的，不可以修改，后来采用 PLCC32 封装的 Flash ROM（见图 1-8）。而现在的多数显卡则采用了大容量的 EEPROM，即所谓的 Flash BIOS，可以通过专用的程序进行改写或升级。在显卡上一般为 25 开头的 8 脚芯片。ATMEL 公司的 25F512AN 采用 SPI 封装如图 1-9 所示。



图 1-8 PLCC32 封装的 BIOS

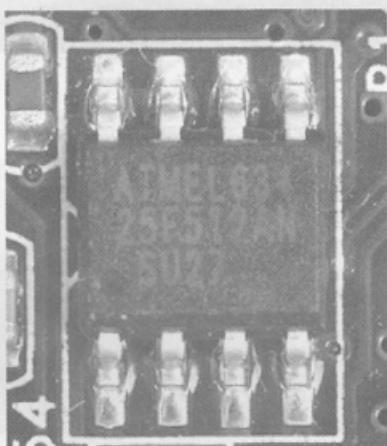


图 1-9 SPI 封装的 BIOS

#### 1.2.4 PCB

显卡 PCB 如图 1-10 所示。PCB 就是印制电路板（Printed Circuit Board）。它几乎会出现



在每一种电子设备当中。如果在某样设备中有电子零件，它们都是镶在大小各异的 PCB 上的。除了固定各种小零件外，PCB 的主要功能是提供其上各项零件的相互电气连接。随着电子设备越来越复杂，需要的零件自然越来越多，PCB 上头的线路与零件也越来越密集了。裸板（其上没有零件）也常被称为印制线路板（Printed Wiring Board, PWB）。板子本身的基本是由绝缘隔热、并不易弯曲的材质所制作成的。在表面可以看到的细小线路材料是铜箔，原本铜箔是覆盖在整个板子上的，而在制造过程中部分被蚀刻处理掉，留下来的部分就变成网状的细小线路了。这些线路被称做导线（conductor pattern）或布线，并用来提供 PCB 上零件的电路连接。通常 PCB 的颜色都是绿色或是红色，这是阻焊漆（solder mask）的颜色。阻焊漆是绝缘的防护层，可以保护铜线，也可以防止零件被焊到不正确的地方。在阻焊层上还会印刷上一层丝网印刷面（silk screen）。通常在这上面会印上文字与符号（大多是白色的），以标示出各零件在板子上的位置。丝网印刷面也被称做图标面（legend）。现在的显卡一般采用 6 层以上的 PCB 板，多层 PCB 板有更好的抗电磁稳定性。

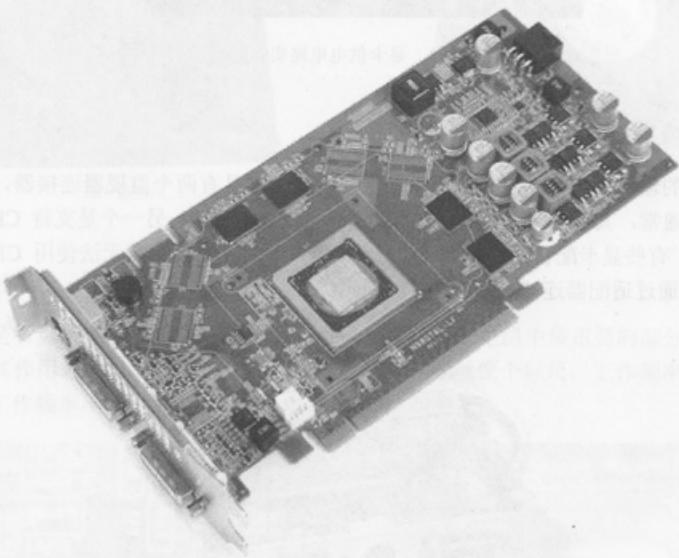


图 1-10 显卡 PCB

### 1.2.5 供电电路

显卡供电电路如图 1-11 所示，电力从插槽和外接电源头过来经电路转换给显卡提供能源。常见的供电方式有三种：三端稳压器、场效应管线性降压和 PWM 脉宽调制。

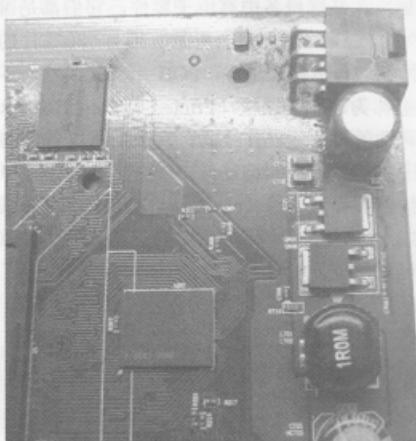


图 1-11 显卡供电电路实物图

### 1.2.6 输出接口

常用显卡的输出接口如图 1-12 所示。大多数显卡都具有两个监视器连接器，能够外接两个监视器。通常，其中一个是支持 LCD 屏幕的 DVI 连接器，另一个是支持 CRT 屏幕的 VGA 连接器。有些显卡配备的是两个 DVI 连接器，但这并不意味着无法使用 CRT 屏幕，CRT 屏幕可以通过适配器连接到 DVI 接口。

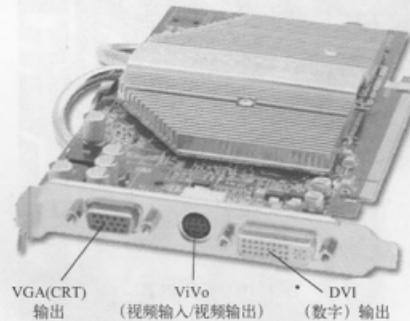


图 1-12 显卡的输出接口

大多数人仅使用显卡具有的两种监视器连接设备中的一种。需要使用两台监视器的用户可以购买具有双头输出功能的显卡，它能将画面分割并显示到两个屏幕上。理论上，如果计算机配有两块具有双头输出功能且提供 PCI-E 接口的显卡，则它能够支持四台监视器。

除了用于主板和监视器的连接器以外，有些显卡还具有用于以下用途的连接设备。



- (1) 电视显示：电视输出或 S-Video。
- (2) 模拟摄像机：ViVo（视频输入/视频输出）。
- (3) 数码相机：火线或 USB。
- (4) 有些显卡还自带了电视调谐器。

### 1.2.7 其他

#### 1. 散热片和散热风扇

有些显卡还带有散热片和散热风扇，如图 1-13 所示。

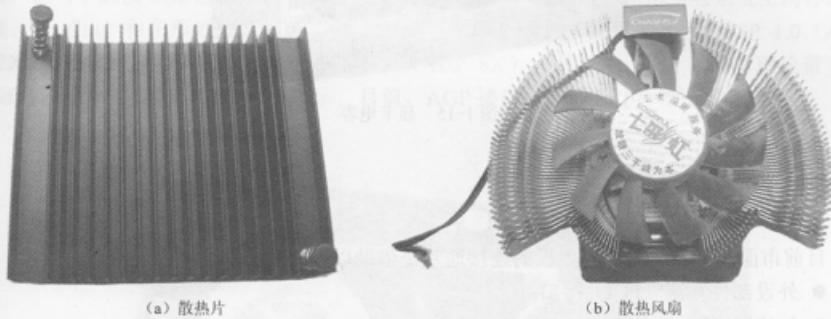


图 1-13 显卡的散热片和散热风扇

#### 2. 晶振

晶振是石英振荡器的简称，英文名为 Crystal，是时钟电路中最重要的部分。显卡晶振为 27MHz，其作用是向显卡的各部分提供基准频率。晶振就像个标尺，工作频率不稳定会造成相关设备工作频率不稳定。晶振如图 1-14 所示。

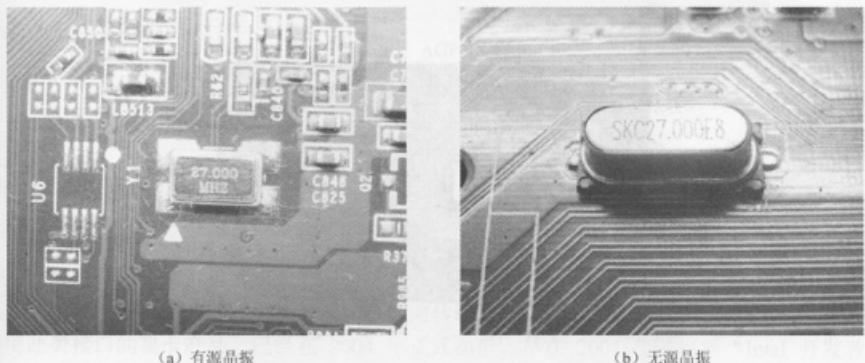


图 1-14 显卡晶振



### 3. 电容

图 1-15 中直立的两个零件是显卡的电容。电容对显卡主要起滤波和稳定电流的作用，只有在保证电流稳定的情况下，显卡才能正常地工作。

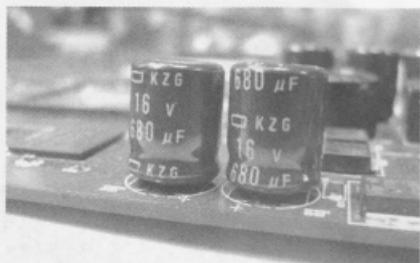


图 1-15 显卡电容

## 1.3 产品分类

- 目前市面能见到的显卡与主板的连接通常是借助以下三种接口之一来实现的
  - 外设部件互连（PCI）接口；
  - 加速图形接口（AGP）；
  - PCI Express（PCI-E）接口。

### 1.3.1 PCI 接口

PCI 接口是 1991 年由英特尔（Intel）公司推出的用于定义局部总线的标准。此标准允许在计算机内安装多达 10 个遵从 PCI 标准的扩展卡。PCI 显卡如图 1-16 所示。

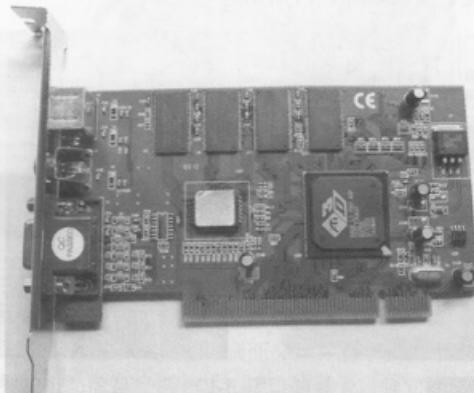


图 1-16 PCI 显卡



最早提出的 PCI 总线工作在 33MHz 频率之下，传输带宽达到 133MB/s (33MHz×32b/s)，基本上满足了当时处理器的发展需要。随着对更高性能的要求，1993 年又提出了 64 位的 PCI 总线，后来又提出把 PCI 总线的频率提升到 66MHz。PCI 接口的速率最高只有 266MB/s，1998 年之后便被 AGP 接口代替。不过至今仍然有新的 PCI 接口的显卡推出，因为有些服务器主板并没有提供 AGP 或者 PCI-E 接口，或者需要组建多屏输出，选购 PCI 显卡仍然是最实惠的方式。

### 1.3.2 AGP 接口

AGP (Accelerate Graphical Port, 加速图形接口) 是 Intel 公司开发的一个视频接口技术标准，是为了解决 PCI 总线的低带宽而开发的接口技术。它通过将图形卡与系统主内存连接起来，在 CPU 和图形处理器之间直接开辟了更快的总线。其发展经历了 AGP 1.0 (AGP 1X/2X)、AGP 2.0 (AGP 4X)、AGP 3.0 (AGP 8X)。最新的 AGP 8X 其理论带宽为 2.1GB/s。AGP 8X 显卡如图 1-17 所示。目前，AGP 接口已经被 PCI-E 接口取代。



图 1-17 AGP 8X 显卡

### 1.3.3 PCI Express 接口

#### 1. PCI-E 介绍

PCI-E (Peripheral Component Interconnect Express) 是新一代的总线接口，它采用的是点对点的数据传输模式，是目前的数据传输接口的主流，分为 1X、2X、4X、8X、16X 几种。目前使用最广泛的为 16X，每个通道的单方向传输速率达到 2.5Gb/s，远远超过 AGP 8X。而采用此类接口的显卡产品，已经在 2004 年正式面世。早在 2001 年的春季“Intel 开发者论坛”上，Intel 公司就提出了要用新一代的技术取代 PCI 总线和多种芯片的内部连接，并称为



第三代 I/O 总线技术。随后在 2001 年年底，包括 Intel、AMD、Dell、IBM 在内的 20 多家业界主导公司开始起草新技术的规范，并在 2002 年完成，对其正式命名为 PCI Express。PCI-E 显卡如图 1-18 所示。

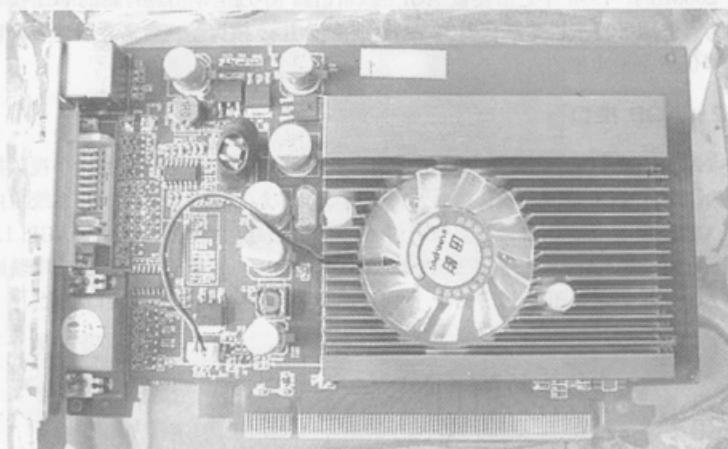


图 1-18 PCI-E 显卡

第一代的 PCI-E 速率为 2.5Gb/s，一对发送的差分信号和一对接收的差分信号组成一路信道，可以实现大约 250MB/s 的数据传输速率。PCI-E 的显卡使用了 16 路信道（又称为 PCI-E 16X），可以实现  $250\text{MB} \times 16 = 4\text{GB/s}$  的数据传输速率，能满足看高清电影或者玩 3D 游戏时大量图像数据在显卡与 MCH 间收发的要求。而一些数据速率要求不高的外设，如千兆位以太网网卡，通常采用一路 PCI-E 的接口（PCI-E 1X）。第二代的 PCI-E 的速率高达 5Gb/s，是 PCI-E 一代的两倍。2007 年后生产的新的计算机主板芯片组和显卡都已升级到了 PCI-E 二代。



### 小知识

差分信号是用一个数值来表示两个物理量之间的差异。从严格意义上来说，所有电压信号都是差分的，因为一个电压只能是相对于另一个电压而言的。在某些系统里，系统“地”被用做电压基准点。当以“地”作为电压测量基准时，这种信号规划被称为单端的。我们使用该术语是因为信号是用单个导体上的电压来表示的。另一方面，一个差分信号作用在两个导体上。信号值是两个导体间的电压差。尽管不是非常必要，这两个电压的平均值还是会经常保持一致。我们用一个方法对差分信号做一下比喻，差分信号就好比是跷跷板上的两个人，当一个人被跷上去的时候，另一个人被跷下来了，但是他们的平均位置是不变的。继续跷跷板的类推，正值可以表示左边的人比右边的人高，而负值表示右边的人比左边的人高。0 表示两个人都是同一水平。



## 2. 最新技术

在以上三种接口中，PCI Express 是最新型的接口，它能在显卡和主板之间提供最快的传输速率。此外，PCI-E 还支持在一台计算机中使用两块显卡。

SLI 和 CrossFire 分别是 nVIDIA 和 ATI 两家的双卡或多卡互连工作组模式。其本质是差不多的，只是叫法不同。

SLI (Scan Line Interlace，扫描线交错，中文名也俗称为速力) 技术是 3Dfx 公司应用于 VooDoo 上的技术。把两块 VooDoo 卡用 SLI 线物理连接起来。工作的时候，一块 VooDoo 卡负责渲染屏幕奇数行扫描，另一块负责渲染偶数行扫描，从而达到将两块显卡“连接”在一起获得“双倍”的性能。目前的 SLI 工作模式与早期 VooDoo 有所不同，现在改为屏幕分区渲染。

支持 nVIDIA 3-way SLI® 技术的微星 P7N Diamond 主板如图 1-19 所示。

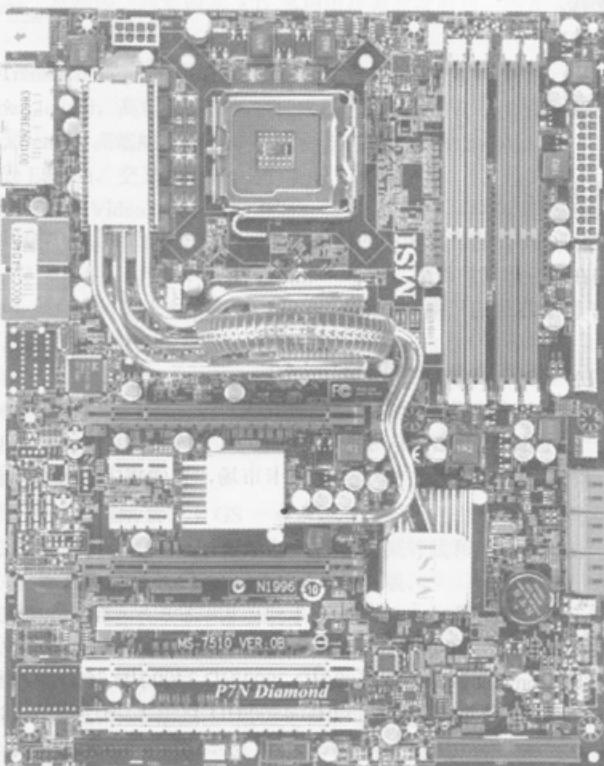


图 1-19 支持 nVIDIA 3-way SLI® 技术的微星 P7N Diamond 主板

CrossFire，中文名交叉火力，简称交火，是 ATI 的一款多重 GPU 技术，可让多块显卡



同时在一部计算机上并排使用，增加运算效能，以与 nVIDIA 的 SLI 技术竞争。CrossFire 技术于 2005 年 6 月 1 日，在 2005 年中国台北电脑展上正式发布，比 SLI 迟一年。从首度公开至今，CrossFire 经过了一次修订。

### 3. 组建 SLI 和 Crossfire

组建 SLI 和 Crossfire，需要几个方面：

- (1) 需要两块以上 PCI-E 接口的显卡，但不要求必须是相同核心。混合 SLI 技术可以用于不同核心显卡。
- (2) 需要主板支持。目前 SLI 授权已开放，支持 SLI 的主板有 nVIDIA 自家的主板和 Intel 主板，如 570 SLI (AMD)、680i SLI (Intel)。Crossfire 已经开放授权。目前，Intel 平台的 945、965、P35、P31、P43、P45、X38、X48 芯片组，AMD 的 770X、790X、790FX、790GX 芯片组均可支持 Crossfire 技术。
- (3) 系统支持。
- (4) 驱动支持。

## 1.4 主要参数

### 1.4.1 显示芯片

显示芯片又称 GPU，它在显卡中的作用，就如同 CPU 在计算机中的作用一样。更直接的比喻就是大脑在人身体里的作用。

常见的生产显示芯片的厂商有 Intel、ATi、nVIDIA、VIA (S3)、SiS、Matrox、3D Labs。

- Intel、VIA (S3)、SiS 主要生产集成芯片；
- ATi、nVIDIA 以独立芯片为主，是目前市场上的主流；
- Matrox、3D Labs 则主要面向专业图形市场。

由于 ATi 和 nVIDIA 基本占据了主流显卡市场，下面将主要针对这两家公司的产品做介绍。

#### 1. 型号

ATi 公司的主要品牌是 Radeon (镭龙) 系列，其型号由早期的 Radeon 7000/7200/7500/8500/9000/9200/9550/9600/9700/9800/X300/X600/X700/X800/X1300/X1600/X1800/X1900/X1950 到近期的 Radeon HD 2400/HD 2600/HD 2900/HD 3400/HD 3600/HD 3800/HD 4350/HD 4550/HD 4600/HD 4650/HD 4670/HD 4770/HD 4800/HD 4850 X2/HD 4870 X2/HD 4890，性能依次由低到高。

nVIDIA 公司的主要品牌是 GeForce (精视) 系列，其型号由早期的 GeForce 256、GeForce2 100/200/400、GeForce3 200/500、GeForce4 420/440/460/4000/4200/4400/4600/4800 到 GeForce FX 5200/5500/5600/5700/5800/5900/5950、GeForce 6100/6150/6200/6400/6500/



6600/6800/、GeForce 8400/8500/8600/8700/8800，再到近期的 GeForce 9400GT/9500GT/9600GSO/9600GT/9800GT/9800GTX+/9800GX2/GTX260/GTX260+/GTX280/GTX275/GTX285/GTX295，性能由低到高。

## 2. 版本级别

除了上述标准版本之外，还有些特殊版。特殊版一般会在标准版的型号后面加个后缀，常见如下：

### (1) ATI 显卡常见后缀说明

SE: Simplify Edition，简化版。通常只有 64 位内存界面，或者是像素流水线数量减少。

Pro: Professional Edition，专业版、高频版。一般比标准版在管线数量、顶点数量及频率等方面都要稍微高一点。

XT: eXtreme，高端版。该后缀在 ATI 系列中代表高端型号，而在 nVIDIA 系列中则代表低端型号。

XT PE: eXtreme Premium Edition XT 白金版。高端的型号。

XL: eXtreme Limited，高端系列中的较低端型号。ATI 最新推出的 R430 中的高频版。

XTX: XT eXtreme，高端版。X1000 系列发布之后的新的命名规则。

CE: Crossfire Edition，交叉火力版。

VIVO: Video In and Video Out，指显卡同时具备视频输入与视频捕捉两大功能。

HM: Hyper Memory。可以占用内存的显卡。

### (2) nVIDIA 显卡常见后缀说明

XT: 降频版，而该后缀在 ATI 系列产品中则表示最高端。

XT: 在 XT 基础上再次降频以降低价格。

LE: Lower Edition 低端版。和 XT 基本一样，ATI 也用过。

SE: 和 LE 相似，基本是 GS 的简化版最低端的几个型号。

MX: 平价版，大众类。

GS: 普通版或 GT 的简化版。

GE: 也是简化版，不过略微强于 GS 一点。影驰显卡用其表示“骨灰玩家版”。

GT: 常见的游戏芯片。比 GS 高一个档次，没有缩减管线和顶点单元。

GTS: 介于 GT 和 GTX 之间的版本，是 GT 的加强版。

GTX: GT eXtreme。目前代表最强的版本，简化后成为 GT。

Ultra: 在 GeForce8 系列之前代表着最高端，但 9 系列最高端的命名就改为 GTX。

GT2 eXtreme: 双 GPU 显卡。

Ti: Titanium，钛。以前的用法，一般就是代表了 nVIDIA 的高端版本。

Go: 用于移动平台。

TC: Turbo Cache，可以占用内存的显卡。

GX2: GT eXtreme 2，指一块显卡拥有两块显示核心，如 9800GX2、7950GX2。

自 G100 系列之后，nVIDIA 重新命名显卡后缀版本，使产品线更加整齐。



GTX：高端/性能级显卡，如 GTX295、GTX275、GTX285、GTX280、GTX260。

GT：代表主流产品线，如 GT120、GT130、GT140、GTS250（9500GT、9600GT、9800GT 9800GTX+）。

G：低端入门产品，如 G100、G110（9300GS、9400GT）。

### 3. 开发代号

所谓开发代号就是显示芯片制造商为了便于显示芯片在设计、生产、销售方面的管理和驱动架构的统一而对一个系列的显示芯片给出基本的代号。开发代号的作用是降低显示芯片制造商的成本、丰富产品线及实现驱动程序的统一。一般来说，显示芯片制造商可以利用一个基本开发代号再通过控制渲染管线数量、顶点着色单元数量、显存类型、显存位宽、核心和显存频率、所支持的技术特性等方面来衍生出一系列的显示芯片来满足不同的性能、价格、市场等不同的定位，还可以把制造过程中具有部分瑕疵的高端显示芯片产品通过屏蔽管线等方法处理成为完全合格的相应低端的显示芯片产品出售，从而大幅度降低设计和制造的难度和成本，丰富自己的产品线。同一种开发代号的显示芯片可以使用相同的驱动程序，这为显示芯片制造商编写驱动程序及消费者使用显卡都提供了方便。

同一种开发代号的显示芯片的渲染架构及所支持的技术特性基本上是相同的，而且所采用的制程也相同，所以开发代号是判断显卡性能和档次的重要参数。同一型号的不同版本可以是一个代号，如 GeForce X700/X700 Pro/X700 XT 代号都是 RV410；而 Radeon X1900/X1900XT/X1900XTX 代号都是 R580 等。但也有其他的情况，如 GeForce 7300 LE/7300 GS 代号是 G72，而 GeForce 7300GT/7600GS/7600GT 代号都是 G73 等。GPU 详细参数见附录 A。

### 4. 制造工艺

制造工艺指的是在生产 GPU 过程中，要进行加工各种电路和电子组件，制造导线连接各个元器件。早期其生产的精度以  $\mu\text{m}$ （微米）来表示，现在多以 nm（纳米）表示（ $1\text{mm}=1000\mu\text{m}$ ,  $1\mu\text{m}=1000\text{nm}$ ）。精度越高，生产工艺越先进，在同样的材料中可以制造更多的电子组件，连接线也越细，集成度也越高，芯片的功耗也越低。

制造工艺的微米是指 IC（Integrated Circuit，集成电路）内电路与电路之间的距离。制造工艺的趋势是向密集度越高的方向发展。密度越高的 IC 电路设计，意味着在同样大小面积的 IC 中，可以拥有密度更高、功能更复杂的电路设计。微电子技术的发展与进步，主要是靠工艺技术的不断改进，使得器件的特征尺寸不断缩小，从而集成度不断提高，功耗降低，器件性能得到提高。芯片制造工艺在 1995 年以后，从  $0.5\mu\text{m}$ 、 $0.35\mu\text{m}$ 、 $0.25\mu\text{m}$ 、 $0.18\mu\text{m}$ 、 $0.15\mu\text{m}$ 、 $0.13\mu\text{m}$ ，再到目前主流的  $90\text{nm}$ 、 $65\text{nm}$ 、 $55\text{nm}$  等。

### 5. 核心频率

显卡的核心频率是指显示核心的工作频率，其工作频率在一定程度上可以反映出显示核心的性能，但显卡的性能是由核心频率、显存频率、显存位宽、像素管线显存容量、像素填充率等多方面的情况所决定的，因此在显示核心不同的情况下，核心频率高并不代表此显卡性能强。例如，GeForce 9600Pro 的核心频率达到了  $400\text{MHz}$ ，要比 GeForce 9800Pro 的  $380\text{MHz}$



高,但在性能上 GeForce 9800Pro 绝对要强于 9600Pro。在同样级别的芯片中,核心频率高的性能要强一些,提高核心频率就是显卡超频的方法之一。显示芯片主流的只有 ATI 和 nVIDIA 两家,两家都提供显示核心给第三方的厂商。在同样的显示核心下,部分厂商会适当提高其产品的显示核心频率,使其工作在高于显示核心固定的频率上以达到更高的性能。

## 1.4.2 显存

显存,也称为帧缓存,它的作用是用来存储显示芯片处理过或者即将提取的渲染数据。如同计算机的内存一样,显存是用来存储要处理的图像信息的部件。我们在显示屏上看到的画面是由一个个的像素点构成的,而每个像素点都以 4~32bit 甚至 64bit 的数据来控制它的亮度和色彩。这些数据必须通过显存来保存,再交由显示芯片和 CPU 调配,最后把运算结果转化为图像输出到显示器上。

### 1. 显存类型

目前,市面上能见到的显卡上采用的显存类型主要有 DDR SDRAM、DDR SGRAM、DDR2、DDR3、DDR4、DDR5。其中,DDR SDRAM 常简称 DDR,而 DDR2、DDR3、DDR4、DDR5 从制造工艺上也属于 DDR SDRAM 大类,但从产品分类角度来看,互相在插槽上不兼容,所以本书还是分别来讲解。

#### (1) DDR SDRAM

DDR SDRAM 是 Double Data Rate SDRAM (双倍数据速率) 的缩写,它能提供较高的工作频率,带来优异的数据处理性能。

#### (2) DDR SGRAM

DDR SGRAM 是显卡厂商特别针对绘图者需求,为了加强图形的存取处理及绘图控制效率,从同步动态随机存取内存 (SDRAM) 所改良而得的产品。SGRAM 允许以方块 (Block) 为单位个别修改或者存取内存中的资料,它能够与中央处理器 (CPU) 同步工作,可以减少内存读取次数,增加绘图控制器的效率。尽管它稳定性不错,而且性能表现也很好,但是它的超频性能很差。

DDR SGRAM 显存目前已经被淘汰。

#### (3) DDR2

DDR2 可以看做 DDR 的一种升级和扩展。DDR2 把 DDR 的“2bit Prefetch (2 位预取)”技术升级为“4 bit Prefetch (4 位预取)”机制。在相同的核心频率下,DDR2 的有效频率是 DDR 的两倍;在相同显存位宽的情况下,显存带宽也是 DDR 的两倍,这对显卡的性能提升是非常有益的。从技术上讲,DDR2 的 DRAM 核心可并行存取,在每次存取中处理 4bit 数据而非 DDR 的 2bit 数据,这样 DDR2 便实现了在每个时钟周期处理 4bit 数据,是传统 DDR 处理的 2bit 数据的两倍。相比 DDR,DDR2 的另一个改进之处在于它采用 144Pin 球形针脚的 FBGA 封装方式替代了传统的 TSOP 方式,工作电压也由 2.5V 降为 1.8V。

DDR2 目前多被低端显卡产品采用。

#### (4) DDR3

DDR3 可以看做 DDR2 的改进版。二者有很多相同之处,如采用 1.8V 标准电压,主要采



用 144Pin 球形针脚的 FBGA 封装方式。不过 DDR3 核心有所改进：DDR3 采用  $0.11\mu\text{m}$  生产工艺，耗电量较 DDR2 明显降低。此外，DDR3 采用了 Pseudo Open Drain 接口技术，只要电压合适，显示芯片可直接支持 DDR3。当然，显存颗粒较长的延迟时间（CAS Latency，即内存需要经过多少个周期才能开始读/写数据）一直是高频率显存的一大通病。DDR3 也不例外，DDR3 的 CAS Latency 为 5/6/7/8 周期，相比之下 DDR2 为 3/4/5 周期。客观地说，DDR3 相对于 DDR2 在技术上并无突飞猛进的进步，但 DDR3 的性能优势仍比较明显。

① 功耗和发热量较小：吸取了 DDR2 的教训，在控制成本的基础上降低了功耗和发热量，使得 DDR3 更易于被用户和厂家接受。

② 工作频率更高：由于功耗降低，DDR3 可实现更高的工作频率，在一定程度上弥补了延迟时间较长的缺点，同时还可作为显卡的卖点之一，这在搭配 DDR3 显存的显卡上已有表现。

③ 降低显卡整体成本：DDR2 显存颗粒规格多为  $4\text{M}\times32\text{bit}$ ，搭配中高端显卡常用的 128MB 显存仅需 8 颗。而 DDR3 显存规格多为  $8\text{M}\times32\text{bit}$ ，单颗颗粒容量较大，4 颗即可构成 128MB 显存。如此一来，显卡 PCB 面积可减小，成本得以有效控制，此外，颗粒数减少后，显存功耗也能进一步降低。

④ 通用性好：相对于 DDR 变更到 DDR2，DDR3 对 DDR2 的兼容性更好。由于针脚、封装等关键特性不变，搭配 DDR2 的显示核心和公版设计的显卡稍加修改便能采用 DDR3 显存，这对厂商降低成本大有好处。

目前，DDR3 显存在新出的大多数中高端显卡上得到了广泛的应用。

#### (5) DDR4

DDR4 和 DDR3 基本技术一样，DDR4 单颗显存颗粒可实现 64bit 位宽、64MB 容量，也就是说只需 4 颗显存芯片就能够实现 256bit 位宽、256MB 容量，8 颗更可轻松实现 512bit 位宽、512MB 容量。目前，DDR4 显存颗粒的速度集中在 0.7~0.9ns，但 DDR4 显存时序过长，同频率的 DDR3 显存在性能上要领先于采用 DDR4 显存的产品，并且 DDR4 显存并没有因为电压更低而解决高功耗、高发热的问题，这导致 DDR4 对 DDR3 缺乏竞争力，逐渐被淘汰了。

#### (6) DDR5

相对于 DDR3、DDR4 而言，DDR5 拥有诸多技术优势，还具备更高的带宽、更低的功耗、更高的性能。如果搭配同数量、同显存位宽的显存颗粒，DDR5 显存颗粒提供的总带宽是 DDR3 的 3 倍以上。由于 DDR5 显存可实现比目前主流的 128bit 或 256bit 显存更高的位宽，也就意味着采用 DDR5 显存的显卡会有更大的灵活性，性能也会有较大幅度的提升，所以目前主流的高端显卡都无一例外地采用了 DDR5 显存。

## 2. 显存位宽

显存位宽是显存在一个时钟周期内所能传送数据的位数，位数越大则瞬间所能传输的数据量越大，这是显存的重要参数之一。目前，市场上的显存位宽有 64bit、128bit、256bit 和 512bit 4 种。人们习惯上叫的 64bit 显卡、128bit 显卡和 256bit 显卡就是指其相应的显存位宽。显存位宽越高，性能越好价格也就越高，因此 512bit 宽的显存更多应用于高端显卡，而主流显卡基本都采用 128bit 和 256bit 显存。



显存带宽=显存频率×显存位宽÷8。在显存频率相当的情况下，显存位宽将决定显存带宽的大小。例如，同样显存频率为500MHz的128bit和256bit显存，那么128bit显卡的显存带宽为 $500\text{MHz} \times 128\text{bit} \div 8 = 8\text{GB/s}$ ，而256bit显卡的显存带宽是 $500\text{MHz} \times 256\text{bit} \div 8 = 16\text{GB/s}$ ，是128bit的两倍，可见显存位宽在显存数据中的重要性。显卡的显存是由一块块的显存芯片构成的，显存总位宽同样也是由显存颗粒的位宽组成。显存位宽=显存颗粒位宽×显存颗粒数。

显存颗粒上都带有相关厂家的内存编号，可以去网上查找其编号，就能了解其位宽，再乘以显存颗粒数，就能得到显卡的位宽。

### 3. 显存容量

虽然说在其他参数相同的情况下容量是越大越好，但也不要被大容量显存吸引了。例如，384MB的9600GSO就远强于512MB的9600GSO，原因有很多，这里就不一一列出了。只需要注意选择显卡时显存只不过是参考之一，重要的还是其他的数据，如核心、位宽、频率等，这些决定显卡的性能优先于显存容量。

主流显存容量有64MB、128MB、256MB、384MB、512MB、768MB、896MB、1GB、1792MB、2GB。

### 4. 显存封装类型

显存封装形式主要有TSOP（Thin Small Out-Line Package，薄型小尺寸封装）、QFP（Quad Flat Package，小型方块平面封装）、MBGA（Micro Ball Grid Array，微型球栅阵列封装），其中MBGA又称FBGA（Fine-pitch Ball Grid Array）。

2004年前的主流显卡基本的封装类型是用TSOP、MBGA和TSOP封装。但是由于nVIDIA的GeForce3、GeForce4系的出现，MBGA封装成为主流。MBGA封装可以达到更快的显存速度，远超过TSOP封装的极限400MHz。

### 5. 显存速度

显存速度一般以ns（纳秒）为单位。常见的显存速度有7ns、6ns、5.5ns、5ns、4ns、3.6ns、2.8ns、2.2ns和1.1ns等，越小表示速度越快、性能越好。

显存的理论工作频率计算公式：

$$\text{额定工作频率 (MHz)} = 1000 / \text{显存速度} \times n$$

n因显存类型不同而不同：如果是SDRAM显存，则n=1；如果是DDR显存，则n=2；如果是DDR2显存，则n=4。

### 6. 显存频率

显存频率在一定程度上反应着该显存的速度，以MHz（兆赫兹）为单位。

显存频率随着显存的类型、性能的不同而不同，显存频率与显存时钟周期是相关的，二者成倒数关系，也就是

$$\text{显存频率} = 1 \div \text{显存时钟周期}$$

如果是SDRAM显存，其时钟周期为6ns，那么它的显存频率就为 $1 \div 6\text{ns} = 166\text{MHz}$ ；而



对于 DDR SDRAM，其时钟周期为 6ns，那么它的显存频率就为  $1 \div 6\text{ns} = 166\text{MHz}$ ，但要了解这是 DDR SDRAM 的实际频率，而不是平时所说的 DDR 显存频率。因为 DDR 在时钟上升期和下降期都进行数据传输，其一个周期传输两次数据，相当于 SDRAM 频率的两倍。习惯上称呼的 DDR 频率是其等效频率，是在其实际工作频率上乘以 2 得到的。因此 6ns 的 DDR 显存，其显存频率为  $1 \div 6\text{ns} \times 2 = 333\text{MHz}$ 。但要明白的是，显卡制造时，厂商设定了显存实际工作频率，而实际工作频率不一定等于显存最大频率。此类情况现在较为常见，如显存最大能工作在 650MHz，而制造时显卡工作频率被设定为 550MHz，这样显存就存在一定的超频空间。这也就是目前厂商惯用的方法，显卡以超频为卖点。

### 1.4.3 显卡采用的技术

#### 1. 像素渲染管线

渲染管线也称为渲染流水线，是显示芯片内部处理图形信号相互独立的并行处理单元。

在某种程度上可以把渲染管线比喻为工厂里面常见的各种生产流水线。工厂里的生产流水线是为了提高产品的生产能力和效率，而渲染管线则是为了提高显卡的工作能力和效率。渲染管线的数量一般是以像素渲染流水线的数量乘以每管线的纹理单元数量来表示。渲染管线的数量是决定显示芯片性能和档次的最重要的参数之一，在相同的显卡核心频率下，更多的渲染管线也就意味着更大的像素填充率和纹理填充率。从显卡的渲染管线数量上可以大致判断出显卡的性能和高低档次。但显卡性能并不仅仅只是取决于渲染管线的数量，同时还取决于显示核心架构、渲染管线的执行效率、顶点着色单元的数量及显卡的核心频率和显存频率等方面。

一般来说在相同的显示核心架构下，渲染管线越多也就意味着性能越高，但是在不同的显示核心架构下，渲染管线的数量多就并不意味着性能更好。例如， $4 \times 2$  架构的 GeForce2 GTS，其性能就不如  $2 \times 2$  架构的 GeForce4 MX440 的性能。

#### 2. 顶点着色器数

顶点着色器（Vertex Shader）也称为顶点遮蔽器和顶点着色引擎，根据官方规格，顶点着色器是一种增加各式特效在 3D 场景中的处理单元的技术。顶点着色器的可程序化特性允许开发者靠加载新的软件指令来调整各式的特效，每一个顶点将被各种的数据变素清楚地定义，至少包括每一顶点的 x、y、z 坐标，每一点顶点可能包括的数据有颜色、最初的路径、材质、光线特征等。顶点着色器数越多，速度就越快。

#### 3. 3D API

API（Application Programming Interface）是应用程序接口的意思，而 3D API 则是指显卡与应用程序直接的接口。

3D API 能让编程人员所设计的 3D 软件调用其 API 内的程序，从而让 API 自动和硬件的驱动程序沟通，启动 3D 芯片内强大的 3D 图形处理功能，所以大幅度地提高了 3D 程序的设计效率。如果没有 3D API，在开发程序时程序员必须要了解全部的显卡特性才能编写出与显卡完全匹配的程序，发挥出全部的显卡性能。而有了 3D API 这个显卡与软件直接的接



口，程序员只需要编写符合接口的程序代码，就可以充分发挥显卡的性能，不必再去了解硬件的具体性能和参数，这样就大大提高了程序开发的效率。同样，显示芯片厂商根据标准来设计自己的硬件产品，以达到在 API 调用硬件资源时最优化，获得更好的性能。有了 3D API，便可实现不同厂家的硬件、软件最大范围的兼容。例如，在最能体现 3D API 的游戏方面，游戏设计人员设计时，不必再用去考虑具体某款显卡的特性，而只是按照 3D API 的接口标准来开发游戏，当游戏运行时则直接通过 3D API 来调用显卡的硬件资源。目前，个人电脑中主要应用的 3D API 有 DirectX 和 OpenGL。

#### 4. RAMDAC 频率和支持最大分辨率

RAMDAC (Random Access Memory Digital/Analog Convertor) 是随机存取内存数模转换器。

RAMDAC 的作用是将显存中的数字信号转换为显示器能够显示出来的模拟信号，其转换速率以 MHz 表示。计算机中处理数据的过程其实就是将事物数字化的过程，所有的事物将被处理成 0 和 1 两个数，而后不断进行累加计算。图形加速卡也是靠这些 0 和 1 对每一个像素进行颜色、深度、亮度等各种处理。显卡生成的这些信号都是以数字来表示的，但是所有的 CRT 显示器都是以模拟方式进行工作的，数字信号无法被识别，这就必须有相应的设备将数字信号转换为模拟信号。RAMDAC 的速度决定了刷新频率的高低（与显示器的“带宽”意义近似）。其工作速度越高，频带越宽，高分辨率时的画面质量越好。该数值决定了在足够的显存下，显卡最高支持的分辨率和刷新率。如果要在 1024×768 的分辨率下达到 85Hz 的分辨率，RAMDAC 的速率至少是  $1024 \times 768 \times 85\text{Hz} \times 1.344$  (折算系数)  $\approx 90\text{MHz}$ 。目前，主流的显卡 RAMDAC 都能达到 350MHz 和 400MHz，足以满足和超过目前大多数显示器所能提供的分辨率和刷新率。

#### 5. DirectX

DirectX 并不是一个单纯的图形 API，它是由微软公司开发的用途广泛的 API，它包含有 Direct Graphics (Direct 3D+Direct Draw)、Direct Input、Direct Play、Direct Sound、Direct Show、Direct Setup、Direct Media Objects 等多个组件，提供了一整套的多媒体接口方案。只是其在 3D 图形方面的优秀表现，让它的其他方面显得暗淡无光。DirectX 开发之初是为了弥补 Windows 3.1 系统对图形、声音处理能力的不足，而今已发展成为对整个多媒体系统的各个方面都有决定性影响的接口。DirectX 的最新版本为 DirectX 11。

#### 6. OpenGL

OpenGL (Open Graphics Lib) 是一套三维图形处理库，也是该领域的工业标准。计算机三维图形是指将用数据描述的三维空间通过计算转换成二维图像并显示或打印出来的技术。OpenGL 就是支持这种转换的程序库，它源于 SGI 公司为其图形工作站开发的 IRIS GL，在跨平台移植过程中发展成为 OpenGL。SGI 在 1992 年 7 月发布 1.0 版，后成为工业标准，由成立于 1992 年的独立财团 OpenGL Architecture Review Board (ARB) 控制。SGI 等 ARB 成员以投票方式产生标准，并制成规范文档 (Specification) 公布，各软硬件厂商据此开发自己系统上的实现。只有通过了 ARB 规范全部测试的实现才能称为 OpenGL。1995 年 12 月 ARB 批准了 1.1 版本，最新版规范是



在 2007 年新加坡（国际）电脑动画节上公布的 OpenGL 3.0。

## 1.5 显卡品牌及 BIOS 下载

目前，显卡业的竞争日趋激烈，各类品牌名目繁多，以下是一些常见的牌子，仅供参考：蓝宝石、华硕、迪兰恒进、丽台、XFX 讯景、技嘉、映众、微星、艾尔莎、富士康、捷波、盘正、映泰、耕升、旌宇、影驰、铭瑄、翔升、盈通、祺祥、七彩虹、斯巴达克、索泰、双敏、精英、昂达。部分显卡品牌 Logo 如图 1-20 所示。



图 1-20 部分显卡品牌 Logo

曾经辉煌的一些显卡品牌还有 3Dfx、帝盟、创新、大力神等，随着市场竞争越来越激烈，都渐渐地消失了，而也有一些品牌直到现在，都还保持着非常好的出货记录。下面简单介绍一下部分知名的品牌。

### 1.5.1 艾尔莎

艾尔莎（ELSA）公司的网址为 <http://www.elsa-tech.com>。

说起艾尔莎这个品牌，相信大家都不会陌生，因为它的知名度实在太大了。虽然现在的艾尔莎与当初的艾尔莎已经无法相比，但是在无数玩家心中，艾尔莎仍然是高端的象征。

艾尔莎 1980 年成立于德国，至今已经有近 30 年的历史。1980 年艾尔莎收购 Beisch Elektronik，正式迈入图形卡领域。在这之后的时间，艾尔莎的发展一帆风顺，到了图形竞争非常激烈的 20 世纪 90 年代，艾尔莎已经有很强大的图形驱动编写能力和技术研发实力。尤其是在 T&L（Transform&Lighting，坐标转换和光源）技术方面，艾尔莎更是有着得天独厚的优势。

艾尔莎之所以成为人们铭记的品牌，主要就是因为其驱动程序和研发能力都很强。每一款艾尔莎显卡都有自己的驱动程序，而且显卡的版型设计基本为非公版产品，做工也非常优良。正是因为 nVIDIA 看中了艾尔莎的驱动编写能力，于 2000 年在美国新奥尔良市正式与艾尔莎建立合作伙伴的关系，以三年的专业卡独家销售授权换取了艾尔莎的驱动程序编写人员。此后在很长一段时间之内，nVIDIA 专业卡的驱动程序都是由这部分人员来编写的，艾尔莎与 nVIDIA 的合作也从此拉开帷幕。

在 1999 年，艾尔莎的营业额突破了 2 亿美元，达到了惊人的 2.27 亿美元；在此后的两三年内，艾尔莎每年的营业额都在 2 亿美元左右，成为了当时第一大显卡品牌。但是，2000 年以后，由于显卡市场竞争加剧、平价品牌的加入及 911 事件对美国造成的经济危机，艾尔莎的危机一步步逼近。终于在 2002 年 3 月宣布德国总公司破产。不过这对其他地区的分公司影响不大。

总公司破产后的艾尔莎各地分公司没有了领导，在经营方针上出现了巨大的偏差。最终，艾尔莎在内地地区的产品由广州昂达电子全权代理。昂达推出的艾尔莎 7300GT 显卡如图 1-22 所示。昔日的王者成为了普通品牌，产品的品质与价格也与普通产品基本保持一致。



图 1-21 昂达推出的艾尔莎 7300GT



而 2007 年，艾尔莎中国台湾公司突然宣布艾尔莎将重新回归中国内地市场，昂达的代理权也已经到期，眼看着艾尔莎将会以一个全新的姿态面向中国市场，并且推出了不少做工很不错的产品，但最后终因渠道管理不力，在中国内地市场再一次销声匿迹了。

### 1.5.2 丽台

丽台 (leadtek) 公司的网址为 <http://www.leadtek.com/cbt>。

这个品牌相信大家都会陌生，现在市场上都还可以经常见到丽台的产品。丽台公司于 1986 年在中国台湾成立。从现在市场上的显卡品牌来看，有着如此悠久历史的显卡品牌中也就丽台在市场上仍然有着很高的声望。当时的显卡品牌在岁月的蹉跎中纷纷倒下，剩下的有艾尔莎与 S3，但它们的显卡在市场上已经没有什么特色，并且市场占有率很低。而丽台到现在为止仍然是 nVIDIA 亚太地区（除日本之外）唯一的专业卡制造与零售商。

丽台以显卡起家，历经 CGA、EGA、VGA、Windows Accelerator VGA、工作站显卡及 3D 显卡，多年来以快速推出新产品，维持优良质量及性能领先在同业著称，并以 WinFast 品牌享誉全球，其质量稳定的超频设计能力深受业界肯定，屡获全球各大媒体评鉴首奖殊荣，是 PC 玩家的显卡最佳首选。WinFast 品牌以稳定驰名，其有利超频的设计一直赢得各媒体的最佳评价及公众的支持。

从现在的市场情况来看，丽台似乎只是生产和销售 nVIDIA 芯片的产品（包括 GeForce 系列和 Quadro 专业卡系列，见图 1-22），但是在早期丽台并不是只与 nVIDIA 合作，S3、3Dlabs、3Dfx、Intel 都是丽台的合作对象，唯独不与 ATI 合作。



图 1-22 丽台出品的 Quadro 专业卡

目前，丽台除了推出显卡产品以外，其他一些通信产品也是丽台的主打。单从显卡这个

产品线来看，虽然现在丽台的显卡没有当年那么有特色（如自己研发驱动、开发 BIOS）等，但是能够支撑 23 年实属不易，可谓经久不衰。

### 1.5.3 耕升

耕升（Gainward）公司的网址为 <http://www.gainward.net>。

Gainward 于 1984 年成立于中国台湾，中文名叫做耕宇。早在 486、586 时代，耕宇就开始生产计算机显卡，并凭借着较低的价格与不错的品质，在消费者心中慢慢地扎下了根。特别是到了 VooDoo 时代，耕宇的成长速度更快，很快就成了销量非常可观的显卡品牌。

但是，当耕宇打算进入内地市场的时候，才发现耕宇这个品牌已经被抢注了，无奈之下只好改名为耕升。说起耕升，相信大家就不会陌生了，在 2002—2003 年间，耕升显卡几乎成为了 DIY 玩家心中的神。

是什么让耕升显卡如此有魔力呢？相信对耕升这个品牌比较了解的朋友应该知道，耕升一直以来是秉持“品质高于一切”的经营理念，力求每一款贴有“耕升”标志的产品都成为众多消费者心目中的首选。

当年的耕升以非常强大的超频能力著称，做工用料都极度奢华，而最值得一提的恐怕就是当年的神奇跳线，当时的耕升 MX/MX400 黄金珍藏版可以通过一个小小的跳线直接改为 Quadro 专业显卡，而其他厂商均没有推出这样的产品，因此耕升一炮走红。

后来的产品虽然没有神奇跳线，但超频能力都非常好，这与其奢华的用料与优秀的做工是分不开的。但是，由于在 2004 年耕升内部出现了问题，导致最终被同德收购。

但是，由于在 2004 年耕升内部出现了问题，导致最终被同德收购，属于同德旗下的自有高端显卡品牌。虽然后续产品从做工与用料上都还不错，但是相对于当年的耕升来说，实在不是一个级别的。而更多人所怀念和提起的耕升仍然是在 2002—2003 年的那个耕升。

### 1.5.4 微星

微星（MSI）公司的网址为 <http://www.msi.com>。

在国内，可能很多人对微星的主板比显卡更加熟悉，但是实际上微星在全球业务上，微星显卡的业绩要比主板突出很多。在全球主板业务上，微星仅仅能进前五，而在显卡业务上微星绝对是数一数二的品牌。只是由于微星显卡的零售价格稍微比国内其他平价品牌同类产品的零售价格稍贵，在国内这样的消费环境下，接受度很难提升而已。

微星科技成立于 1985 年，根据维基百科上显示，微星是全球最大的显卡制造商，平均每 2.8s 就生产出一块显卡。虽然这个数据没有得到证实，但是也是有根据的。部分网友可能会说栢能、同德、启亨这些排到哪儿去了？怎么会是微星呢？但是这个问题如果从另一个方面来理解的话，就相对好理解了。我们可以想象，以上的这些品牌都只有一个工厂，而微星的工厂是遍布全球的，仅仅在中国就有两个工厂，分别位于昆山与深圳。微星的销量可观，在 2000—2004 年这 5 年中，微星连续 5 年夺得了全球显卡销量第一的桂冠。

微星 PCI-E 显卡如图 1-23 所示。



图 1-23 微星 PCI-E 显卡

### 1.5.5 华硕

华硕（ASUS）公司的网址为 <http://www.asus.com>。

华硕总公司位于中国台湾台北市北投区。在 2007 年度《财富》全球最大五百家公司排名中名列第 427 位。

华硕是在自主研发方面做的不错的品牌，相对于平价品牌，在做工和特色技术上更出色一些，华硕的 ATI 显卡和 nVIDIA 显卡都是核心合作伙伴，华硕的“为游戏而生”是品牌特色，大家都耳熟能详。

华硕 NGTX295 显卡如图 1-24 所示。



图 1-24 华硕 NGTX295 显卡



### 1.5.6 蓝宝石

蓝宝石 (SAPPHIRE) 公司的网址为 <http://www.sapphiretech.com>。

蓝宝石是 ATI 全球最大的合作伙伴，也是全球最大的 AIB 厂商（即 ATI 图形显卡官方认证最高级别合作伙伴，Add In Board ATI 认证合作伙伴），其背后的工厂就是被称为 ATI 原厂卡故乡的栢能。蓝宝石所有显卡都由栢能代工，但是蓝宝石品牌本身和栢能没有什么关系，栢能也代工 nVIDIA 显卡，并且有自己的 nVIDIA 显卡品牌索泰。

蓝宝石显卡如图 1-25 所示。

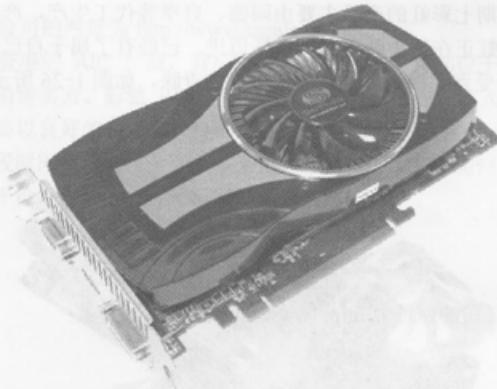


图 1-25 蓝宝石显卡

### 1.5.7 迪兰恒进

迪兰恒进 (Dataland) 公司的网址为 <http://www.dataland.com.cn>。

中国台湾憾讯旗下的显卡品牌，在国外的商标为 PowerColor，几乎和蓝宝石齐名，也是 ATI 的重要级合作伙伴。单从蓝宝石和迪兰恒进这两个品牌来说，进入显卡市场的时间并不长，不过它们的背后都有实力很强大的公司，如蓝宝石背后的栢能、迪兰恒进背后的憾讯。

在产品上，由于两家都是 AIB 厂商，并且都有研发、生产、销售、售后的实力，所以这两个品牌的产品都比较令人放心，几乎代表了当今 ATI 显卡的最高品质。在海外，这两个品牌也是 ATI 显卡之王，虽然说 HIS、GECUBE、技嘉等也是 AIB 合作伙伴，但是在销量方面，似乎蓝宝石和迪兰恒进的市场接受度更大一些。

2008 年，业界传出了蓝宝石与迪兰恒进中国内地分公司合并的消息，后经证实确有此事，主要是为了相互共享资源。但是对于用户来说影响不大，因为在市场端蓝宝石仍然是蓝宝石，迪兰恒进也仍然是迪兰恒进，两个品牌与背后的工厂都互不关联。



### 1.5.8 七彩虹

李宝蓝 8.2.1

七彩虹（Colorful）公司的网址为 <http://www.colorful.cn>。

七彩虹的前身是世和资讯公司，公司成立于 1995 年，七彩虹实际上就是世和资讯公司的自有显卡品牌。

1999 年 2 月，七彩虹正式以世和资讯公司的自有显卡品牌面世。凭借着世和资讯多年的产品代理经验，七彩虹显卡在市场和渠道上做得非常出色，很快就成为了销量最大的显卡厂商之一，这在当年竞争非常激烈的显卡市场上确实算是个奇迹。直到现在，七彩虹仍然是中国内地显卡销量最高的品牌。

从产品来看，早期七彩虹的产品主要由同德、启亨等代工生产，产品本身没有太大的特色。不过近两年七彩虹正在努力朝着高端市场迈进，已经有了属于自己的产品研发团队，特别是 iGame 系列产品受到了很多玩家及高端用户的青睐，如图 1-26 所示。

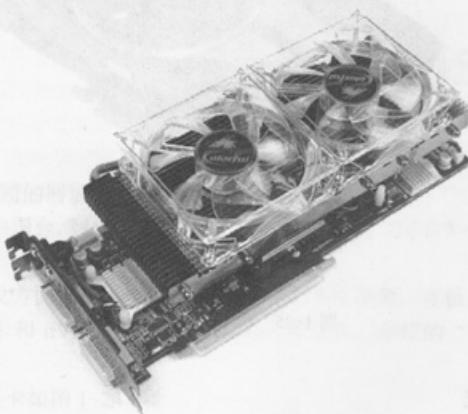


图 1-26 七彩虹 iGame 显卡



#### 小知识

七彩虹的显卡一般用 CH、CT、CF、CV 和 CL 作为显卡的后缀。

“C”为七彩虹的英文注册商标“Colorful”的缩写，代表“由七彩虹板卡专业研发团队出品，除拥有七彩虹一贯的高品质、高性能特性外，还享有七彩虹特色而贴心的‘后售后服务’体系”。

而在此“C”后另一个字母是对相同芯片的不同功能和价格的划分，相应解释如下：

CH：“H”是“High”（高端）的缩写。此产品命名将会独立应用在最高端的产品，此系列代表七彩虹对技术有着狂热向往的高端用户最深刻的理解。

CT：“T”是“Technology”（技术）的缩写。此产品线将最能体现七彩虹科技专业研发



团队的技术特色及研发力量，是相同产品中最耀目的技术明星。

CF：“F”是“Full”（完整）的缩写。此产品线是“完整”按照芯片开发商的公板来设计，完全符合公板所有的特性和规格，具备公板所有的功能。

CV：“V”是“Value”（价值、超值）的缩写。此产品线代表七彩虹竭力为用户提供价格优惠而性能出众（高性价比）的产品理念。

CL：“L”是“Limit”（有限度）的缩写。表明此产品线在功能上与公板“CF”版相比有所简略，是七彩虹因应市场需求而特制的一款性能价格相宜的普及版本。

### 1.5.9 影驰

影驰（Galaxy）公司的网址为 <http://www.szgalaxy.com>。

影驰是一家来自香港的 AIC 厂商，背后的公司名叫嘉威，总部位于深圳，有丰富的产品研发、设计、生产、销售实力。影驰 1999 年开始与 nVIDIA 合作，迈入显卡市场，不过近几年发展非常迅猛，主要以良好的做工和较低的价格受到了人们的喜爱，而且影驰也经常会推出一些特色产品，如前段时间就推出了全球首款采用数字供电的 GTX26075 显卡（见图 1-27）。影驰显卡的定位就是平价，比一般平价产品还有好的品质。

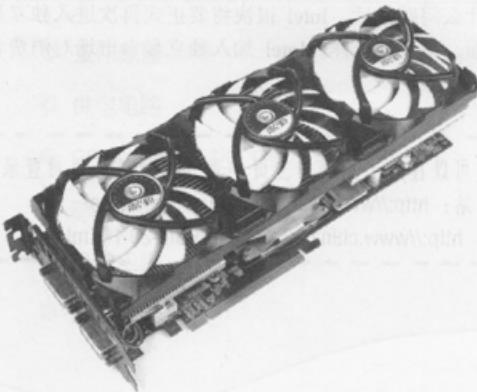


图 1-27 采用数字供电的影驰显卡

从近两年影驰显卡的销量来看，可以说是节节攀升，昔日的同德五虎除了七彩虹之外，销量都不及影驰了，可以看出这个品牌的成长速度确实非常快。目前，影驰只是生产和销售 nVIDIA 芯片的显卡，之前有消息说会推出 ATI 显卡品牌，但后来也没了消息。

### 1.5.10 讯景

讯景（XFX）公司的网址为 <http://www.xfx.com.cn>。

讯景公司隶属于松景集团。松景集团成立于 1991 年，其旗下的 XFX 品牌显卡畅销于欧美计算机市场，在欧美 2002 年全年的显卡销量成绩排名第三。在国内市场，松景一直致力



于 OEM 业务，成为许多品牌计算机的首席显卡供应商，在业界做出了相当出色的成绩。在 2003 年，随着 GeForceFX 系列图形芯片的发布，松景携其 XFX 品牌登陆国内 DIY 市场。十年磨一剑，今朝把示君。XFX 向国内游戏玩家展示了具欧美大气风格的全系列 nVIDIA 显卡及 Personal Cinema 产品，形成了高、中、低端全面铺开的阵型，满足了不同的消费层次。作为 nVIDIA 的主力发布伙伴之一，XFX 是最早把 nVIDIA 最新显卡产品带入国内市场的显卡厂商。并且依靠自身强大的研发实力，研制出了一批“精品工程”，为国内显卡市场注入了一股新鲜血液，市场反映热烈，被广大 3D 爱好者所推崇。伴随着 2004 年 XFX 的中文名称“讯景”正式启用，XFX 讯景将进一步把“显卡玩家，玩家显卡”的理念深植国内 DIY 市场，带来更多更好人性化的显卡产品。



## 结语

从现在的显卡市场来看，虽然竞争也非常激烈，但显示芯片厂商基本上是 nVIDIA 与 ATI 两家的天下，而且产品的挖掘潜力不是很大，更多意义上是厂商与厂商之间的竞争，莫非就是换换版型，对比对比散热器而已。不过这样的情况很不乐观，相对于之前来说，提供显示芯片的厂商少了很多，而显卡厂商却多了很多，这两者完全成反比，而且比例越来越大。

不过，如果没有什么问题的话，Intel 很快将要正式再次进入独立显卡市场了，届时可能会出现三足鼎立的局面。不管怎么样，Intel 加入独立显卡市场对消费者是没有坏处的，所以我们很期待这一天的到来。

### 提示

显卡的 BIOS 除了可以在以上品牌的主页中查找下载外，也可登录以下网站搜索下载。

显卡 BIOS 下载网站：<http://www.techpowerup.com/vgabios/>

迅维网显卡维修：<http://www.chinafix.com/forum-28-1.html>

## 第 2 章

# 显卡电路原理

- ◎ 工作原理
- ◎ 供电电路
- ◎ GPIO、显存电路
- ◎ BIOS 电路
- ◎ 接口电路
- ◎ 其他电路



## 2.1 工作原理

我们在显示屏上看到的图像是由很多个小点组成的，这些小点称为“像素”。在最常用的分辨率设置下，屏幕显示一百多万个像素，计算机必须决定如何处理每个像素，以便生成图像。为此，它需要一位“翻译”，负责从CPU获得二进制数据，然后将这些数据转换成人眼可以看到的图像。除非计算机的主板内置了图形功能，否则这一转换是在显卡上进行的。

显卡的工作非常复杂，但其原理和部件很容易理解。

显卡内部工作原理如图2-1所示，GPU是主要部分，通过AGP/PCI-E总线完成与CPU之间的通信，控制板上的显存工作，通过DAC电路输出R、G、B、HS、VS信号。

工作过程：GPU→显存→RAMDAC→显示器

数据离开CPU，必须通过4个步骤，才会到达显示屏。

(1) 从总线进入GPU——将CPU送来的数据送到GPU里面进行处理。

(2) 从GPU进入显存——将芯片处理完的数据送到显存。

(3) 从显存进入DAC——由显存读取出数据再送到RAMDAC(随机读/写存储数模转换器)将数据从数字信号转换成模拟信号。

(4) 从DAC进入显示器——将转换完的模拟信号送到显示屏。

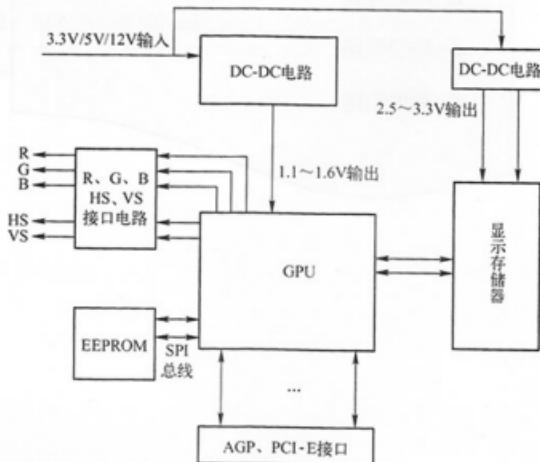


图2-1 显卡内部工作原理



RV630 内部架构图如图 2-2 所示。

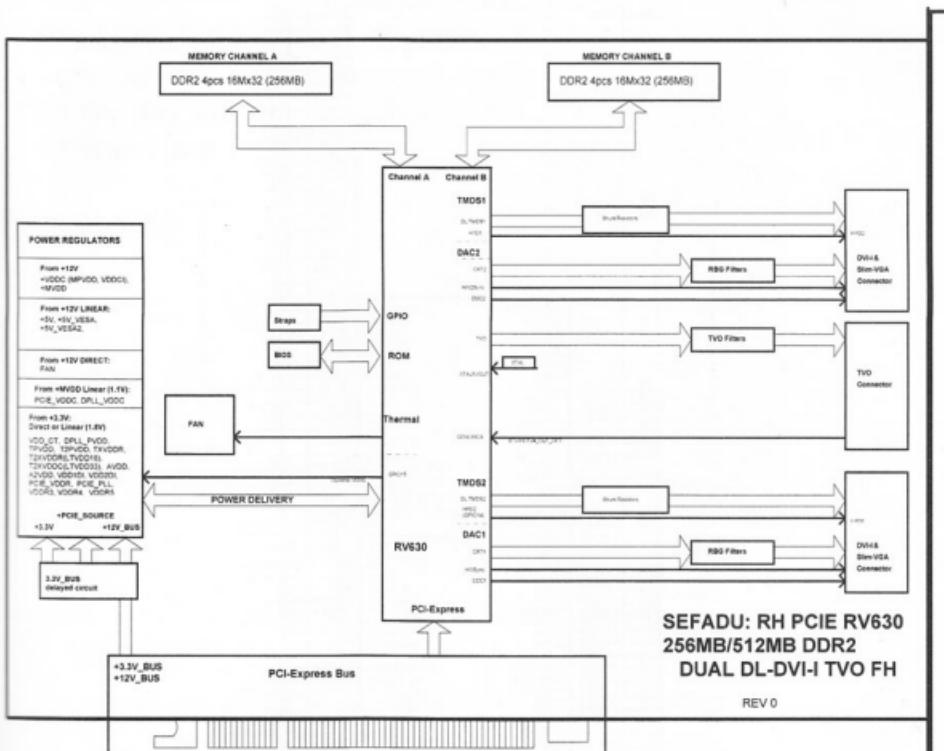


图 2-2 RV630 内部架构图

## 2.2 供电电路

### 2.2.1 供电来源

绝大多数显卡是由主板上的 AGP/PCI-E 插槽供电的，本身没有电源补充，也没有电池等来供应所需的工作电能，而是由显卡上的金手指通过计算机主板的插槽来获得所需的电量。

#### 1. AGP 显卡供电

AGP 插槽定义如图 2-3 所示，供电脚如下。

+12V: A1

+5V: B2、B3

+3.3V: B9、A9、B16、A16、B28、A28

VDDQ: A34、B34、A40、B40、B47、A52、B52、A58、B58、A64、B64

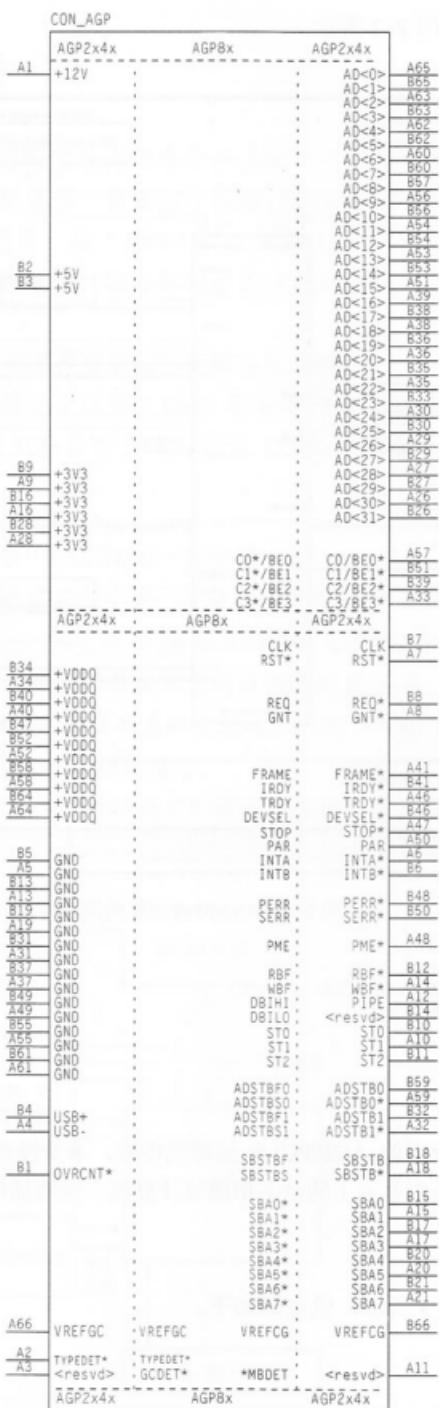


图 2-3 AGP 插槽定义



## 2. PCI-E 显卡供电

PCI-E 插槽定义如图 2-4 所示，供电脚如下。

+12V: A2、A3、B1、B2、B3

+3.3V: A9、A10、B8

+3.3Vaux: B10

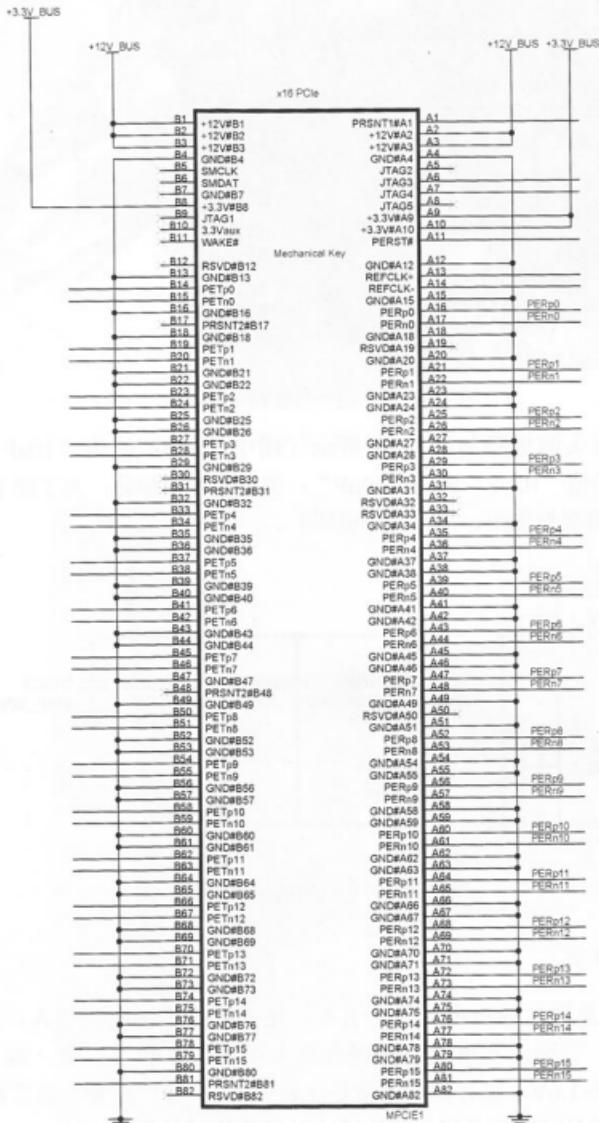


图 2-4 PCI-E 插槽定义



对于部分高端显卡产品因为耗电很厉害，通过主板上的插槽供电已不能满足显卡的要求，于是，人们又想到直接由 PC 电源引入一组插头来为显卡供电。显卡的多个外接辅助电源插头如图 2-5 所示。

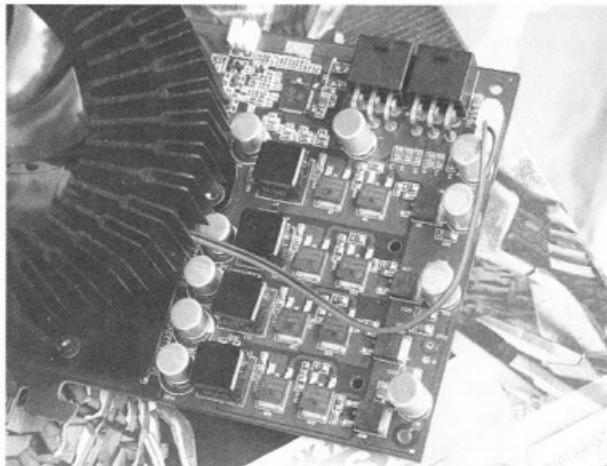


图 2-5 显卡的外接辅助电源插头

外接辅助电源插头的电路如图 2-6 所示（图中 C1612 的值“10uF”根据国标应为“ $10\mu F$ ”，MC1605 的值“10UF”应为“ $10\mu F$ ”，但因为原图如此，为了便于读者查阅，本书不再改。全书还有很多类似图形，不再一一说明）。

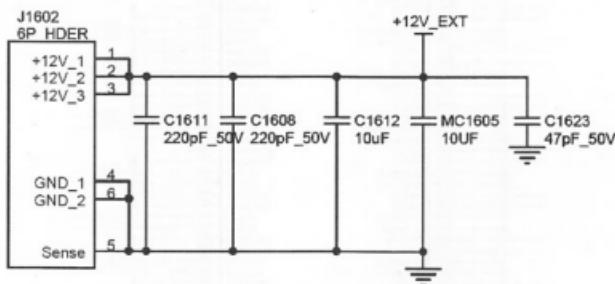


图 2-6 外接辅助插头的电路

## 2.2.2 供电方式

显卡的供电无论是通过插槽由主板上引入，还是直接外接电源引入，这些电源主要为 $+3.3V$ 、 $+5V$  及 $+12V$  三种，不可能正好符合显卡正常工作的电压值，因为一块显卡正常 GPU 核心供电是 $1.1\sim1.6V$ ，显存供电正常是 $1.8\sim3.3V$ ，接口部分有的需要 $+3.3V$ ，有的需要 $+5V$ ，各不相同，于是这就涉及显卡上直流电源模块的设计问题。

直流电源模块的基本工作原理：当输入端的电压发生变化时，它都能稳定地输出一个预



先设计的平滑的电压值，并可带动一定的负载。

显卡上的直流电源模块通常分三大类：三端稳压方式、MOS 线性降压方式和开关电源方式。它们的工作模式都是采取降压工作模式，即输出端电压要低于输入端。

### 1. 三端稳压电源方式

采用三端稳压电源方式的芯片有 1117、7805 等（见图 2-7）。此方式电路简单，但提供的电流比较小。一般数模转换电路供电 DAC（见图 2-8）和接口部分电路供电 DDC5V 采用此种方式。

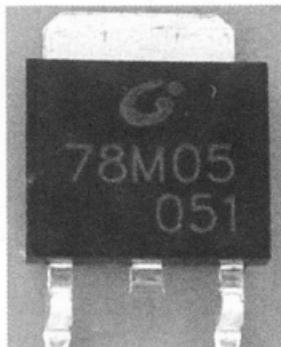


图 2-7 78M05

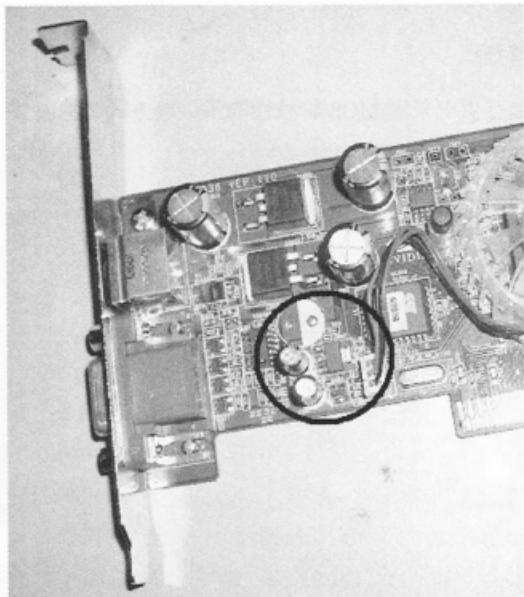


图 2-8 采用 1117 降压的 DAC 供电



1117 等三端稳压元件工作原理：3 脚为电压输入，2 脚为输出，1 脚为调整。1117 工作原理图如图 2-9 所示，只需改变图中 ER304 与 ER305 的阻值比例即可改变 VOUT 大小。

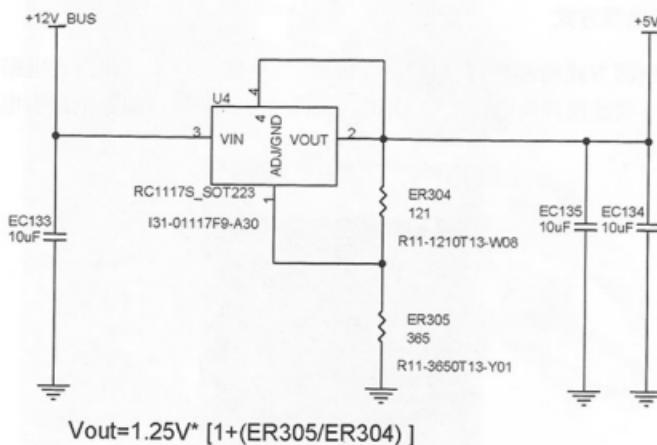


图 2-9 1117 工作原理图

DDC\_5V 供电一般由正电压稳压器 78L05 产生。它的 3 脚输入 12V，2 脚接地，1 脚固定输出 5V。

## 2. MOS 管线性降压

一般低端显卡的显存供电采用 MOS 管线性降压供电方式（见图 2-10）。

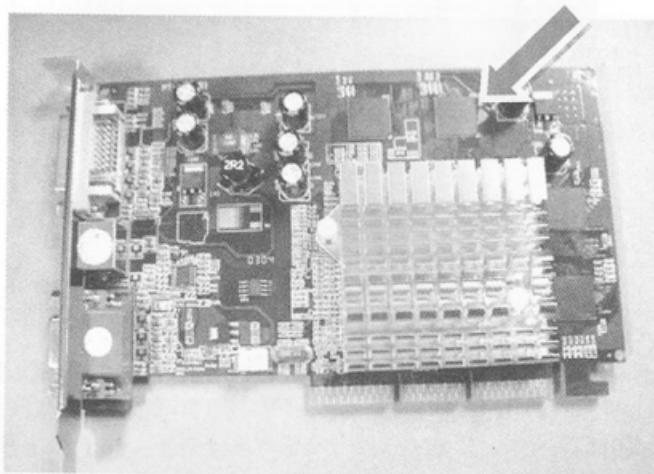


图 2-10 低端显卡显存供电



N 沟道 MOS 管特性：G 极电压越高，D-S 极导通程度越强。

图 2-11 所示的 MOS 管线性降压电路图中，控制芯片 18 脚发出信号驱动 Q800 和 Q801，使 AGP 3.3V 降压为 FBVDDQ 2.5V。R810 和 R811 为反馈，改变它们的大小比例可以调整输出的大小。

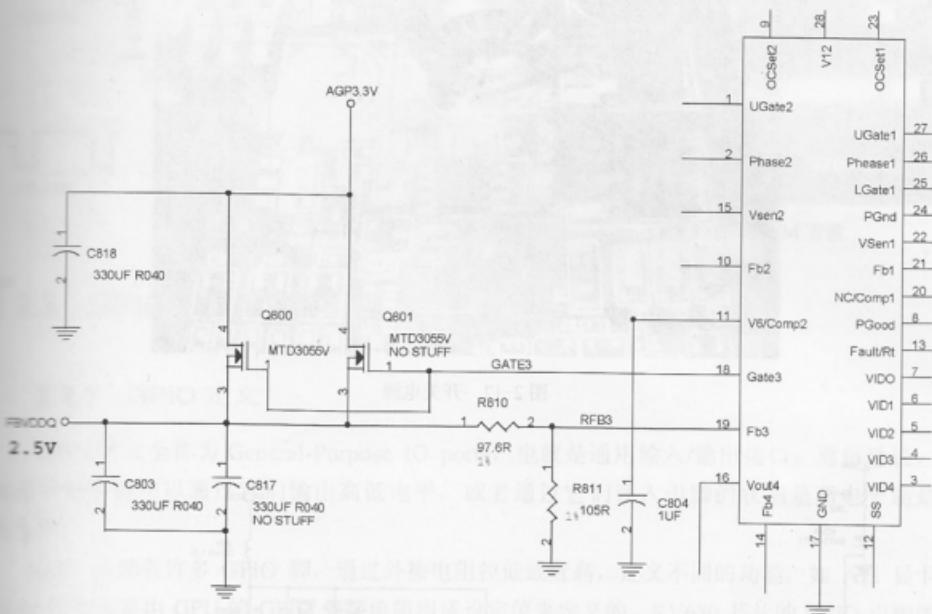


图 2-11 MOS 管线性降压电路图

### 3. 开关电源方式

大多数显卡核心供电和高端卡的显存供电采用开关电源方式。

对于高端显卡由于工作频率逐步提升，使得前两种供电方式无法承受更多的负载工作，工作时容易发生死机情况，因而逐步被开关电源供电方式取代。开关电源是利用现代电力电子技术，控制开关管开通和关断的时间比率，维持稳定输出电压的一种电源。开关电源一般由脉冲宽度调制（PWM）控制 IC 和 MOSFET 构成。

传统的 PWM+MOS+线圈+电容组成的开关电源供电电路实物如图 2-12 所示。

开关电源供电电路图如图 2-13 所示，其中 8 脚芯片 EMU31 为 PWM 主控芯片，EQ28 我们习惯称做上管或高端管，EQ31 为下管或低端管，当 PWM 芯片工作条件满足后，控制上管、下管轮流工作，输出相应电压。（图中电阻 ER6 的标注为“19K”，按国标应为“19k”，但为了与原图一致，便于读者查阅，本书不再改正。本书还有很多类似图形，不再一一说明。）

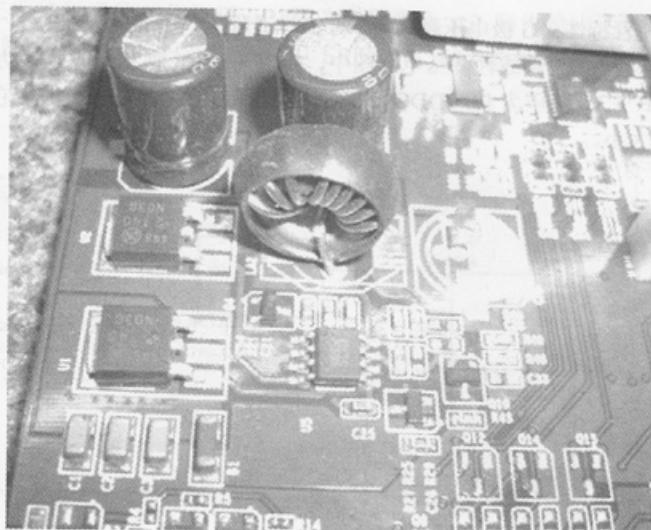


图 2-12 开关电源

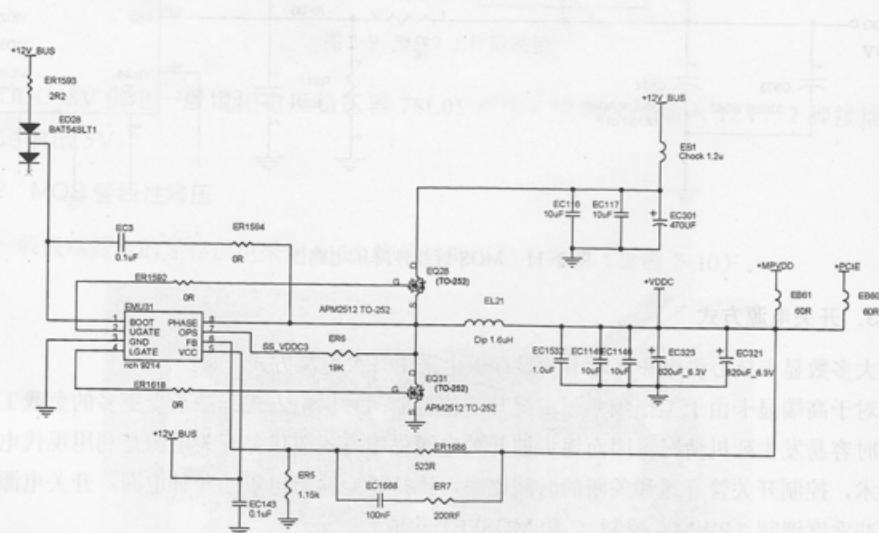


图 2-13 开关电源供电电路图

**开关电源工作原理：**PWM 是控制 MOSFET 的高速开关来调节电压，当开关打开时电压上升，而关闭时则电压下降，利用电感电容蓄电元件，电压上升及下降的时间，高速的切换开和关的时间，控制电压的准位。如图 2-14 所示， $T$  代表一个周期，而  $T_1$  为开启状态， $T_2$  为关闭状态，只要控制  $T_1$  和  $T_2$  的时间（占空比）就可控制电压的高低。

使用示波器可以探测到如图 2-15 所示的方波。

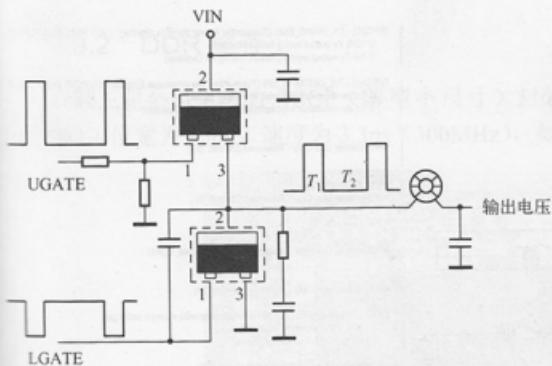


图 2-14 PWM 原理图

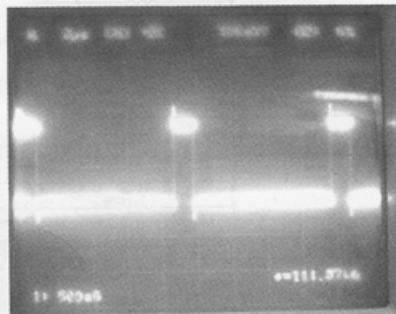


图 2-15 PWM 方波

## 2.3 GPIO、显存电路

### 2.3.1 GPIO 定义

GPIO 英文全称为 General-Purpose IO ports，也就是通用输入/输出接口。通俗地说，就是一些引脚可以通过它们输出高低电平，或者通过它们读入引脚的状态是高电平还是低电平。

GPU 内部有许多 GPIO 脚，通过外接电阻拉低或置高，定义不同的功能，如 ATI 显卡 ROM 的型号是由 GPU 的 GPIO 外接电阻组成设定值来定义的。RV630 芯片的 GPIO 引脚图如图 2-16 所示，相应的设定说明图如图 2-17 所示。

RV630		CrossFire	
General Purpose I/O	GPIO_0 GPIO_1 GPIO_2 GPIO_3 GPIO_4 GPIO_5 GPIO_6	GPIO_0 GPIO_1 GPIO_2 GPIO_3 GPIO_4 GPIO_5 GPIO_6	
	GPIO_7_BLO_N GPIO_8_ROMSO GPIO_9_ROMSI GPIO_10_ROMSCK GPIO_11 GPIO_12 GPIO_13	GPIO_7 GPIO_8 GPIO_9 GPIO_10 GPIO_11 GPIO_12 GPIO_13	FLOW_CONTROL_1 - Lower Cable FLOW_CONTROL_2 - Upper Cable SWAP_LOCK_1 - Lower Cable SWAP_LOCK_2 - Upper Cable
	GPIO_14_HPD2 GPIO_15_PVRCNTL_0 GPIO_16_SSIN GPIO_17_THERMAL_INT GPIO_18_HPD3 GPIO_19_CTFB GPIO_20_PVRCNTL_1 GPIO_21_BB_EN GPIO_22_ROMCSB GPIO_23_CLKRECB GPIO_24_J_MODE GPIO_25_TDI GPIO_26_TCK GPIO_27_TMS GPIO_28_TDO	GPIO_7 GPIO_8 GPIO_9 GPIO_10 GPIO_11 GPIO_12 GPIO_13 GPIO_14 GPIO_15 GPIO_16 ThermINT AE5 AE4 AE3 AE2 AE1 AD3 AD2 AD1 AD0 AB3 AB2 AB1 AB0 AF5 AF4 AF3 AF2 AF1 AF0 AA7 AA6 AA5 AA4 AA3 AA2 AA1 AA0 AB7 AB6 AB5 AB4 AB3 AB2 AB1 AB0 AA9 AA8 AA7 AA6 AA5 AA4 AA3 AA2 AA1 AA0	HPD2 PWRCTRL_0 PWRCTRL_1 ThermINT CTFb CTFb PWRCTRL_0 PWRCTRL_1 GPIO21_BB_EN GPIO22 PCIE_CLK_REQb JTAG_MODE TP51 TP50 TP50 +3.3V BUO TR50 10K TP50 TP50 MRS5 1K TP50

图 2-16 RV630 芯片的 GPIO 引脚图



图 2-17 RV630 芯片的 GPIO 引脚相应的设定说明图



### 2.3.2 DDR 显存

一颗三星公司生产的 TSOP (薄型小尺寸) 封装 DDR 显存颗粒，单颗容量为 128Mb (16MB)，位宽为 16bit，速度为 3.3ns (300MHz)，如图 2-18 所示。

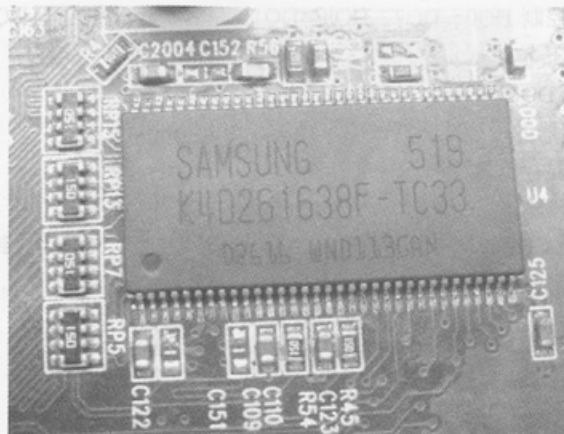


图 2-18 三星 DDR 显存

#### 1. TSOP 封装 DDR 显存脚位定义

DDR 显存颗粒的脚位定义如图 2-19 所示。

x4	x8	x16		x16	x8	x4
VDD	VDD	VDD	1	66	VSS	VSS
NC	DQ0	DQ0	2	65	DQ15	NC
VDDQ	VDDQ	VDDQ	3	64	VSSQ	VSSQ
NC	NC	DQ1	4	63	DQ14	NC
DQ0	DO1	DQ2	5	62	DQ13	DQ6
VSSQ	VSSQ	VSSQ	6	61	VDDQ	VDDQ
NC	NC	DQ3	7	60	DQ12	NC
NC	DQ2	DQ4	8	59	DQ11	DQ5
VDDQ	VDDQ	VDDQ	9	58	VSSQ	VSSQ
NC	NC	DQ5	10	57	DQ10	NC
DQ1	DQ3	DQ6	11	56	DQ9	DQ2
VSSQ	VSSQ	VSSQ	12	55	VDDQ	VDDQ
NC	NC	DQ7	13	54	DQ8	NC
NC	NC	NC	14	53	NC	NC
VDDQ	VDDQ	VDDQ	15	52	VSSQ	VSSQ
NC	NC	LDQS	16	51	UDQS	DQS
NC	NC	NC	17	50	NC	NC
VDD	VDD	VDD	18	49	VREF	VREF
NC	NC	NC	19	48	VSS	VSS
NC	NC	LDM	20	47	UDM	DM
/WE	/WE	/WE	21	46	/CK	/CK
/CAS	/CAS	/CAS	22	45	CK	CK
/RAS	/RAS	/RAS	23	44	CKE	CKE
/CS	/CS	/CS	24	43	NC	NC
NC	NC	NC	25	42	NC	NC
BA0	BA0	BA0	26	41	A11	A11
BA1	BA1	BA1	27	40	A9	A9
A10/AP	A10/AP	A10/AP	28	39	A8	A8
A0	A0	A0	29	38	A7	A7
A1	A1	A1	30	37	A6	A6
A2	A2	A2	31	36	A5	A5
A3	A3	A3	32	35	A4	A4
VDD	VDD	VDD	33	34	VSS	VSS

图 2-19 DDR 显存颗粒的脚位定义



DQ0~DQ7: 数据线, 与 GPU 之间数据传输, 当 LDM 状态线有效时 DQ0~DQ7 有效。

DQ8~DQ15: 数据线, 与 GPU 之间数据传输, 当 UDM 状态线有效时 DQ8~DQ15 有效。

LDM、UDM: 控制 DQ0~DQ7、DQ8~DQ15 是否有效, 相当于 DQ0~DQ7 在传输数据时 DQ8~DQ15 不传输数据。

LDQS、USQS: DQ0~7、DQ8~DQ15 数据选通。

A0~A11: 存储器的地址线。同一通道地址线是共用的。

VDD/ VDDQ: 显存电源。

VREF: 参考电压输入, VDDQ 经两个相同阻值电阻分压而来。

CK、/CK、CKE: CK、/CK 为数据写入和读出时钟控制; CKE 为时钟输入线。

/CS: 芯片选择信号, 决定 CK、/CK、CKE、LDM、UDM 是否有效。

(注: x4、x8、x16 分别表示 4 位、8 位、16 位显存的脚位定义。)

## 2. MBGA 封装 DDR 显存脚位定义

单颗宽 32bit 的 MBGA 封装 DDR 显存脚位定义图如图 2-20 所示。

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
A														
B		DQ50	DQ0	VSSQ	DQ3	DQ2	DQ0	DQ31	DQ29	DQ28	VSSQ	DM3	DQS3	
C		DQ4	VDDQ	NC	VDDQ	DQ1	VDDQ	VDDQ	DQ30	VDDQ	NC	VDDQ	DQ27	
D		DQ6	DQ5	VSSQ	VSSQ	VSSQ	VDD	VDD	VSSQ	VSSQ	VSSQ	DQ26	DQ25	
E		DQ7	VDDQ	VDD	VSS	VSSQ	VSS	VSS	VSSQ	VSS	VDD	VDDQ	DQ24	
F		DQ17	DQ16	VDDQ	VSSQ	VSS Thermal	VSS Thermal	VSS Thermal	VSS Thermal	VSSQ	VDDQ	DQ15	DQ14	
G		DQ19	DQ18	VDDQ	VSSQ	VSS Thermal	VSS Thermal	VSS Thermal	VSS Thermal	VSSQ	VDDQ	DQ13	DQ12	
H		DQS2	DM2	NC	VSSQ	VSS Thermal	VSS Thermal	VSS Thermal	VSS Thermal	VSSQ	NC	DM1	DQS1	
J		DQ21	DQ20	VDDQ	VSSQ	VSS Thermal	VSS Thermal	VSS Thermal	VSS Thermal	VSSQ	VDDQ	DQ11	DQ10	
K		DQ22	DQ23	VDDQ	VSSQ	VSS	VSS	VSS	VSS	VSSQ	VDDQ	DQ9	DQ8	
L		/CAS	/WE	VDD	VSS	A10	VDD	VDD	NC <sup>2</sup>	VSS	VDD	NC	NC	
M		/RAS	NC	NC	BA1	A2	A11	A9	A5	NC <sup>3</sup>	CLK	/CLK	MCL, DSF	
N		/CS	NC	BA0	A0	A1	A3	A4	A6	A7	A8/AP	CKE	VREF	
P														

图 2-20 MBGA 封装 DDR 显存颗粒脚位定义图



### 2.3.3 DDR2 显存

三星公司生产的 DDR2 颗粒，容量 256Mb (32MB)，位宽 16bit，速度 2.5ns (400MHz)，如图 2-21 所示。



图 2-21 三星 DDR2 显存

#### 1. DDR2 显存脚位定义

K4N56163QG 256M gDDR2 显存脚位定义顶视图如图 2-22 所示。

1	2	3		7	8	9	
VDD	NC	VSS	A	VSSQ	UDQS	VDDQ	
UDQ6	VSSQ	UDM	B	UDQS	VSSQ	UDQ7	
VDDQ	UDQ1	VDDQ	C	VDDQ	UDQ0	VDDQ	
UDQ4	VSSQ	UDQ3	D	UDQ2	VSSQ	UDQ5	
VDD	NC	VSS	E	VSSQ	LDQS	VDDQ	
LDQ6	VSSQ	LDM	F	LDQS	VSSQ	LDQ7	
VDDQ	LDQ1	VDDQ	G	VDDQ	LDQ0	VDDQ	
LDQ4	VSSQ	LDQ3	H	LDQ2	VSSQ	LDQ5	
VDDL	VREF	VSS	J	VSSDL	CK	VDD	
	CKE	WE	K	RAS	CK	ODT	
NC	BA0	BA1	L	CAS	CS		
	A10	A1	M	A2	A0	VDD	
VSS	A3	A5	N	A6	A4		
	A7	A9	P	A11	A8	VSS	
VDD	A12	NC	R	NC	NC		

图 2-22 K4N56163QG 256M gDDR2 显存脚位定义顶视图



## 2. 三星 K4N56163QG 引脚定义

**CK、 $\overline{CK}$** : 时钟。CK 和  $\overline{CK}$  是差分时钟输入。CMD、ADD 输入在 CK 上升沿和  $\overline{CK}$  下降沿交叉处采样。输出（读）数据在 CK 和  $\overline{CK}$  交叉点（两个不同交叉方向）引用。

**CKE**: 时钟启用。CKE 为高电平启用内部时钟信号和设备的输入缓冲器和输出驱动器，为低电平停用内部时钟信号和设备的输入缓冲器和输出驱动器。

**CS**: 片选。当 CS 记录为高电平时所有命令被屏蔽。在系统具有多个 Bank 时，CS 提供对外部 Bank 的选择。CS 也被认为是命令代码的一部分。

**ODT**: 芯片内终结。ODT 置高开启内部终端电阻到 gDDR2 SDRAM。当启用时，在 x16 的配置时 ODT 仅用于 DQ、UDQS/ $\overline{UDQS}$ 、LDQS、 $\overline{LDQS}$ 、UDM 和 LDM 信号。如果编程禁用扩展模式寄存器（EMRS）ODT，ODT 引脚将被忽略。

**RAS、 $\overline{CAS}$ 、 $\overline{WE}$** : 命令输入。 $\overline{RAS}$ 、 $\overline{CAS}$  和  $\overline{WE}$ （与  $\overline{CS}$ ）定义为输入命令。

**LDM、UDM**: 输入数据掩码。LDM、UDM 是一种写数据输入掩码信号。在写访问期间，LDM、UDM 为采样高与输入数据相关联，输入数据是被掩码了的。LDM、UDM 在 DQS 的两个边采样。虽然 LDM、UDM 引脚是只用于输入，但是 LDM、UDM 加载与 DQ 和 DQS 加载相匹配。UDM 控制高字节，LDM 控制低字节。

**BA0~BA1**: Bank 地址输入。BA0 和 BA1 定义哪个 Bank 被激活、读、写或者使用预充电命令。在 MRS 期间或者在 EMRS 周期，BA0 还决定是否访问模式寄存器或者扩展模式寄存器。

**A0~A12**: 地址输入。对激活命令提供行地址、列地址及在相应 Bank 的存储器阵列中去找出一个对应读/写命令的自动预充电位。预充电命令期间采样 A10 来确定预充电是加到一个 Bank (A10 低) 上，还是加到所有的 Bank (A10 高) 上。

**DQ**: 数据输入/输出。双向数据总线。

**LDQS ( $\overline{LDQS}$ )、UDQS ( $\overline{UDQS}$ )**: 数据选通。输出读取数据，输入写入数据。边缘读取数据，中心写入数据。LDQS 对应于 DQ0~DQ7 上的数据，UDQS 对应于 DQ8~DQ15 的数据。数据选通 LDQS 和 UDQS 可用于单端模式或可选的互补配对信号。在读/写期间，LDQS 和 UDQS 为系统提供差分对信号。EMR (1) 控制位启用或禁用所有补偿数据选通信号。

**NC**: 空脚。

**VDDQ**: DQ 供电。1.8V $\pm$ 0.1V 对应-ZC25/2A，或者 2.0V $\pm$ 0.1V 对应-ZC20/22。

**VSSQ**: DQ 接地。

**VDDL**: DLL 供电。1.8V $\pm$ 0.1V 对应-ZC25/2A，或者 2.0V $\pm$ 0.1V 对应-ZC20/22。

**VSSL**: DLL 接地。

**VDD**: 供电。1.8V $\pm$ 0.1V 对应-ZC25/2A，或者 2.0V $\pm$ 0.1V 对应-ZC20/22。

**VSS**: 接地。

**VREF**: 参考电压。



### 2.3.4 DDR3 显存

三星 DDR3 显存，容量 512Mb（64MB），位宽 32bit，速度 1.0ns（1000MHz）如图 2-23 所示。

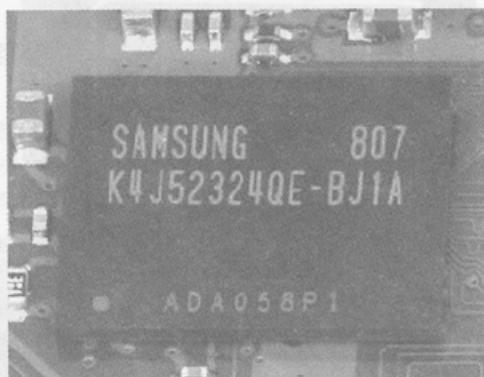


图 2-23 三星 DDR3 显存

#### 1. DDR3 显存脚位定义

DDR3 显存脚位定义顶视图如图 2-24 所示。

A	VDDQ	VDD	VSS	ZQ				MF	VSS	VDD	VDDQ
B	VSSQ	DQ0	DQ1	VSSQ				VSSQ	DQ9	DQ8	VSSQ
C	VDDQ	DQ2	DQ3	VDDQ				VDDQ	DQ11	DQ10	VDDQ
D	VSSQ	WDQS0	RDQS0	VSSQ				VSSQ	RDQS1	WDQS1	VSSQ
E	VDDQ	DQ4	DM0	VDDQ				VDDQ	DM1	DQ12	VDDQ
F	VDD	DQ6	DQ5	CAS#				CAS#	DQ13	DQ14	VDD
G	VSS	VSSQ	DQ7	BA0				BA1	DQ15	VSSQ	VSS
H	VREF	A1	RAS#	CKE				WE#	BA2	A5	VREF
J	VSS	NC	RFU	VDDQ				VDDQ	CK#	CK	VSS
K	VDD	A10	A2	A0				A4	A6	A8/AP	VDD
L	VSS	VSSQ	DQ25	A11				A7	DQ17	VSSQ	VSS
M	VDD	DQ24	DQ27	A3				A9	DQ19	DQ16	VDD
N	VDDQ	DQ26	DM3	VDDQ				VDDQ	DM2	DQ18	VDDQ
P	VSSQ	WDQS3	RDQS3	VSSQ				VSSQ	RDQS2	WDQS2	VSSQ
R	VDDQ	DQ28	DQ29	VDDQ				VDDQ	DQ21	DQ20	VDDQ
T	VSSQ	DQ30	DQ31	VSSQ				VSSQ	DQ23	DQ22	VSSQ
U	VDDQ	VDD	VSS	SEN				RES	VSS	VDD	VDDQ

图 2-24 DDR3 显存脚位定义顶视图



## 2. DDR3 显存焊盘实物图

DDR3 显存焊盘实物如图 2-25 所示。

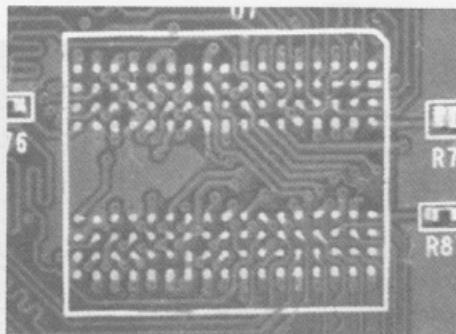


图 2-25 DDR3 显存焊盘实物

## 3. DDR3 引脚说明

**CK、CK#：**时钟。CK 和 CK#是差分时钟输入。所有地址和控制输入信号都在 CK 上升沿和 CK#下降沿交叉处采样。

**CKE：**时钟启用。CKE 为高电平启用内部时钟信号和设备的输入缓冲器和输出驱动器，为低电平停用内部时钟信号及设备的输入缓冲器和输出驱动器。

**CS#：**片选。CS#启用（记录为高）和禁用（记录为低）命令解码器。当 CS#记录为高电平时，所有命令被加掩码。在系统具有多个 Bank 时，CS#提供对外部 Bank 的选择。CS#也被认为是命令代码的一部分。

**RAS#、CAS#、WE#：**命令输入。RAS#、CAS#和 WE#（与 CS#）定义为输入命令。

**DM0~DM3：**输入数据掩码。DM 是一种写数据输入掩码信号。在写访问期间，同时 DM 为高采样，输入数据被隐蔽。DM 在 WDQS 的上升沿和下降沿采样。

**BA0~BA2：**Bank 地址输入。BA0~BA2 定义为哪个 Bank 被激活、读、写或者使用预充电命令。

**A0~A11：**地址输入。

**DQ0~DQ31：**数据输入/输出。

**RDQS0~RDQS3：**读数据选通。RDQS 和读数据是边沿对齐的。

**WDQS0~WDQS3：**写数据选通。WDQS 和读数据是中心对齐的。

**SEN：**扫描启用引脚。逻辑高启用扫描模式。不使用时应该接地。该引脚为 CMOS 输入。

**NC/RFU：**空脚。

**VDDQ、DQ：**供电，+1.8V。

**VSSQ：** DQ 接地。在核心上隔离以便改进噪声性能。

**VDD：**供电，+1.8V。

**VSS：** 接地。



VREF: 参考电压。

MF: 翻盖安装 DRAM 的镜像功能。

ZQ: 自动校准的外部基准引脚。它应该连接到 RQ (=240Ω)。

RES: 复位脚。该引脚为 VDD CMOS 输入。

## 2.4 BIOS 电路

显卡 BIOS 程序烧录在一个 8 脚 EEPROM 芯片内，芯片型号通常为 25 系列。常见容量为 512KB (64KB)，实物图如图 2-26 所示。此芯片工作在 SPI 总线。SPI BIOS 引脚定义如图 2-27 所示。

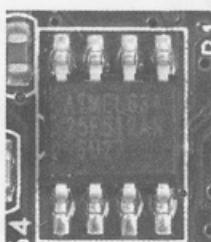


图 2-26 8 脚 EEPROM 芯片实物图

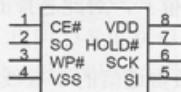


图 2-27 SPI BIOS 引脚定义

EEPROM 与 GPU 通信使用 SPI 总线（见图 2-28）。SPI 是英文 Serial Peripheral Interface 的缩写，中文意思是串行外围设备接口。SPI 是 Motorola 首先在其 MC68HCXX 系列处理器上定义的。SPI 接口主要应用在 EEPROM、Flash、实时时钟、AD 转换器，还有数字信号处理器和数字信号解码器之间。SPI 是一种高速、全双工、同步的通信总线，并且在芯片的引脚上只占用四根线，节约了芯片的引脚，同时为 PCB 的布局上节省空间，提供方便。正是出于这种简单易用的特性，现在越来越多的芯片集成了这种通信协议，如 AT91RM9200。

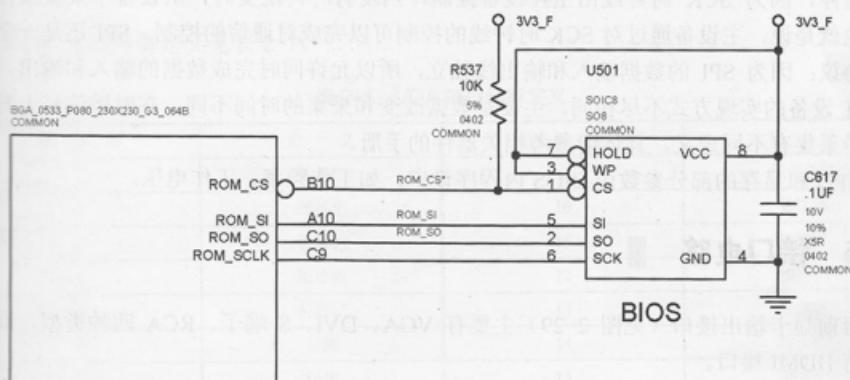


图 2-28 BIOS 与 GPU 间电路图



SPI 总线系统是一种同步串行外设接口，它可以使 MCU 与各种外围设备以串行方式进行通信以交换信息。外围设置 Flash RAM、网络控制器、LCD 显示驱动器、AD 转换器和 MCU 等。SPI 总线系统可直接与各个厂家生产的多种标准外围器件直接接口，该接口一般使用 4 条线：串行时钟线（SCK）、主机输入/从机输出数据线（MISO）、主机输出/从机输入数据线（MOSI）和低电平有效的从机选择线（SS）（有的 SPI 接口芯片带有中断信号线 INT 或 INT，有的 SPI 接口芯片没有主机输出/从机输入数据线）。

SPI 的通信原理很简单，它以主从方式工作。这种模式通常有一个主设备和一个或多个从设备，需要至少 4 根线，事实上 3 根也可以（单向传输时）。这 4 根线也是所有基于 SPI 的设备共有的，它们是 SDI（数据输入）、SDO（数据输出）、SCK（时钟）、CS（片选）。

- (1) SDO：主设备数据输出，从设备数据输入。
- (2) SDI：主设备数据输入，从设备数据输出。
- (3) SCLK：时钟信号，由主设备产生。
- (4) CS：从设备使能信号，由主设备控制。

其中，CS 是控制芯片是否被选中的，也就是说只有片选信号为预先规定的使能信号时（高电位或低电位），对此芯片的操作才有效。这就使在同一总线上连接多个 SPI 设备成为可能。

接下来就负责通信的 3 根线了。通信是通过数据交换完成的，这里先要知道 SPI 是串行通信协议，也就是说数据是一位一位地传输的。这就是 SCK 时钟线存在的原因，由 SCK 提供时钟脉冲，SDI、SDO 则基于此脉冲完成数据传输。数据输出通过 SDO 线，数据在时钟上升沿或下降沿时改变，在紧接着的下降沿或上升沿被读取，完成一位数据传输。输入也使用同样原理。这样，在至少 8 次时钟信号的改变（上升沿和下降沿为一次），就可以完成 8 位数据的传输。

要注意的是，SCK 信号线只由主设备控制，从设备不能控制该信号线。同样，在一个基于 SPI 的设备中，至少有一个主控设备。这样的传输方式有一个优点，与普通的串行通信不同，普通的串行通信一次连续传送至少 8 位数据，而 SPI 允许数据一位一位地传送，甚至允许暂停，因为 SCK 时钟线由主控设备控制，当没有时钟跳变时，从设备不采集或传送数据。也就是说，主设备通过对 SCK 时钟线的控制可以完成对通信的控制。SPI 还是一个数据交换协议：因为 SPI 的数据输入和输出线独立，所以允许同时完成数据的输入和输出。不同的 SPI 设备的实现方式不尽相同，主要是数据改变和采集的时间不同，在时钟信号上升沿或下降沿采集有不同定义，具体请参考相关器件的手册。

GPU 和显存的部分参数由 BIOS 内程序设定，如工作频率、工作电压。

## 2.5 接口电路

目前显卡输出接口（见图 2-29）主要有 VGA、DVI、S 端子、RCA 四种类型，高端显卡还有 HDMI 接口。

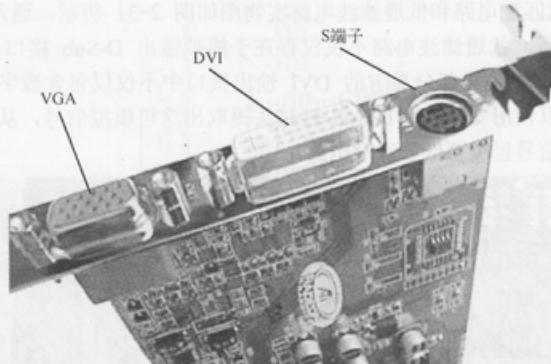


图 2-29 显卡各种输出接口

### 2.5.1 VGA 接口

CRT 显示器因为设计制造上的原因，只能接受模拟信号输入，这就需要显卡能输出模拟信号。VGA（Video Graphics Array，视频图形阵列）接口，也叫 D-Sub 接口，作用是将转换好的模拟信号输出到 CRT 或者 LCD 显示器中。虽然液晶显示器可以直接接收数字信号，但很多低端产品为了与 VGA 接口显卡相匹配，因而采用 VGA 接口。VGA 接口是一种 D 型接口，上面共有 15 针孔，分成三排，每排五个。VGA 接口是显卡上应用最为广泛的接口类型。绝大多数显卡都带有这种输出接口。VGA 接头实物图如图 2-30 所示。

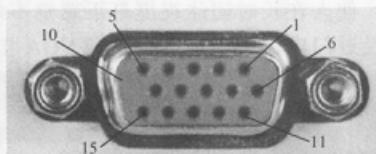


图 2-30 VGA 接头实物图

VGA 接口针脚定义见表 2-1。

表 2-1 VGA 接口针脚定义

针脚号	定义	针脚号	定义
1	红基色	9	保留脚位
2	绿基色	10	数字地
3	蓝基色	11	地址码
4	地址码	12	地址码
5	自测试	13	行同步
6	红地	14	场同步
7	绿地	15	地址码
8	蓝地		



VGA 电路阻抗匹配电路和低通滤波电路实物图如图 2-31 所示，通常该电路位于 VGA 模拟输出接口的背后。低通滤波电路不仅仅存在于模拟输出 D-Sub 接口处，在 S-Video 和 DVI 背后一般也会存在。大部分显卡的 DVI 输出接口中不仅仅包含数字信号，还会包含有一组模拟信号，可以使用 DVI 转 D-Sub 转接头提取出这组模拟信号，从而实现双模拟显示器支持，这组模拟信号也需要低通滤波电路。

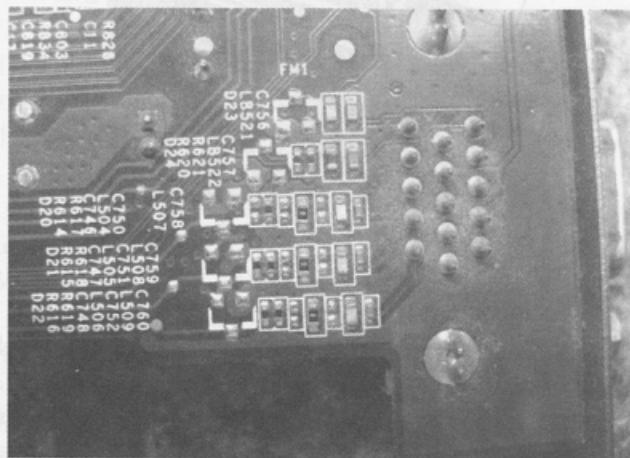


图 2-31 阻抗匹配和低通滤波电路实物图

完整的低通滤波电路，能保证显卡在大分辨率下仍能保持比较清晰，另外能保证色彩的色泽和文本的锐度，使人在长时间注视屏幕下感觉不疲劳。

显卡的行场同步信号经过门电路（74HCT08）到 VGA 接口（见图 2-32）。

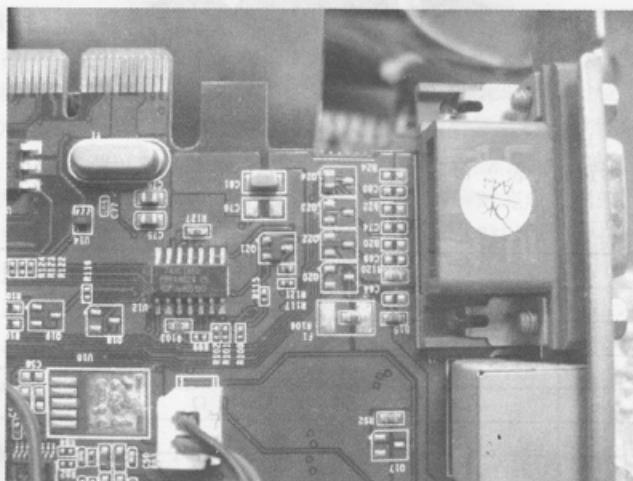


图 2-32 14 脚的门电路 74HCT08

VGA 接口电路图如图 2-33 所示。

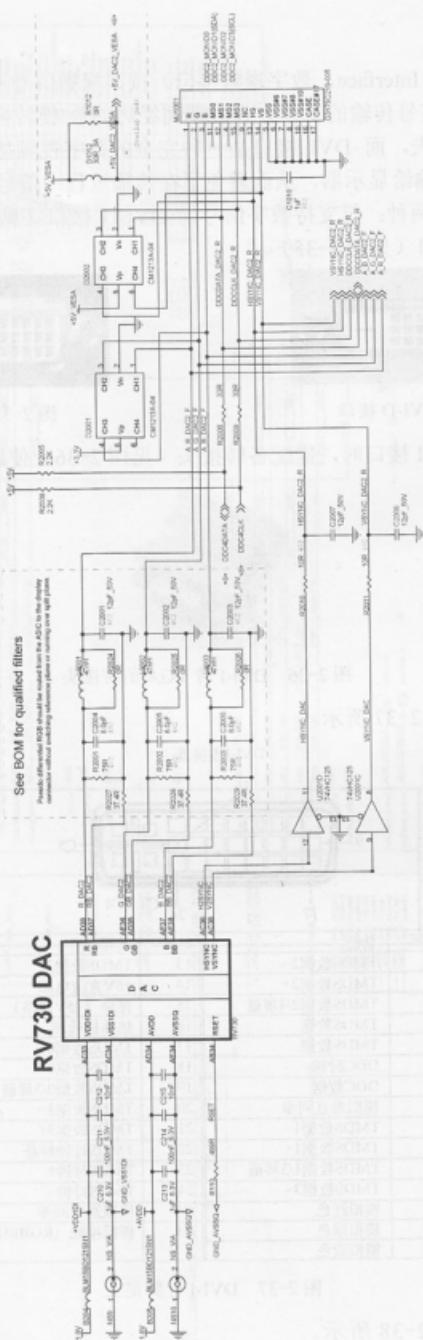


图 2-33 VGA 接口电路图



### 2.5.2 DVI 接口

DVI (Digital Visual Interface, 数字视频接口) 接口视频信号无需转换, 信号无衰减或失真。VGA 是基于模拟信号传输的工作方式, 期间经历的数/模转换过程和模拟传输过程必将带来一定程度的信号损失, 而 DVI 接口是一种完全的数字视频接口, 它可以将显卡产生的数字信号原封不动地传输给显示器, 从而避免了在传输过程中信号的损失。

DVI 接口可以分为两种: 仅支持数字信号的 DVI-D 接口 (见图 2-34) 和同时支持数字和模拟信号的 DVI-I 接口 (见图 2-35)。

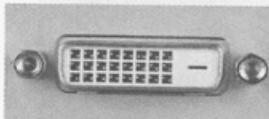


图 2-34 DVI-D 接口



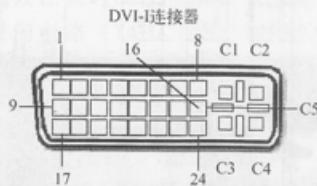
图 2-35 DVI-I 接口

对于显示器设有 DVI 接口时, 需配备转接头 (见图 2-36) 使用。



图 2-36 DVI-I 转 VGA 的转接头

DVI-I 针脚定义如图 2-37 所示。



针脚	功能	针脚	功能
1	TMDS数据2-	13	TMDS数据3+
2	TMDS数据2+	14	+5V直流电源
3	TMDS数据2/4屏蔽	15	接地 (+5V回路)
4	TMDS数据	16	热插拔检测
5	TMDS数据	17	TMDS数据0-
6	DDC时钟	18	TMDS数据0+
7	DDC数据	19	TMDS数据0/5屏蔽
8	模拟垂直同步	20	TMDS数据5-
9	TMDS数据1-	21	TMDS数据5+
10	TMDS数据1+	22	TMDS时钟屏蔽
11	TMDS数据1/3屏蔽	23	TMDS时钟+
12	TMDS数据3-	24	TMDS时钟-
C1	模拟红色	C4	模拟水平同步
C2	模拟绿色	C5	模拟接地 (RGB回路)
C3	模拟蓝色		

图 2-37 DVI-I 针脚定义

DVI 接口电路如图 2-38 所示。

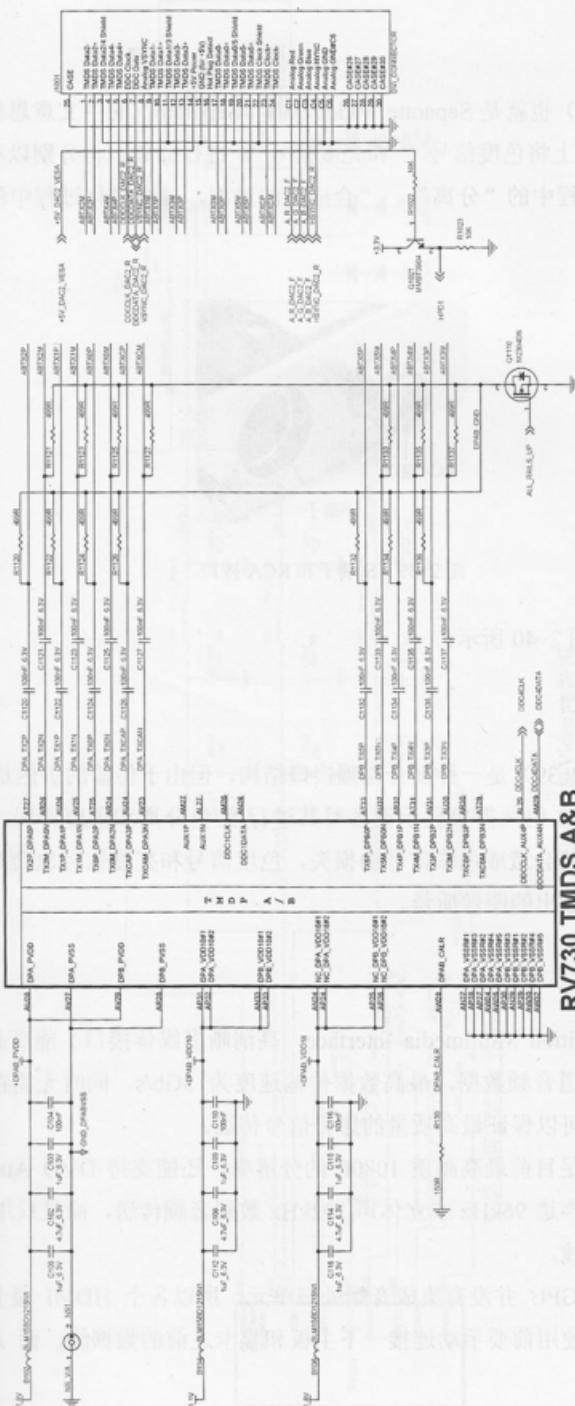


图 2-38 DVI 接口电路

RV730 TMDS A&amp;B



### 2.5.3 S 端子

S 端子（见图 2-39）也就是 Separate Video，而“Separate”的中文意思就是“分离”。它是在 AV 界面的基础上将色度信号 C 和亮度信号 Y 进行分离，再分别以不同的通道进行传输，减少影像传输过程中的“分离”、“合成”的过程，减少转化过程中的损失，以得到最佳的显示效果。



图 2-39 S 端子和 RCA 接口

S-Video 电路图如图 2-40 所示。

### 2.5.4 RCA 接口

RCA 接口（见图 2-39）是一种复合视频接口结构，但由于传输的仍然是一种亮度/色度（Y/C）混合的视频信号，仍然需要显示设备对其进行度/色分离和色度译码才能成像。这种先混合再分离的过程必然会造成色彩信号的损失，色度信号和亮度信号也会有很大的机会相互干扰，从而影响最终输出的图像质量。

### 2.5.5 HDMI

HDMI（High Definition Multimedia Interface，高清晰多媒体接口）能高品质地传输未经压缩的高清视频和多声道音频数据，最高数据传输速度为 5Gb/s，同时无需在信号传送前进行数模或者模数转换，可以保证最高质量的影音信号传送。

HDMI 不仅可以满足目前最高画质 1080P 的分辨率，还能支持 DVD Audio 等最先进的数字音频格式，支持 8 声道 96kHz 或立体声 192kHz 数码音频传送，而且只用一条 HDMI 线连接，免除数字音频接线。

不过，nVIDIA 的 GPU 并没有集成音频处理单元，所以各个 HDMI 显卡厂商都在显卡上设置音频输入接口，使用前要手动连接一下主板和显卡之前的数据线。而 ATI 的 GPU 则没有这种问题。

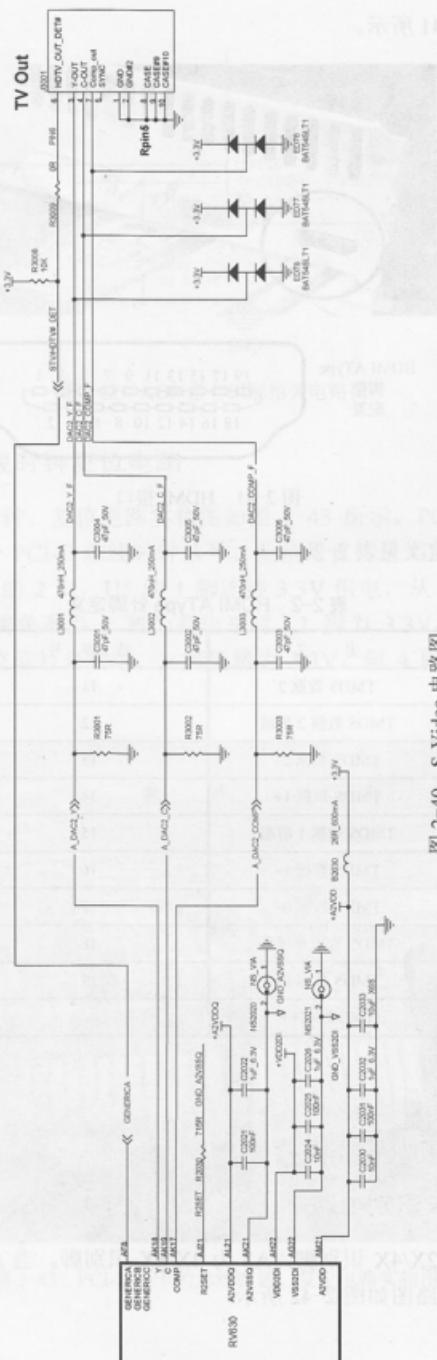


图 2-40 S-Video 电路图



HDMI 接口如图 2-41 所示。

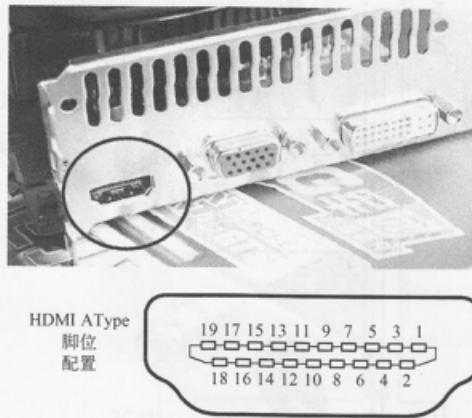


图 2-41 HDMI 接口

HDMI AType 针脚定义见表 2-2。

表 2-2 HDMI AType 针脚定义

针脚号	定义	针脚号	定义
1	TMDS 数据 2	11	TMDS 时钟屏蔽
2	TMDS 数据 2 屏蔽	12	TMDS 时钟 -
3	TMDS 数据 2 -	13	CEC 一种简单的控制总线
4	TMDS 数据 1 +	14	保留脚位
5	TMDS 数据 1 屏蔽	15	串行时钟
6	TMDS 数据 1 -	16	串行数据
7	TMDS 数据 0 +	17	DDC/CEC 地
8	TMDS 数据 0 屏蔽	18	+5V 电源
9	TMDS 数据 0 -	19	热插拔检测
10	TMDS 时钟 +		

## 2.6 其他电路

### 2.6.1 AGP 显卡识别电路

AGP 显卡 A2 脚为 2X/4X 识别脚, A3 为 4X/8X 识别脚。当 A2 接地时, 为 4X; 当 A3 接地时, 为 8X。相关电路图如图 2-42 所示。

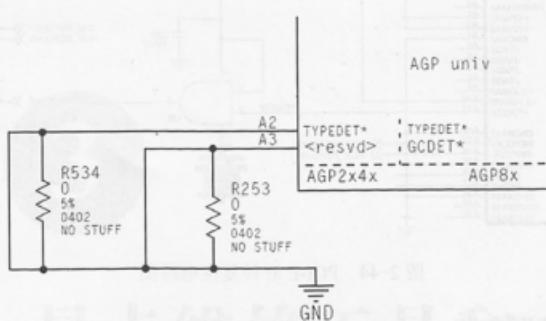


图 2-42 AGP 显卡识别相关电路图

### 2.6.2 PCI-E 总线时钟复位电路

PCI-E 显卡的总线时钟、复位电路实物图如图 2-43 所示。PCI-E 显卡金手指 A13、A14 脚连接主板插槽两个 PCI-E 总线时钟信号，此信号直接进 GPU。金手指 A11 脚连接复位信号，进入与门 U5 的 2 脚，U5 的 1 脚连接 3.3V 供电，从 4 脚输出进入 GPU（见图 2-44）。根据与门逻辑关系当 2 脚为高电平时，1 脚为 3.3V，所以 4 脚也会为高电平。当 2 脚为低电平复位信号有效时，1 脚虽然为 3.3V，但 4 脚同样为低电平，以此完成复位动作。

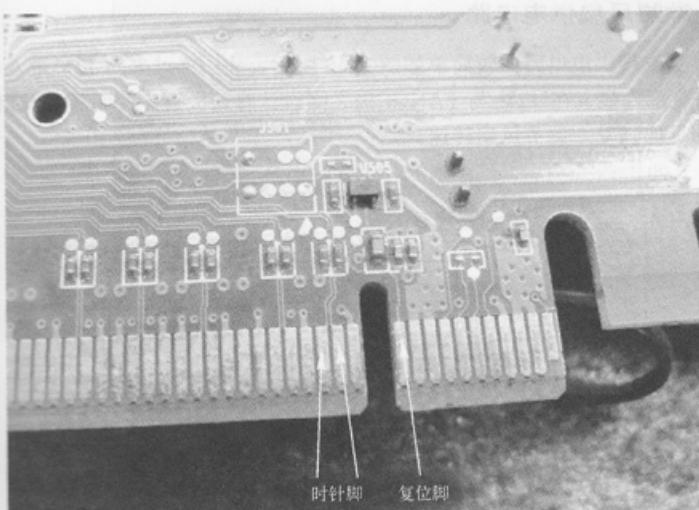


图 2-43 PCI-E 显卡的总线时钟、复位电路实物图

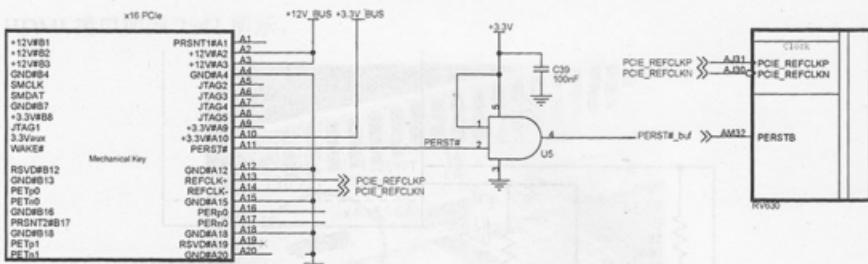


图 2-44 PCI-E 时钟复位电路图

### 2.6.3 显卡晶振电路

显卡有一个 27MHz 晶振，提供时钟信号，电路比较简单，如图 2-45 所示。EY82 为晶振，C86、C85 为谐振电容。（图中 EY82 的标注“27\_MHZ”按照标准标注为“27MHz”更正确，但为了与原图一致，便于读者查阅，本书不再改。全书还有一些类似图形，不再一一说明。）

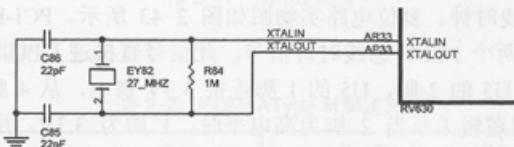


图 2-45 27MHz 晶振电路图

### 2.6.4 散热风扇供电电路

显卡的散热风扇供电电路比较简单如图 2-46 所示。从插槽过来的 12V 进入 FAN 1 脚，2 脚接地。另有部分显卡在 12V 与 FAN 正极之间设计有三极管，控制芯片发出 PWM 信号控制三极管的导通强度，调节风扇转速。

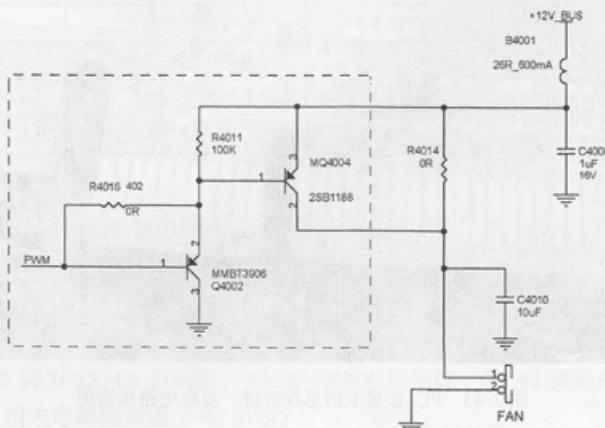


图 2-46 风扇接口电路图

# 第3章

## 显卡维修工具和方法

- ◎ 维修工具
- ◎ 维修方法
- ◎ 无显示的检修
- ◎ 花屏的检修
- ◎ 其他故障检修
- ◎ 显卡 BIOS 刷写



对于显卡所发生的各种故障来说，其检查、维修的方法和步骤，基本上都是相同的。显卡的故障多种多样。排除兼容性问题，将故障类型做简单归纳，显卡的故障主要可分为四大类型：

- 明显的外观性故障
- 无显示
- 花屏
- 缺色、黑屏等其他故障

不管是哪种故障，都必须遵循一定的维修流程：先外观检查，然后上机测试一下，确定故障是否跟客户描述的一致（故障重现）。这一点很重要，如果客户送修花屏的显卡，维修人员看到明显的爆电容，忽略了故障重现的步骤，鲁莽地更换电容后出现不显示的情况，对后续的维修以及跟客户的沟通都非常不利。

在确定好故障现象后，就可以根据各故障现象的检修方法进行维修了。检测和维修显卡，需要用到一些常用设备，本章主要介绍显卡维修需要的工具、显卡的维修方法及常见故障的维修思路。

### 3.1 维修工具

显卡维修需要的工具和软件大概有如下几种。

- 热风焊台
- 恒温烙铁
- 万用表
- 示波器
- BGA 拆焊机
- PCI 显卡
- 主板两块
- 硬盘一块
- 测试软件

#### 3.1.1 热风枪

热风枪也称为热风焊台，是通过热空气加热焊锡来实现焊接功能的。安泰信 852D 数显热风枪如图 3-1 所示，黑盒子里面是一个气泵，气泵的作用是不间断地吹出空气，气流顺着橡皮管流向前面的手柄，手柄里面是发热芯，通电后会发热，里面的气流顺着风嘴出来时就会把热量带出来。

每个热风枪都会配有很多个风嘴，显卡维修常用的是圆孔风嘴。前面板有 1 个电源开关、1 个温度显示屏和两个旋钮：左边旋钮负责调节风速；右边旋钮负责调节温度。



#### 注意

使用之前必须检查机身底部的泵螺丝是否去除，使用后要记得冷却机身。关电后发热管



会自动短暂喷出凉气冷却，这时请不要拔去电源插头，否则会影响发热芯的使用寿命。显卡维修时可以根据个人熟练程度调节风速，注意不要吹飞零件；温度一般调节至370~400℃比较合适。工作时风枪的风嘴和它喷吹的热风温度很高，切勿触摸。替换风嘴时，要等它冷却后才可操作。更多的使用方法和注意事项参照热风枪的使用说明书。



图 3-1 安泰信 852D 数显热风枪

### 3.1.2 恒温烙铁

安泰信 936 恒温烙铁如图 3-2 所示。电源开关在主机右侧，正面为手柄连接和温度调节旋钮，其中刻度圈金色代表摄氏度（℃）。右边为烙铁架用来放置手柄和擦拭烙铁头用的海绵。常用的烙铁头有刀头、尖头、马蹄头等。



图 3-2 安泰信 936 恒温烙铁



## 注意

- (1) 海绵要充分湿水，以拿起来不向下滴水为准。
- (2) 烙铁第一次使用，加温时先将温度设为 200℃ 左右进行预热，当温度达到 200℃ 后，再将温度设为要使用的温度。显卡维修中，一般设置为 370~400℃。
- (3) 使用后，要将烙铁头加上锡，轻轻放在烙铁架上，可以有效保护烙铁头不被氧化，延长烙铁的使用寿命。
- (4) 烙铁头不要接触到塑料、润滑油、橡胶等化合物。使用的锡丝也要有一定的纯度。当烙铁头脏时，只能在海绵上快速擦拭，不可长时间放置于湿水的海绵上。
- (5) 烙铁头切记不能敲。手柄中的发热芯很容易因为敲击而碎裂，导致烙铁不发热。

### 3.1.3 万用表

万用表是电子、电机行业者所必需的仪器，如图 3-3 所示。它主要用来测量电学上的三大要素——电压、电阻、电流，还可以用来测量晶体管、二极管。价格高的万用表可以测量温度、分贝值、频率等。万用表所使用的电压单位是伏特（Volt, V）；电阻单位是欧姆（Ohm, Ω），电流单位是毫安（milli-Ampere, mA）。更多内容请参照具体的产品说明书。



图 3-3 万用表

显卡维修中，万用表常用的挡位有直流 20V 电压挡 、二极管挡 、蜂鸣挡 .

### 3.1.4 示波器

安泰信 1102C 100M 彩色便携式示波器如图 3-4 所示。详细的介绍和使用方法见迅维网示波器板块。

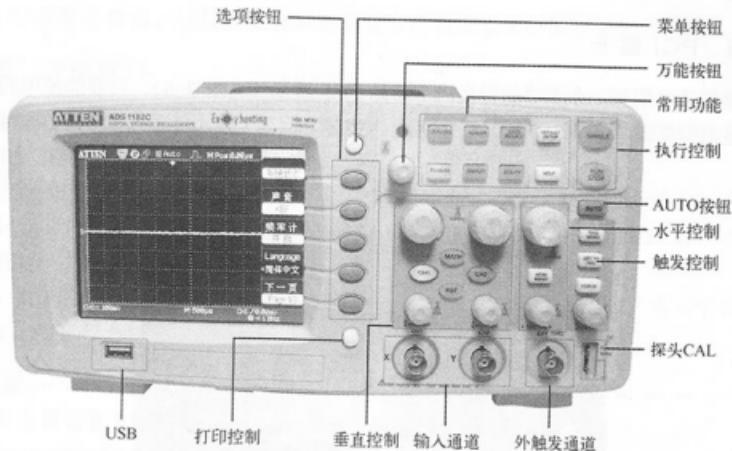


图 3-4 安泰信 1102C 100M 彩色便携式示波器

示波器一般都有一个“**AUTO**”键。无论是量测频率还是 PWM 波形，都可以用 **AUTO** 功能进行自动测量。

### 3.1.5 BGA 拆焊机

显卡的 GPU 都采用 BGA 封装的，这种封装方式用普通的风枪无法进行更换，必须使用 BGA 拆焊机（见图 3-5）。由于 BGA 拆焊机价格比较昂贵，操作比较复杂，这里只作简单介绍。

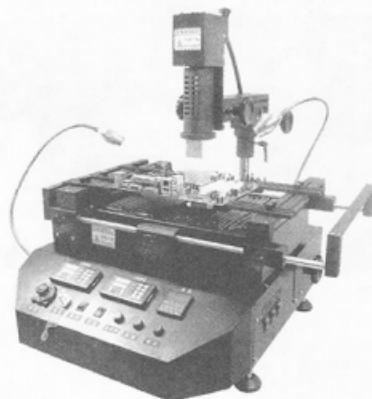


图 3-5 迅维牌 BGA 拆焊机

BGA 拆焊机常见的有两温区和三温区、两温区多数采用上面热风加热和底部暗红外加热，适合拆焊有铅的板卡；三温区在两温区基础上增加了下部热风加热，适合拆焊无铅的板卡。拆焊机是通过温度曲线的智能编程，使温度呈曲线式上升，达到对 BGA 芯片的良好、均匀加热，使之充分融化，实现拆焊目的。



### 3.1.6 PCI 显卡

显卡维修需要用到一个重要的设备，那就是 PCI 显卡（见图 3-6）。只要能使用的 PCI 显卡即可，价格也很便宜。如图 3-7 所示是正在用 PCI 显卡检测一片不能显示的 PCI-E 显卡。

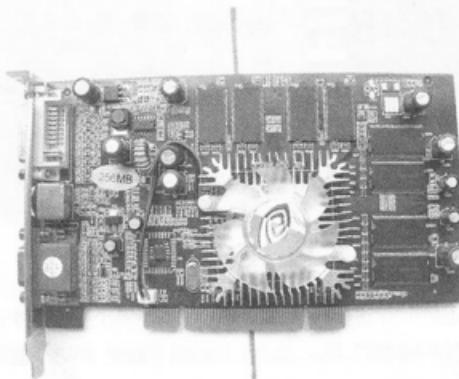


图 3-6 PCI 显卡

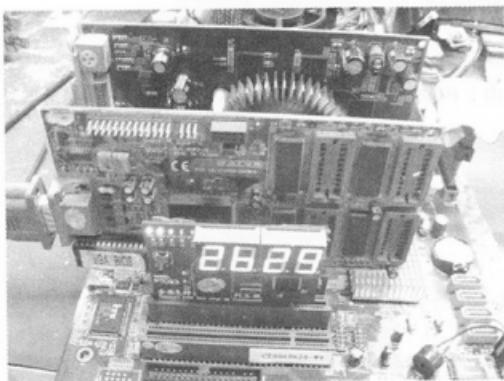


图 3-7 工作中的 PCI 显卡（下面的显卡）

### 3.1.7 主板

显卡维修必须要准备带 AGP 插槽和带 PCI-E 插槽的主板各一片，尽量不要使用 nVIDIA 芯片组的主板。另外，最好制作一个小喇叭，接在 Speaker 插针上。

### 3.1.8 硬盘

准备 10GB 以上 IDE 硬盘一块。将硬盘分为两个 FAT32 格式分区，用来安装操作系统和存放显存测试程序。将 C 盘做成 Windows+DOS 双系统，把显存测试软件和显卡测试程序



3DMARK 等放置在 D 盘，这样分配会避免系统崩溃重做系统后程序丢失等问题。

### 3.1.9 测试软件

目前市场需要维修的卡，主要有 nVIDIA 系列和 ATI 系列，分别对应的显存测试软件是 MATS 和 Rx 系列测试软件，主要用于测试显存数据位的好坏。

MATS 有很多版本。新版本大部分可以兼容旧版本。需要如何选用合适的版本可以在迅维网论坛讨论。Rx 系列测试程序分为 R3MEMID、R5MEMID、R6MEMID 等，不同的核心用不同的程序。最新的 AMD HD 显卡需要使用最新的 STSERVER 测试。

另外，还需要显卡 BIOS 刷写程序 NVFLASH.exe、ATIFLASH.exe（本书中分别改名为 NV577.exe、ATI362.exe）。

#### 提示

下载显存测试软件可以登录迅维网

<http://www.chinifix.com.cn>

## 3.2 维修方法

### 3.2.1 观察法

拿到一块故障显卡，首先要确定用户送修的问题是什么，然后再观察显卡的外观，看有无明显电容鼓包、爆裂，元件烧伤或变色，金手指是否烧坏或者不洁。最重要的就是一定要仔细的观察显卡是否有掉件、断线，多数显卡故障都可以从外观检查中找到问题。一块电容爆了的显卡如图 3-8 所示。

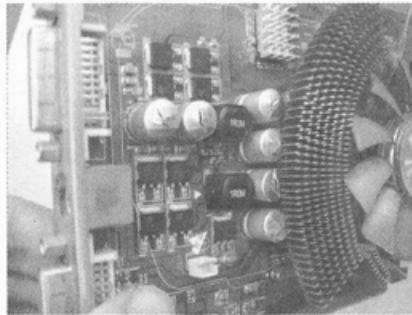


图 3-8 电容爆裂的实物

### 3.2.2 实测法

实测法是通过我们用万用表来对显卡上的电路和信号等进行实地测量的方法，一般采用的有二极体值法、电压法、电阻法 3 种。下面以数字万用表简单介绍三种实测法。



### 1. 测二极体值

测二极体值也叫打阻值，叫法不同而已。测量方法比较简单，把万用表放到二极管挡，红表笔接地，黑表笔接测试点，然后看万用表的读数即可。图 3-9 所示为万用表显示的某二极体值 534。



图 3-9 万用表显示的某二极体值为 534

如果相同显卡，相同测试点的二极体值不同，偏小即为短路，偏大即为开路。

#### 提示

二极值的叫法，是中国台湾的叫法，在中国大陆也并无具体的称呼。由于在指针表时代，万用表这个挡只能测对地电阻，所以，老的叫法是对地打阻值。我们目前维修主板，普遍使用数字表，那么使用二极管挡，即反映电阻也反映压降。因为不好找具体的词来定义，在本书中，各章节中提到的对地阻值、对地数值、接口的数值、二极体值，均是同一个含义。因为这个不等同于电阻，所以后面是没有单位的。

### 2. 电压测试法

电压测试法就是利用万用表的直流电压挡，黑表笔接地，红表笔接测试点，万用表显示的数值即为电压值，如图 3-10 所示。



图 3-10 万用表显示的 11.5V 的直流电压

### 3. 电阻测试法

电阻测试法非常好掌握。如果怀疑显卡上的某个电阻损坏，可以用电阻法测得该电阻的阻值。方法是将万用表的红表笔和黑表笔分别接电阻的两端，万用表读数即该电阻的阻值。



(见图 3-11)。

### 注意

由于万用表是并联在电阻上，有的电阻在线测量出的数值并不准确，所以最好将电阻取下，再对电阻进行测量，这是的读数才是真实的。



图 3-11 万用表显示的  $11.49\text{k}\Omega$  的电阻值

### 3.2.3 加焊法

在显卡上，一些焊点虚焊、假焊都会造成各种故障现象，尤其是 GPU 发热比较大，很容易出现虚焊。加焊处理法是有选择、有目的、有重点地重新熔焊我们所怀疑的一些焊点和 BGA 芯片，这是显卡中最常用的维修方法。一片正在 BGA 拆焊机上加焊的显卡如图 3-12 所示。

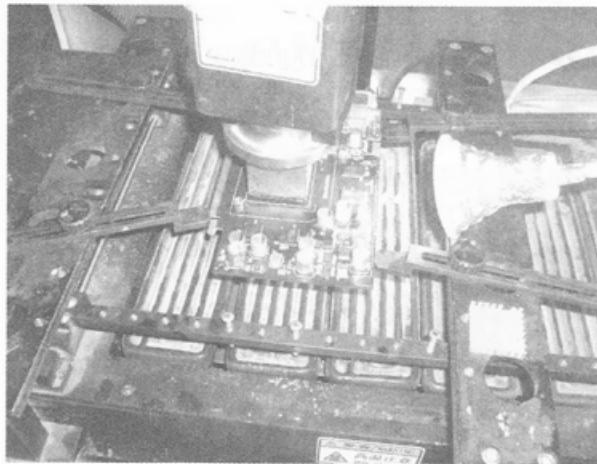


图 3-12 加焊中的显卡

### 3.2.4 比较替换法

比较替换法是利用一片正常工作的同型号显卡作为参照物，运用移植、比较、参照、对比等



手段，查出具体的故障部位，然后对比其二极体值、电压、电阻等参数。当检修到一些故障时，经常要用到比较替换法。通过找一片正常显卡上相同的零件替换我们怀疑损坏的零件，如电源芯片、显存芯片等。如果修复，说明替换成功，这时才需要去采购我们所需要的零件。简单地讲，这个检查方法是通过与一个标准物进行对比，快速找出故障部位，避免了浪费，节省了时间。

### 3.3 无显示的检修

#### 3.3.1 无显示的检修流程

第一步：必须先做全面的外观检查，观察显卡是否有掉件、烧坏、断线等外观问题，尤其注意 PCI-E 显卡背面的一排耦合电容，一个也不能少。

第二步：测量显卡供电是否正常；

第三步：检查显卡时钟复位是否正常；

第四步：测量金手指上的信号线、显卡背面黑色电感是否正常；

第五步：使用显卡 BIOS 刷新程序检查是否能检测到显卡信息；

第六步：检修接口部分电路。



#### 注意

AGP 接口的 NF6600 和 ATI X700 等显卡，如果代码走到 25 停住，可能为桥接芯片故障。

#### 3.3.2 供电部分的检修

显卡所需的供电有多个，核心供电在显卡最大的线圈处测量，范围 1.1~1.6V（见图 3-13），波形为方波。电感对地阻值只要大于  $1\Omega$  即可。因为电流越大，阻值越小，现在 PCI-E 显卡该电感的对地阻值大多在  $3\sim5\Omega$ 。最好的办法是找个同型号正常的显卡对比判断。

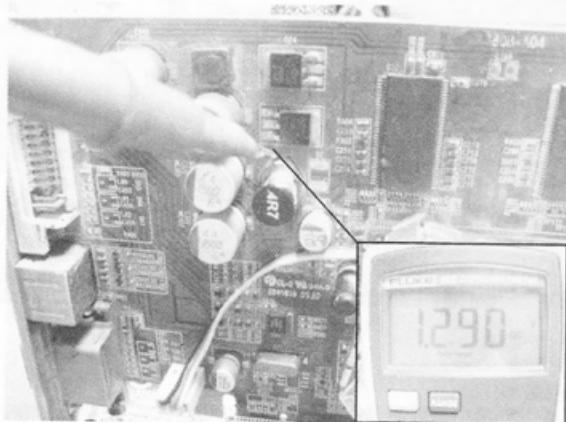


图 3-13 测量显卡主供电



显存供电在显存周边场管 S 极或者线圈处测量（见图 3-14）。对于 DDR 显存芯片，在芯片第 1 脚也可以测量到显存供电电压，一般是 2.5~3.3V；DDR2 显存的供电电压是 2.0V；DDR3 显存基本都是采用 PWM 方式供电，测量显存旁边的线圈电压是 1.8~2.0V。

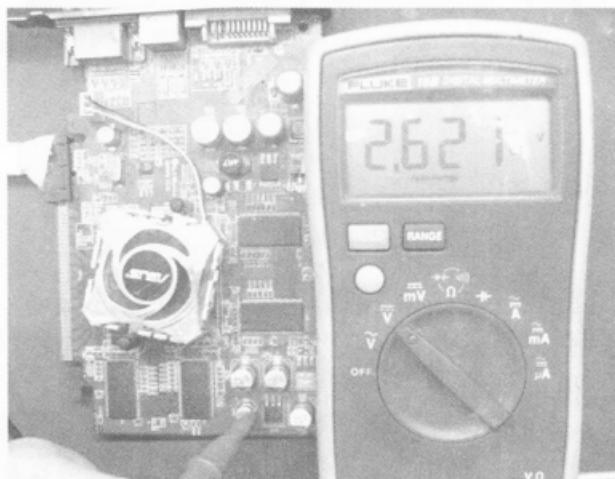


图 3-14 测量显存供电

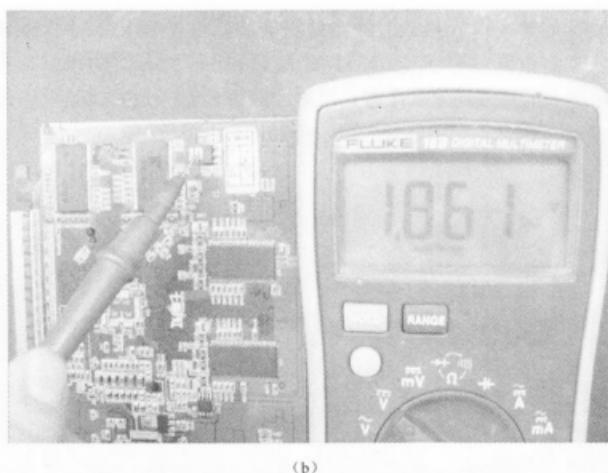
显存供电的对地阻值为几十欧姆。

VDAC、VDDC 等其他供电，一般在稳压器的输出端测量（见图 3-15），电压多为 1.5V、1.8V、2.5V、3.3V、5V 这几种。



(a)

图 3-15 测量其他供电



(b)

图 3-15 测量其他供电 (续)

需要多积累经验和使用对比法才可准确判断电压是否正常。

### 3.3.3 时钟复位的检修

显卡有一个 27MHz 的晶振，使用示波器可以探测到 27MHz 的正弦波，如图 3-16 所示。

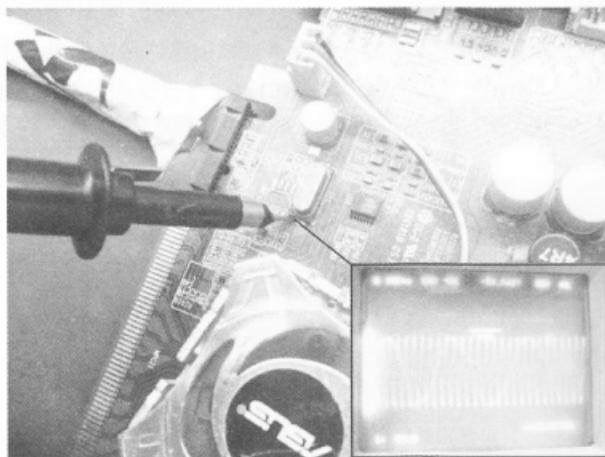


图 3-16 27MHz 的正弦波

显卡与主板通信同步，那么插槽上的总线时钟和复位是不可缺少的。使用万用表二极管挡测量金手指上接口总线时钟和复位是否正常，一般不短路不开路即可。接口总线时钟和复位脚如图 2-43 所示（第 2 章）。



### 3.3.4 金手指信号线检修

对显卡金手指上的信号线打值是比较费时费力的，但也是检修关键。需要测量三次，具体方法如下。

(1) 使用万用表二极管挡，红表笔接地，黑表笔测量显卡正面连接有细线的金手指，一共有 32 根（见图 3-17），值应该全一致。

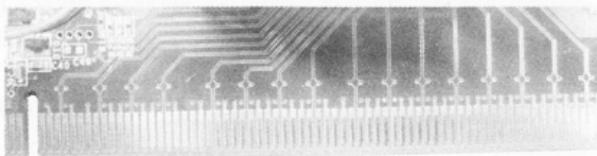


图 3-17 显卡正面信号线

(2) 测量显卡反面一排 32 颗电容靠近 GPU 一端二极体值，值同样要求一致，注意电容需要从左往右数 32 颗即可，如图 3-18 所示。

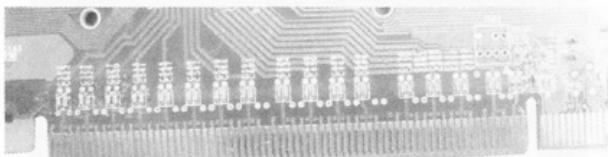


图 3-18 PCI-E 显卡的耦合电容

以上两次测量，如果某个信号线的数值比其他偏大，说明 GPU 有空焊或损坏，可以加焊或者重植 GPU，具体步骤见后面章节；如果数值偏小，说明 GPU 有短路，需要更换 GPU。

(3) 使用万用表二极管挡夹着耦合电容测量。值无穷大基本可以判断为正常，如图 3-19 所示。



图 3-19 测量耦合电容



除了金手指上的信号线需要认真打直外，还需要检查显卡背面的所有小贴片黑色电感，它们坏了也会产生点不亮等各种问题。

### 3.3.5 巧用 BIOS 刷新程序

对于无显示的显卡，在确认了前面几项检测正常后，需要将损坏的 AGP 或 PCI-E 显卡拔下来，插上 PCI 显卡后开机，进入主板 BIOS 设置程序，选择“Intergrated Peripherals”选项，将“Inti Display First”项的值改为“PCI SLOT”，然后保存设置并关机。接下来，将 AGP 卡或者 PCI-E 重新插上，但仍让显示器连接在 PCI 显卡上，然后重新开机进入 DOS，切换至显卡程序保存目录，运行显卡 BIOS 刷新程序查看是否有返回 GPU 信息和 BIOS 参数等。例如，nVIDIA 显卡使用“NVFLASH -C”命令，ATi 显卡使用“ATIFLASH -I”命令。返回结果有三种情况：

(1) 返回结果如图 3-20 所示，表示主板没有检测到显卡，需要重点查 GPU 到插槽部分的线路和 GPU 的工作条件。

```
D:\NVIDIA\BIOS>nv577 -c
D:\NVIDIA\BIOS>nv577 -c
NVIDIA Firmware Update Utility (Version 5.77)

ERROR: No NVIDIA display adapters found
D:\NVIDIA\BIOS>_
```

图 3-20 检测不到显卡的提示结果

(2) 返回结果如图 3-21 所示，表示检测到显卡核心，但检测不到 EEPROM，需要检查 EEPROM 到 GPU 之间的 SPI 总线，GPU 的 GPIO 电路及替换 EEPROM 芯片等。

```
D:\NVIDIA\BIOS>nv577 -c
D:\NVIDIA\BIOS>nv577 -c
NVIDIA Firmware Update Utility (Version 5.77)

Adapter: GeForce 7300 GT      (100E,0393,0000,0000) H:-->N0M 0:01,PCI,0:00,F:00
The display may go white/no color and off for up to 10 seconds during access to the
EEPROM depending on your display adapter and output device.

Identifying EEPROM...
EEPROM ID (20,0000) : Unknown
ERROR: Supported EEPROM not found
D:\NVIDIA\BIOS>_
```

图 3-21 不能正确显示 BIOS 信息的提示结果

(3) 返回结果如图 3-22 所示，表示 GPU 和 EEPROM 硬件主要部分没有问题，一般通



过刷写 BIOS（刷写 BIOS 相见后续章节）或者检修 DAC 和接口部分电路即可修复。

```
D:\UGN>cd bios
D:\UGN\BIOS>av57? -c
MUDIN Firmware Update Utility (Version 5.77)

Adapter: GeForce 7300 GT      (10DE:0393,0000,0000) H:---NRM B:DI,PCI,D:00,F:00
The display may go >BLANK< on and off for up to 10 seconds during access to the
EEPROM depending on your display adapter and output device.

Identifying EEPROM...
EEPROM ID (1F:0065) : Atmel AT25FS12A 2.7-3.6V 512Kx13, page
D:\UGN\BIOS>
```

图 3-22 检测到核心和 EEPROM 信息的提示

### 3.3.6 输出接口电路检修

对于无显示的显卡，有可能是上述显卡基本工作条件出故障导致的，也可能是输出接口部分有问题导致屏幕无显示。对于后者，可以借助主板上的小喇叭判断，如果主板在运行至显卡代码时小喇叭只响一声，然后继续跑码，但屏幕无显示，表示主板已经检测到显卡，不过显卡的 DAC 或接口部分电路有故障。

DAC 电路一般只需要检测 GPU 的 DAC 供电和 DDC5V 即可，检测位置在 1117 或 7805 的输出端。

接口部分一般检修 VGA 接头的 1、2、3、13、14 针脚即可。其中 1、2、3 为红绿蓝三基色，对地阻值为  $76.6\Omega$  左右，如图 3-23 所示。任何一个有问题都会导致缺色，如果都有问题，则会灰屏无显示。如果阻值偏小，说明有短路，可能为 GPU 或者低通电路中电容漏电导致；如果阻值偏大，说明接口接触不良或者匹配电阻损坏。



图 3-23 测量 R、G、B 对地阻值

VGA 接头行场同步信号若有问题，会导致无显示，显示器电源指示灯为橙色，它们的对地二极体值一般为 500 左右。用示波器可以探测到该波形，如图 3-24 所示。

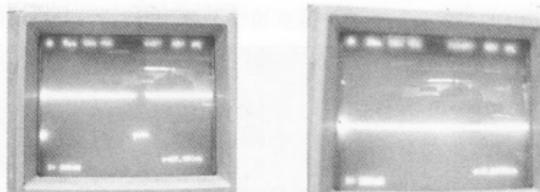


图 3-24 VGA 接行场同步波形

如果行场没有波形，需要沿着 13、14 脚跑线，一般会连接到 7408 门电路的输出端。门电路的输入端是从 GPU 发出的行场信号。74HCT08 门电路引脚定义如图 3-25 所示。

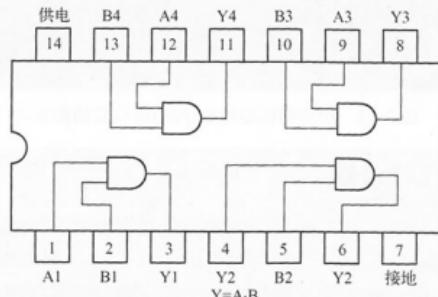


图 3-25 74HCT08 门电路引脚定义

DVI 头检修与 VGA 头类似，注意 16 脚位热拔插检测信号 HPD。如图 3-26 所示电路，当连接了 DVI 头时，此信号变为高电平。开启 NPN 三极管 Q2021，GPU 收到高电平信号，这时 DVI 接头才会有显示。

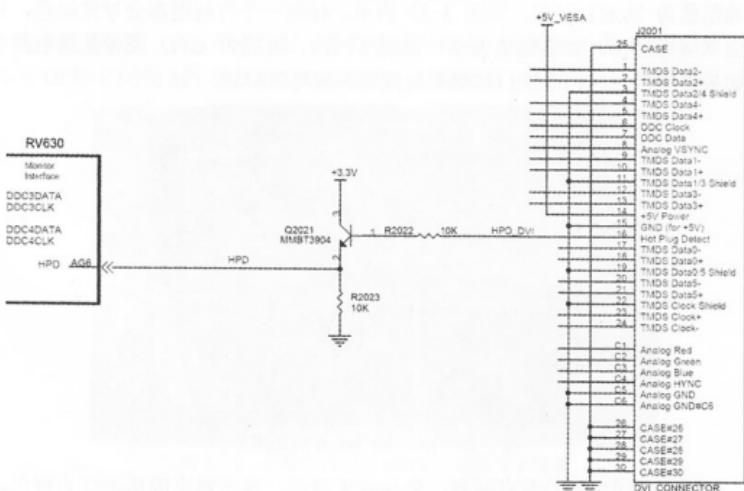


图 3-26 热拔插检测信号电路图



## 3.4 花屏的检修

花屏的显卡一般习惯分为“大花”和“小花”两种。

“大花”是指根本无法辨认屏幕的字符。首先需要检查外观是否有掉件，其次是检查显存供电是否正常。GPU 损坏或者显存地址线故障都会导致“大花”。另外，BIOS 刷错也可能导致“大花”。如果对显存测试系统非常熟练，也可以盲测，借助测试软件找出故障所在。具体操作方法参照后面章节“小花”的维修。

“小花”的显卡，首先同样需要检查外观：电阻、排阻、电感等是否掉件，PCB 是否断线。然后运行显存测试程序检测显存数据位好坏，根据程序返回的结果，结合通道定义和花屏的检修思路来维修。

### 3.4.1 MATS 的使用

进入 DOS 命令行，输入“mats”即可测试 nVIDIA 显卡，也可以输入“mats-c 10”只测试 10% 的显存。测试过程为彩色方块不停地变换。如图 3-27 所示为使用 mats 测试 7300 系列显卡的画面。（注：此图中 mats 已经改名为 mats7，且 MATS 有不同的版本适合不同的核心。）

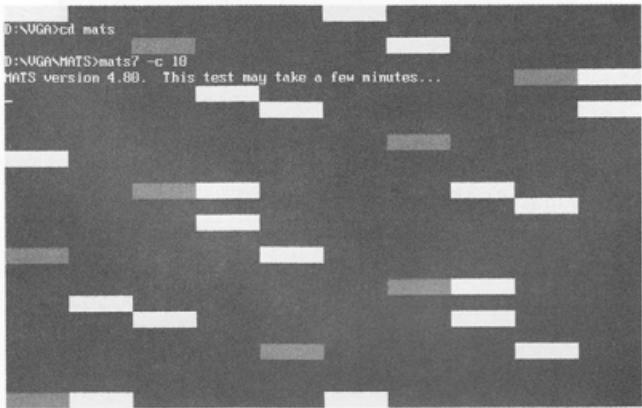


图 3-27 MATS 测试中的画面

测试结果会自动保存到 MATS 同目录下的 REPORT.txt 文件中，如图 3-28 所示，返回结果显示此显卡分为 FBA、FBC 两个通道，每个通道 64 个数据位（0~63）；ERR 数值为 0 表示此项没有错误；External Bank 0 Failing bits 显示 None，表示没有错误的数据位。

如果有错误的显卡，会返回如图 3-29 所示结果。同样此显卡分为 A 和 C 两个通道，每个通道 64 个数据位，C 通道的 15 号数据位有错误。至于 ERRORS 数值 499392 可以不用理会。（注：本书图形中如有如图 3-29 所示界面一条竖线，为图片拍摄时显示器上的亮线导致。）



```
D:\VGA>cd mats
D:\VGA\mats>mats7 -c 10
MATS version 4.00. This test may take a few minutes...
    LANE   EBO READ ERR EBO WRITE ERR UNKNOWN ERR
PBA[31: 0]      0      0      0
PBA[63:32]      0      0      0
FBC[31: 0]      0      0      0
FBC[63:32]      0      0      0

External Bank 0 Failing bits:
    None
    Read   Error Count: 0
    Write  Error Count: 0
    Unknown Error Count: 0

D:\VGA\mats>_
```

图 3-28 使用 MATS7 测试 G86 显卡的界面

```
MATS version 3.41. This test may take a few minutes...
Tested from 0 MB to 128 MB.
    LANE   E_BANK0 ERRORS
    -----
FMA[31: 0]          0
FMA[63:32]          0
FNC[31: 0]          499392
FNC[63:32]          0

External Bank 0 Failing bits:
    C15
    Read   Error Count: 0
    Write  Error Count: 499392
    Unknown Error Count: 0
```

图 3-29 C 通道 15 号数据位报错的提示

更多的 MATS 使用参数可以通过输入“mats /?”可以得到，详见如下。

#### MATS 参数：

- e xx Forces endpoint of test to megabyte xx
- c xx Only test xx percent of the framebuffer
- b xx Forces start of test to megabyte xx
- f Uses 48N (long) test algorithm
- o Suppress file output
- m xx Set the maximum number of errors to log
- n xx Run the algorithm on the card with index xx  
‘xxxx’ in the boards.dat file.
- v Disabled save & restore of VGA memory space
- ver Display version information
- x Don't use the box algorithm

如果屏幕花的比较严重，甚至看不清，那就只能盲测了。所谓盲测就是依据对测试程序



目录结构的熟练程度，凭记忆输入命令运行测试程序。等待一会，估计已经测试完毕后，主板断电，换一块好的显卡，进入 MATS 所在目录，输入“edit report.txt”即可查看前一片 nVIDIA 显卡的测试结果，如图 3-30 所示。

```

File Edit Search View Options Help
D:\NUGEN\MATS\REPORT.TXT
: LANE EBB READ ERR EBB WRITE ERR UNKNOWN ERR
: FBA[31:0] 0 0 0
: FBA[63:32] 0 0 0
: FBC[31:0] 0 0 0
: FBC[63:32] 0 0 0
:
: External Bank 0 Failing bits:
: None
: Read Error Count: 0
: Write Error Count: 0
: Unknown Error Count: 0
:
: No errors logged.
:
: No errors logged.

F1=Help Line:1 Col:1

```

图 3-30 nVIDIA 显卡查看测试结果的界面

### 3.4.2 RxMEMID 的使用

ATi 显卡的测试程序与 nVIDIA 显卡的不一样，使用方法也不同。下面以 R3MEMID 程序为例，介绍一下 ATI 显卡测试程序的使用方法。

进入 DOS 命令行后，输入“r3memid-nocfg-log”启动 R3，进入测试项选择界面，如图 3-31 所示，在“Enter selection:”后输入如下参数，会运行对应的程序。

```

R3MEMID Test Program - version 1.13 - 15 tests
=====
C1 J - F11           I9 J - Byte swap macro+micro8x2 read
C2 J - Data line toggle (GUI)   I10 J - Byte swap macro+micro8x4 write
C3 J - BM column (GUI)    C11 J - Macro+Micro8x2 alignment write
C4 J - BM page (GUI)     C12 J - Macro+Micro4x4 alignment read
C5 J - BM channel (GUI)   C13 J - Moveblit, 4 align, I
C6 J - Data mask        C14 J - HOST_DATA<f,b>/H2L
C7 J - Macro + Micro8x2 tiling read C15 J - Line slopes/dir/P/solid
C8 J - Macro + Micro4x4 tiling write

[*] - Run all tests
[p J - previous page
[n J - next page
[e J - start page
[0 J - end page

Enter selection:

```

图 3-31 R3MEMID 界面

\*——运行所有的测试项。

2——测试第 2 项，如输入 8 则测试第 8 项。



0——退出。

s 2 3 e 5——测试 2、3、5 这几个项。

输入“2”启动测试程序第 2 项后，会出现如图 3-32 所示花屏画面，为正常测试过程。

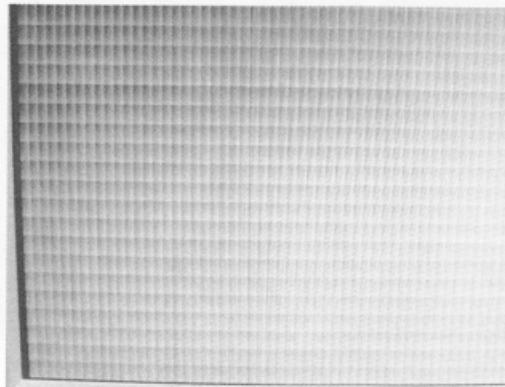


图 3-32 R3MEMID 测试中的界面

程序测试完成后，如果没有错误，会返回 PASS 的界面，如图 3-33 所示。

```
R3MEMID version 1.13, (c) Copyright ATI Technologies Inc, 2004
TEST RESULT SUMMARY:
=====
R0350-M1B (0x4150) detected.
128M video memory.
Test suite ran 1 of 1 times.
Checking test status array ...
EZ J Data line toggle (GUI) : PASS
No failures detected.

D:\XUGA>_
```

图 3-33 第 2 项测试通过的提示

如果数据位有问题，会返回 FAIL 的界面，如图 3-34 所示，错误的数据位为“MDB0 48 49 50 51 52 53 54 55 ...”，也就是 B 通道的 48~55... 数据位出错。ATi 显卡的测试结果并没有 nVIDIA 显卡的那么方便，每个通道它只显示 7 个出错数据位，如果超出则在后面加上“...”，表示还有省略的出错数据位。这里需要注意一点，ATi 显卡的测试结果是程序结束后才能保存的，如图 3-35 中，按“1”后继续，回到 R3MEMID 主界面，输入“0”回车退出，最后还要按“1”回到命令提示行才能结束程序，也才会保存结果。

```
R3MEMID version 1.07, (c) Copyright ATI Technologies Inc, 2003
TEST RESULT SUMMARY:
=====
Rv350 (Bx4150) detected.
128M video memory.
Test suite ran 1 of 1 times.
Checking test status array ...
C2 3 Data line toggle (GUI) : FAIL
    Error ID 0000023
1024 x 768 - 32 bpp ( 60 Hz): TEST FAILURE
    failing bit : H000 40 49 50 51 52 53 54 55 ...

Failure detected.
Press '1' key to continue ...
-
```

图 3-34 第 2 项测试失败的提示

如果进入 DOS 命令行后，输入“r3memid-nocfg-log”没有出现测试项选择界面，而是出现如图 3-35 所示画面，表示此程序不支持当前显卡，需要更换其他版本的 ATI 显卡测试程序。

```
D:\>R3MEMID>r3memid-nocfg -log
R3MEMID version 1.13, (c) Copyright ATI Technologies Inc, 2004

Log file generation enabled to .\R3MEMID.LOG ...
Reference data file (RDF) loading disabled ...
This program requires an ATI Radeon based video adapter.
Press '1' key to continue ...
-
```

图 3-35 程序不支持的提示

如果 ATI 显卡大花，同样需要使用盲测法，不过可以使 R3MEMID 自动执行测试项目，命令是“r3memid -nocfg -log 2”，执行此命令后的效果是自动运行第 2 测试项。如图 3-36 所示，同样，需要按“1”才能保存结果。R3MEMID 的测试结果记录在同目录下的 r3memid.log 文件中，查看方法与 nVIDIA 显卡测试软件的记录文件相同。

```
D:\>R3MEMID>r3memid -nocfg -log 2
R3MEMID version 1.07, (c) Copyright ATI Technologies Inc, 2003
TEST RESULT SUMMARY:
=====
Rv350 (Bx4150) detected.
128M video memory.
Test suite ran 1 of 1 times.
Checking test status array ...
C2 3 Data line toggle (GUI) : FAIL
    Error ID 0000023
1024 x 768 - 32 bpp ( 60 Hz): TEST FAILURE
    failing bit : H000 40 49 50 51 52 53 54 55 ...

Failure detected.
Press '1' key to continue ...
-
```

图 3-36 保存 R3MEMID 测试结果的界面



r3memid.exe 说明部分译文如下。

### R3MEMID 使用说明部分译文

R3MEMID 是一个 DOS 程序，其目的是用来定位 R300/R350/RV350 显卡板的失效产品损坏显存。它适用于一系列产品的测试，当失效的时候很可能指出内存的问题。作一些改动，这些测试可以按照定义在 R3MEMID 配置文件里的板上的内存计算出哪个显存芯片引起失效。有些测试产品失效的项目很可能指出显存问题，但是程序中并未包括，因为那些测试在定位坏显存项目的过程要复杂得多。我们正在努力开发下一个版本来支持那些测试项目。

#### 语法与选项

运行 R3MEMID：

`r3memid [-选项] <测试选择>`

例如：

运行 1# 和 2# 测试，请输入“`r3memid 1 2`”。

带错误 ID VB001 运行，请输入“`r3memid VB001`”。

查看测试列表，请输入“`r3memid -nl`”。

R3MEMID 可以带下述选项运行：

`-bit`

报告相应于失效的数据线而不是显存芯片，这个对卡级问题有用。

`-board<ID 字符串>`

指定程序使用定义在 R3MEMID.cfg 中的哪个配置来定位坏显存芯片。R3MEMID.cfg 里可以有不同显卡的很多内存配置。程序在<ID 字符串>所确定的区域查出显存配置。

`-info`

显示由 BIOS 在当前板上检察到的显存配置，信息包括：

`nbankbit`——每个显存芯片的 bank 地址线数目，显示值为 1、2 或者 3。1 = 2 bank 显存，2 = 4 bank 显存，3 = 6 bank 显存。

`nrowbit`——每个显存芯片的行地址线数目，显示值应该在 9~13。

`ncolbit`——每个显存芯片的列地址线数目，显示值应该在 7~9。

`channel`——正在使用的显存通道数，显示值应该是 1 或者 2。

`rank`——显存 rank 的数目，显示值应该是 1 或者 2。

`mem_ctrl`——`mem_ctrl` 寄存器内容。

`memsize`——BIOS 检查到的总显存大小，十六进制数表示。通常的值为：

02000000——32MB 卡

04000000——64MB 卡

08000000——128MB 卡

(译者注：其他卡以此类推)

注意：如果卡上有某些芯片损坏程度使得 BIOS 不能检察到，显示的显存配置信息可能不同于所期望的信息。

`-logext`

在 r3memid.log 中长的额外信息。额外信息包括失效显存数据总线位完全列表，测试中探查到的总出错相数，以及当时用“`-nlog`”选项时很多错误显存位置和数据的。

`-nlog<#>`

当“`-logext`”启用时，把<#>数目的失效位置和数据记到日志文件中。

例如：“`r3memid -nlog100 -logext 3`”

这个命令运行测试 3 并把首先遇到的 100 个错误记在 r3memid.log 日志文件中。

**-nocfg**

禁止程序使用从 R3MEMID.cfg 中查找显存配置，而是使用 BIOS 当前检查到的显存配置并且仅仅报告失效的显存数据线。

注意：如果“board”和“nocfg”都没有使用，程序将从 R3MEMID.cfg 文件中找出一个显存配置，它有一个 PCI 子系统的 ID 和卡上的 PCI 子系统相匹配。

**测试列表**

R3MEMID 支持 14 测试。

R3MEMID 测试编号	描述	出错 ID
1	填充	VB001
2	数据线切换 (GUI)	VB023
3	读写页面 (GUI)	VB025
4	读写通道 (GUI)	VB028
5	数据掩码	VB006
6	宏+微 8x2 贴图读	VC006
7	字节交换 宏+微 8x2 读	VC018
8	主数据/<f, b>/M2L	TR014
9	Line slopes/dir/P/solid	TR010

**配置文件**

显存配置和组织随显卡设计不同而不同，如一块显卡可以设计为单显存通道和两个显存芯片，而另一块显卡可能设计为双显存通道和 8 个显存芯片。为计算不同设计的显卡上哪个芯片坏了，R3MEMID 需要从 R3MEMID.cfg 文件里查找信息，该文件含有用户为不同设计的显卡定义的不同显存配置。在第一次对某种显卡设计运行 R3MEMID 之前，我们需要编辑 R3MEMID.cfg 文件添加那种显卡设计的内存配置。

**故障查找**

当崩溃发生时，R3MEMID 报告正在访问那个显存芯片或显存数据位，这个信息用来帮助发现失效原因。

“-logext”把错误信息写在 r3mchip.log 文件中，这在屏幕上花到无法阅读信息时很有用的，还有可选的不匹配数据也写入这个文件中。

显存失效的一般原因：

- (1) 显存芯片坏；
- (2) 终端电阻损坏或变值；
- (3) 显存引脚、ASIC 芯片引脚或者排阻的焊接问题；
- (4) 来自稳压电路的电压出错；
- (5) ASIC 芯片坏。

R3MEMID 报告的错误类型及我们应该检查的项目：

- (1) 单个芯片，单个位失效

- 可能存在排阻、ASIC 引脚或者显存数据引脚焊接问题；
- 若焊接良好，显存芯片可能存在内部问题，试换显存芯片；
- 若替换后不能修复，则失效可能是 ASIC 芯片引起的。

- (2) 单个芯片，多个位失效



- 若这些位连接到同一个排阻，检查排阻问题；
- 若这些位连接到显存芯片或者 ASIC 芯片的引脚相互靠近，检查这些芯片焊接质量；
- 若这些位属于同一字节，检查 DQM 通路；
- 检查电压和像 CLK、DQS、CS...等控制信号通路；
- 否则的话，检查每个失效数据位的通路；
- 如果其他都是正常的，试换显存芯片。

(3) 单个芯片，所有的位都失效

- 检查电压和像 CLK、DQS、CS...等控制信号通路；
- 试换显存芯片。

(4) 多个显存芯片，单个通道

- 通常坏显存芯片不多于 1 个；
- 检查每个显存供电电压；
- 检查如 CLK、CS、地址线...等公共控制信号通道；
- 试换显存芯片。

(5) 多个显存芯片，多个通道

- 检查每个显存供电电压及稳压电路；
- 检查总线接线；
- 检查 ASIC 的电压。

R5MEMID、R6MEMID 的使用与 R3MEMID 类似，这里不再详细介绍。



### 小技巧

测试程序命令复杂，可以编辑一个批处理，简化输入命令的繁琐步骤。作者使用的测试程序选择界面如图 3-37 所示，其实质就是批处理。

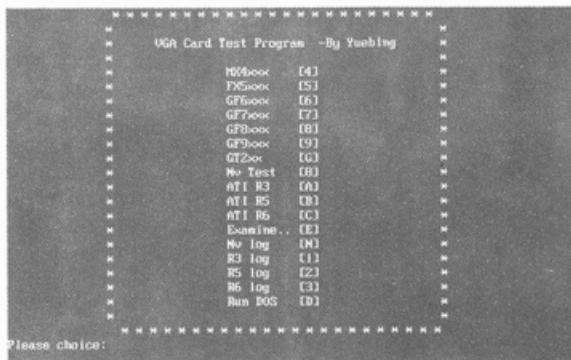


图 3-37 测试程序选择界面

### 3.4.3 显存数据位排列

学完测试程序的使用方法后，知道了如何看测试结果，那么显存数据位是如何排列的



呢？大家应该都知道 865 以后的主板才开始支持双通道内存，而在显卡中，显存早已经是多通道了，最新的 GT200 支持 A、B、C、D、E、F、G、H 8 个通道。不管是 nVIDIA 显卡还是 ATI 显卡，其显存排列都是由 BIOS 定义好的，相同板型的显卡，基本上是相同的，很少有厂家会去改动。

### 1. nVIDIA 显卡显存排列

市场上的显卡常见的 nVIDIA 显卡是采用 A、C 两个通道：右边竖排为 A 通道，上面横排为 C 通道。常见 nVIDIA 显卡显存排列如图 3-38 所示。

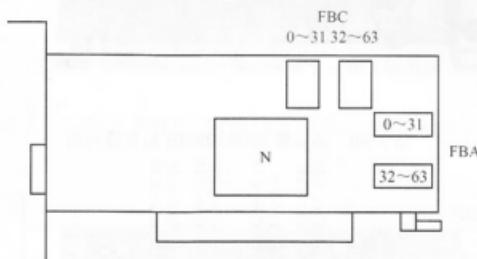


图 3-38 常见 nVIDIA 显卡显存排列示意图

如果为 8 颗显存的显卡，常见的有两种方式：

(1) 如果 MATS 测试显示有 FBA、FBC 两个通道，那么显存排列如图 3-39 所示。

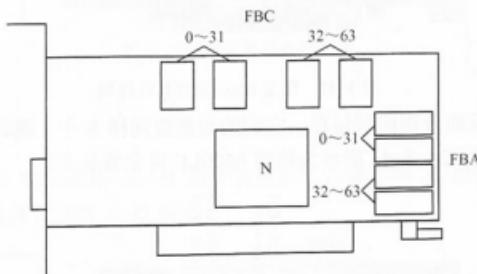


图 3-39 8 颗显存排列示意图

某品牌 5200128MB 显卡排列如图 3-40 所示，8 颗显存，分 A、C 两个通道，排列比较有规律。数据位每 8 位一组。相连的两组在同一个显存上。

#### 注意

每个公司的排列可能都不尽相同，数据可能会交叉排列。微星 6600 显存具体排列如图 3-41 所示，8 颗 DDR 显存，每个显存 16 位，每一列有 8 个数据位。

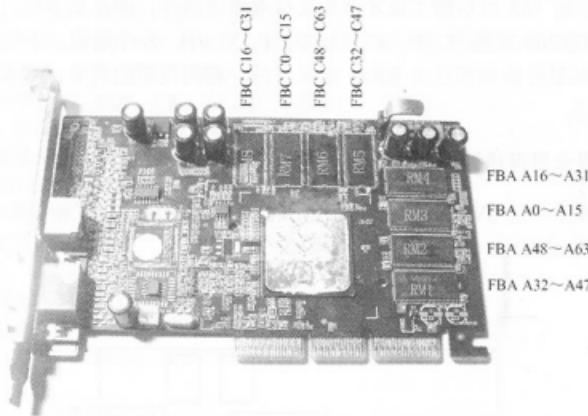


图 3-40 某品牌 5200 128MB 显存排列图

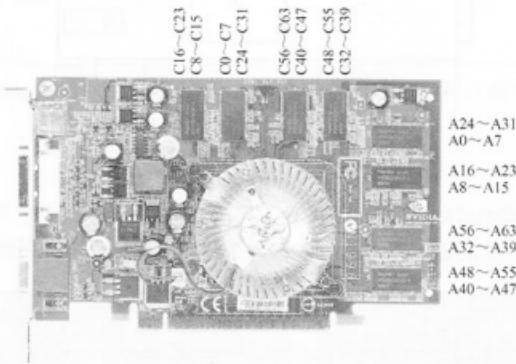


图 3-41 微星 6600 显存具体排列

有的显卡正面和反面分别四颗显存，它们的数据位同样 8 个一组，交叉排列，几乎没有多少规律可找，如图 3-42、3-43 所示为铭瑄 6600LE 黄金版显卡。

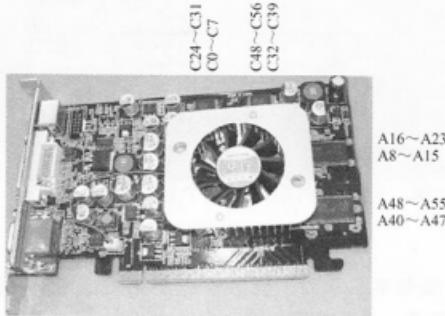


图 3-42 铭瑄 6600LE 黄金版显卡正面 4 颗显存

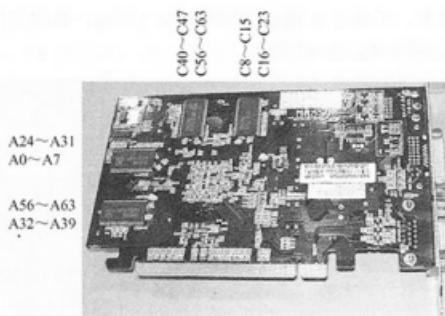


图 3-43 铭瑄 6600LE 黄金版显卡反面 4 颗显存

(2) 如果 MATS 测试显示只有 FBD 一个通道 (常见为 MX 系列显卡), 那么显存排列如图 3-44 所示。

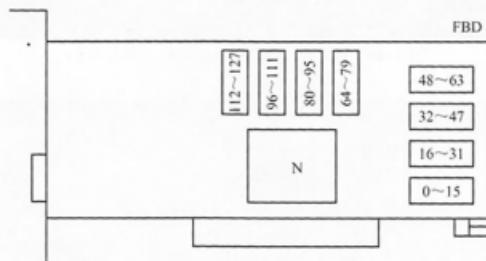


图 3-44 单通道显存排列图

## 2. ATI 显卡显存排列

市场上常见的 ATI 显卡采用 A、B 两个通道: 右边竖排为 A 通道, 上面横排为 B 通道。常见 ATI 显卡显存排列如图 3-45 所示。

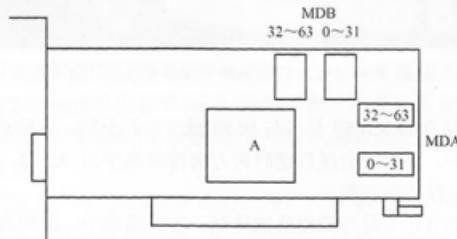


图 3-45 常见 ATI 显卡显存排列示意图



常见的 ATI9550 显卡，正反各 4 颗显存 128MB，128bit，数据位也是交叉排列。迪兰恒进 9550 显卡显存排列如图 3-46、3-47 所示。

图 3-46 迪兰恒进 9550 显卡显存正面排列图

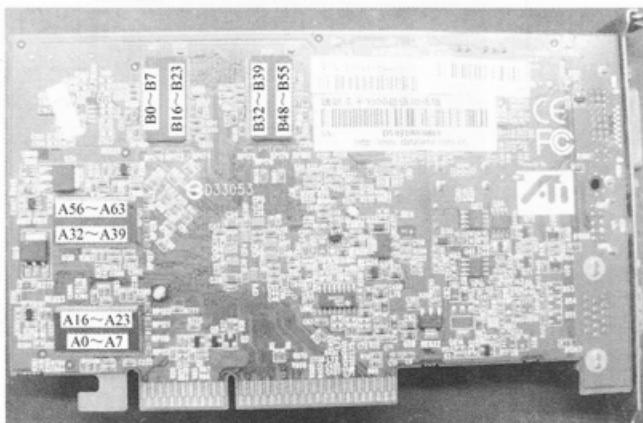


图 3-47 迪兰恒进 9550 显卡显存反面排列图

但是使用 DDR3 显存的 X1650 显卡与 9550 显卡排列不同。这种正面四颗显存、右边两颗，上面两颗的方案中，显存的分区以逆时钟方向排列顺序为 A、B、E、F，在维修中要仔细区分，多总结各种显存排列方案。

这里只是介绍了部分显卡显存数据位的排列。实际维修中，最终判断显存排列的方法是采用“短接法”：



- (1) 运行测试程序测试一次，记下报错的数据位；
- (2) 短接显存 65、66 脚测试一次，记录下新增加的报错数据位；
- (3) 再次短接显存 5、6 脚测试一次，记录下新增加的报错数据位；

因为 DDR x16 显存数据位都是 8 位一组，如此就可以准确判断数据位排列了。

MBGA 封装的显存排列方式与 TSOP 相同，但由于不能采取短接法，只能采取割线法，不过难度比较大，因为很多数据位都是从 PCB 中间层走线的。

#### 3.4.4 花屏的检修思路

- (1) 对显卡进行全面的外观检查，是否有掉件、烧坏、断线等外观问题。
- (2) 运行显存测试程序，根据显存排列图找出报错的数据线。必要时需要使用“短接法”才能准确定位报错的数据位。
- (3) 如果报错的只是独立的某个或几个数据位，可以参照显存脚位定义图测显存数据线的二极体值，也可以更换显存芯片排除。显存与 GPU 间数据线上有串联电阻的如图 3-48 所示，注意检查阻值是否正常。

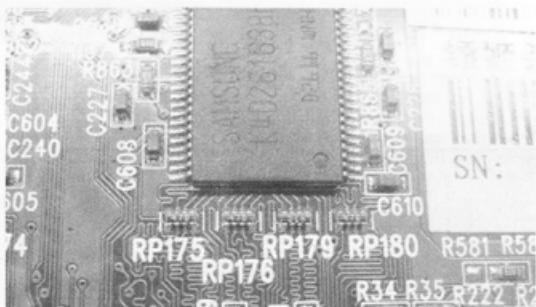


图 3-48 数据线上的串联排阻

(4) 如果报错的数据位为 0~7、32~39 这样的整组（8 个为一组），重点检查对应的 LDQS、LDM 对地数值是否正常；如果报错的数据位为 0~31 这样的情况，重点检查显存的时钟信号/控制信号是否正常、地址线是否空焊、显存的工作电压/参考电压是否正常等。

(5) 如果整个通道报错，则可能为地址线短路或显存供电不正常，GPU 损坏等。

(6) 对于显存报错的，都可以采取替换法排除。例如，A 通道不报错，C 通道报错的显卡，可以把 C 通道数据位报错的显存与 A 通道互换，如果故障依旧，可以说明显存没问题，故障在 GPU 或者显存到 GPU 间的线路；如果错误的数据位在 A 通道了，说明显存坏，更换一颗显存即可修复。

(7) “大花”的显卡，可能为 BIOS 资料损坏，可以考虑刷写 BIOS。

(8) 如图 3-49 所示屏幕很多小点，且不断变化，戏称“满天星”，用软件测试的界面显示如图 3-50 所示。此为显存通病，芯片为 DDR3 三星 MBGA 封装的 K4J5532\*\*\*-BC14



系列，稍微加热一下显存芯片都会导致非常多的数据位错误。需要全部更换显存芯片才可以修复。

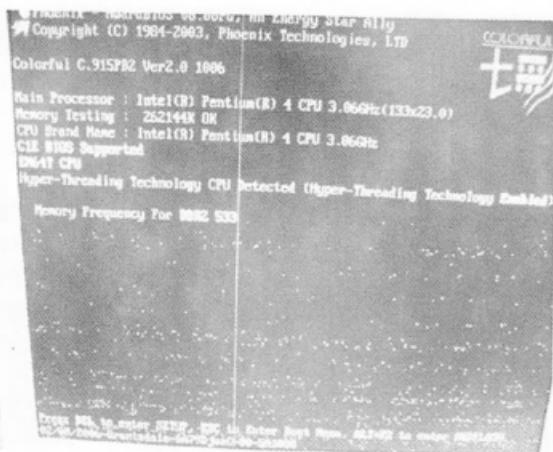


图 3-49 “满天星”故障表现

	File	Edit	Search	View	Options	Help
	E:\DESKTOP\REPORT.TXT					
	LANE DQD RAID ERR EBD HWT EIR UNKNOWN ERR					
	I:FBM11: 01 35 570401 0 0					
I:	FBM16(3:32)	0	10310	0		
I:	FBC01: 01	0	19833	0		
I:	FBC16(3:32)	0	23148	0		
	<External Bank 0 Failing Bits>					
I:	000 000 000 000 001 001 0 1 001 001 002 002 0 3 003 003 003 004 004 004 004 005 005 005 006 0 6 006 006 007 007 0 7 007					
I:	008 008 008 008 0 9 009 009 009 009 01 010 010 010 0 11 001 011 0 12 012 012 012 13 013 0 13 013 014 014 014 0 14 0 15 015 016 016 016 016 017 017 017 017 018 018 018 018 019 019 019 020 020 020 020 021 021 021 021 022 022 022 022 023 023 023 024 024 024 024 025 025 025 025 026 026 026 026 027 027 0 27 028 028 0 28 028 029 0 29 029 030 030 030 030 031 031 031 032 032 032 032 033 033 033 033 034 034 034 034 035 035 035 036 036 036 036 037 037 037 037 038 038 038 039 039 039 040 040 040 040 041 041 041 041 042 042 042 043 043 043 043 044 044 044 044 045 045 045 045 046 046 046 047 047 047 048 048 048 048 049 049 049 049 050 050 050 050 051 051 051 052 052 052 052 053 053 053 053 054 054 054 054 055 055 055					

图 3-50 显存通病“满天星”的测试结果

### 3.5 其他故障检修

显卡的故障除了无显示和花屏的故障外，还有如缺色、偏色、时亮时不亮、不能安装驱动、玩游戏黑屏死机等其他特殊故障。

先检查外观是否不良以及金手指是否不洁。缺色、偏色显卡的维修参照本书 3.3.6 节；其他故障需要检查供电时钟是否正常，必要时更换供电场效应管和电容；不能安装



驱动的有可能为 GPU 空焊或损坏、BIOS 问题、硬件 ID 错误等，部分显卡显存问题也会导致无法安装驱动；另外显卡本身的散热要特别注意，散热不好轻则导致死机黑屏，严重还会烧坏 GPU。

有些显卡在出厂前进行了超频。把 GPU 厂家规定的工作频率提高一成左右，长时间使用后可能会造成 GPU 的老化，这种情况基本上没有什么硬件上的解决方法，除非是换 GPU，当然也可以用软件的方法解决，把 GPU 和显存的工作频率都降低一些试试。常用的软件有 nVIDIA BIOS Editor (NiBiTor)、Radeon BIOS Editor (RBE)。

### 3.5.1 nVIDIA 显卡降频

NiBiTor 是现阶段最好的 nVIDIA 显卡 BIOS 编辑工具之一。它操作简便且功能强大，重要的是它可以修改显卡频率。NiBiTor 原版为英文，图 3-51 所示为汉化版界面。



图 3-51 NiBiTor 汉化版界面

首先在 DOS 下将故障显卡的 BIOS 备份成\*.ROM 文件（方法参照 3.6 节内容）。

(1) 执行菜单“文件”→“打开 BIOS”命令，如图 3-52 所示，从弹出对话框中选择备份的 ROM 格式文件，然后单击“确定”按钮。

(2) 打开文件后，将看到频率设置项，调整 3D 频率数值，只需降低核心和显存数值 30 即可，如图 3-53 所示。

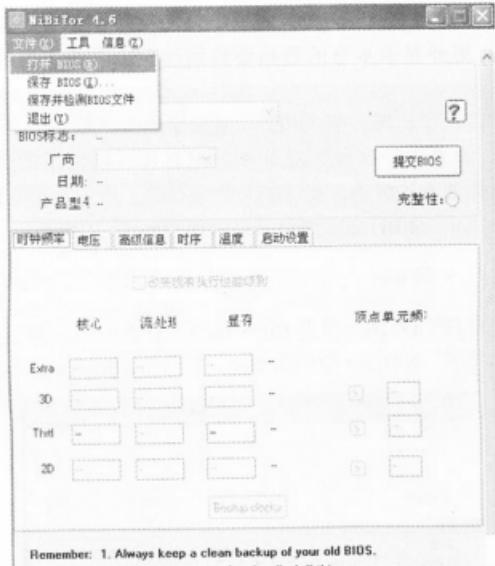


图 3-52 打开文件的界面



图 3-53 调整频率的界面

(3) 执行菜单“文件”→“保存 BIOS”命令，如图 3-54 所示，将更改过频率的 BIOS 保存为 ROM 格式文件。



(4) 将保存好的 ROM 格式文件在 DOS 下刷入显卡即可。刷新完毕后，如果显卡故障依旧，基本可以判定为 GPU 坏了。

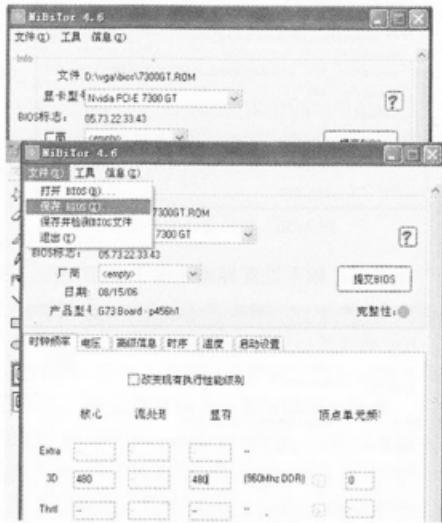


图 3-54 保存 BIOS 的菜单

### 3.5.2 ATI 显卡降频

ATI 显卡修改 BIOS 的软件有 Radeon BIOS Editor (RBE) 和 Radeon BIOS Tuner。Radeon BIOS Tuner 是由一位俄罗斯硬件高手编写的显卡 BIOS 编辑修改工具，具有修改设备 ID、频率等众多非常强大的功能。Radeon BIOS Tuner 的界面如图 3-55 所示。

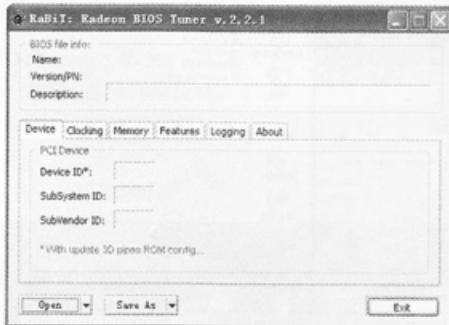


图 3-55 Radeon BIOS Tuner 的界面

(1) 单击“Open”按钮，打开 DOS 下备份好的 ROM 文件，如图 3-56 所示。

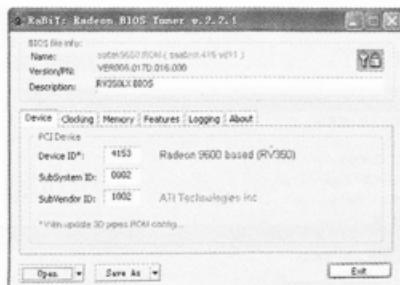


图 3-56 打开文件的界面

(2) 单击“Clocking”标签页，频率设置界面如图 3-57 所示。

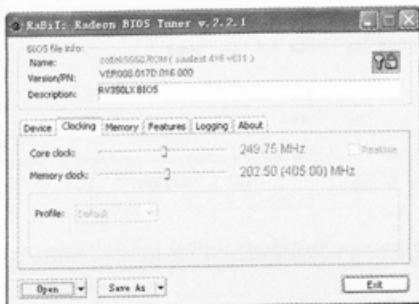


图 3-57 频率设置界面

(3) 单击“Save As”按钮，将修改后的内容保存为 RV350.ROM 文件，即可进入 DOS 进行刷写了，如图 3-58 所示。

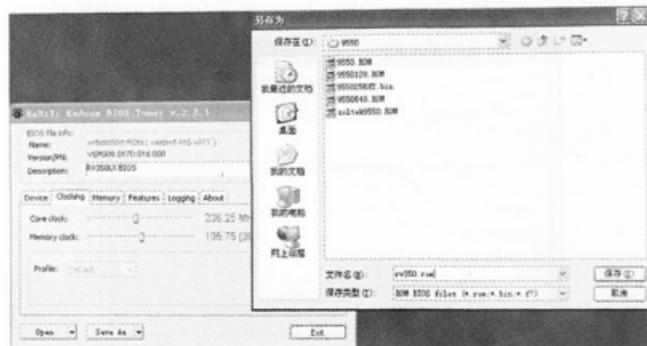


图 3-58 保存文件的对话框

刷新修改过的显卡 BIOS 有很大风险，刷新前必须备份原 BIOS 文件，万一刷完后不显示，可将备份的 BIOS 刷回去。



## 3.6 显卡 BIOS 刷写

出现如下情况可以考虑刷写 BIOS:

(1) 更新 BIOS 失败, 导致不显示。

(2) “大花”故障, 可能为刷错 BIOS, 可以考虑刷写 BIOS。

(3) 当主板诊断卡跑到 2A 2B 的时候, 测试 BIOS 的片选脚, 1 脚有高到低的电平跳变, 可以考虑刷写 BIOS (也可能为 GPU 故障)。

(4) 显卡不显示, 但能检测到核心和 BIOS 信息, 可以考虑优先刷写 BIOS。

显卡 BIOS 刷写可以采取两种方法:

第一种是把 ROM 芯片取下来使用编程器刷写;

第二种是在 DOS 下运行显卡 BIOS 刷新程序刷写。

对于无显示或者“大花”的显卡, 要刷写 BIOS, 需要准备一张 PCI 显卡。如果没有 PCI 显卡, 而主板支持双 PCI-E 显卡, 也可以在主板上插入两张不同品牌的显卡。例如, 待修的那张是 PCI-E 的 ATI 显卡, 那么就再插入一张 nVIDIA 显卡。

DOS 下使用的显卡 BIOS 刷写程序, 常用的有两种: ATI 显卡的 ATIflash.exe 和 nVIDIA 显卡的 Nvflash.exe。常见的显卡 BIOS 文件为 64KB, 也有少数为 128KB, 在刷写时要注意区分。

下载地址: 迅维网<http://www.chinafix.com.cn>

### 3.6.1 ATI 显卡 BIOS 刷写

ATI 显卡刷写 BIOS 的程序命令为 ATIFLASH.exe, 常用参数如下:

- ATIflash -i 显示 ATI 显卡的参数信息。
- ATIflash -p 0 abc.rom 将 abc.rom 写入显卡的 ROM 芯片中。
- ATIflash -p -f 0 abc.rom 将 abc.rom 强制写入显卡的 ROM 芯片中。
- ATIflash -s 0 abc.rom 读取显卡 ROM 内容, 并以 abc.rom 的名字保存。
- ATIflash -p -f atmel 0 abc.rom 将 abc.rom 写入芯片为 atmel 公司的 ROM 中。
- ATIflash -p -f sst 0 abc.rom 将 abc.rom 写入芯片为 sst 公司的 ROM 中。
- ATIflash /? 获取 ATIflash 的详细说明。

“ATIflash -i”命令如图 3-59 所示, 显示该显卡的设备 ID 号、核心型号、Flash 型号、容量等参数信息。

注: ATIflash.exe 改名为 ATI362.exe。

```

D:\UGR>cd bios
D:\UGR\BIOS>ati362 -i
adapter bn dn did      asic      flash      romsize test      bios p/n
***** ----- -----
B     01 00 4150 RV350      H25P05/C      10000 pass 113-A009200-100
D:\UGR\BIOS>

```

图 3-59 ATI 显卡参数信息的提示



将 9.ROM 文件刷写进 ATI 显卡 EEPROM 的画面如图 3-60 所示。

```
D:\NUGAN\BIOS>ati1362 -p 0 -f 9.rom
Old mem setting: 7848
New mem setting: 7948
Old SSID: 3366
New SSID: 3366
Old P/M: 113-AW9200-100-BT
New P/M: 113-AW9200-100-BT
Old DeviceID: 4150
New DeviceID: 4150
Old Product Name: NV350 P/M 113-AW9200-100-BT BIOS
New Product Name: NV350 P/M 113-AW9200-100-BT BIOS
Old BIOS Version: 008.0170.016.000
New BIOS Version: 008.0170.016.000
Flash type: M25P80-C
10000/10000h bytes programmed
10000/10000h bytes verified

Restart System To Complete UBIOS Update.

D:\NUGAN\BIOS>
```

图 3-60 ATI 刷写 BIOS 的提示

### 3.6.2 nVIDIA 显卡 BIOS 刷写

nVIDIA 显卡刷写 BIOS 的程序命令为 NVFLASH.exe，常用参数如下。

- nvflash -c 检测显卡 ROM 芯片是否支持刷新。
- nvflash abc.rom 将 abc.rom 写入显卡的 ROM 中。
- nvflash abc.rom -4 -5 -6 将 abc.rom 强制写入显卡的 ROM。
- nvflash -b abc.rom 读取显卡 ROM 内容，并以 abc.rom 的名字保存。
- nvflash abc.rom -k 读取显卡 ROM 内容，并与名为 abc.rom 的文件比较。
- nvflash abc.rom -f 将 abc.rom 写入显卡的 ROM 中，然后进行校验。
- nvflash -? 获取刷新程序的详细说明。

nVIDIA 显卡备份 ROM 内容为 7300gt.rom 的界面如图 3-61 所示（注：nvflash.exe 改名为 nv577.exe）。

```
D:\NUGAN\BIOS>nv577 -b 7300gt.rom
NVIDIA Firmware Update Utility (Version 5.77)

Adapter: GeForce 7300 GT      (100E,8393,0000,0000) H:---:NRM B:01,PCI,D:00,F:00

The display may go *BLANK* on and off for up to 10 seconds during access to the
EEPROM depending on your display adapter and output device.

Identifying EEPROM...
EEPROM ID (1F,005) : Atmel AT25P512A 2.7-3.6V 512Kx1S, page
Reading adapter firmware image...
Image Size          : 61952 bytes
Version            : 05.73.22.33.43
CRC32              : F98277E8
Subsystem Vendor ID : 0000
Subsystem ID        : 0000
Hierarchy ID       : Normal Board
Build Date         : 05/26/06
Modification Date   : 06/15/06
Saving of image completed.

D:\NUGAN\BIOS>
```

图 3-61 nVIDIA 显卡备份 BIOS 的提示



接下来图解 nVIDIA 显卡 BIOS 刷写过程，输入命令“nv577 7300gt.rom”后，出现提示信息：更新显卡固件？按“Y”键确定，按任意其他键取消操作，如图 3-62 所示（NVFLASH.exe 已改名为 NV577.exe）。

```
D:\UGR\BIOS>nv577 7300gt.rom
NVIDIA Firmware Update Utility (Version 5.77)

Checking for matches between display adapter(s) and image(s)...

Adapter: GeForce 7300 GT      (10DE:0393:0000:0000) H:--:NRM B:01,PCI,D:00,F:00
Current      - Version:05.73.22.33.43 ID:10DE:0393:0000:0000
              G73 Board - p456h1 (Normal Board)
Replace with - Version:05.73.22.33.43 ID:10DE:0393:0000:0000
              G73 Board - p456h1 (Normal Board)
Update display adapter firmware?
Press 'y' to confirm (any other key to abort): -
```

图 3-62 确认刷写的提示

按“Y”键后，出现如图 3-63 所示界面，表示正在更新 EEPROM，此过程键盘三个指示灯会轮流闪亮。

```
D:\UGR\BIOS>nv577 7300gt.rom
NVIDIA Firmware Update Utility (Version 5.77)

Checking for matches between display adapter(s) and image(s)...

Adapter: GeForce 7300 GT      (10DE:0393:0000:0000) H:--:NRM B:01,PCI,D:00,F:00
Current      - Version:05.73.22.33.43 ID:10DE:0393:0000:0000
              G73 Board - p456h1 (Normal Board)
Replace with - Version:05.73.22.33.43 ID:10DE:0393:0000:0000
              G73 Board - p456h1 (Normal Board)
Update display adapter firmware?
Press 'y' to confirm (any other key to abort): y
The display may go BLANK on and off for up to 10 seconds or more during the update process depending on your display adapter and output device.

Identifying EEPROM...
EEPROM ID (1F.0065) : Atmel AT25P512A 2.7-3.6V 512Kx1S, page
Clearing original firmware image...

Storing updated firmware image...
```

图 3-63 更新中的提示信息

稍等一会后，出现更新成功的界面，如图 3-64 所示。

大多数显卡厂商官方网站都不提供 BIOS 程序下载，所以需要平时多积累并在论坛与大家交流共享。

如果 BIOS 刷写过程中提示如下：

- (1) 提示显卡类型不匹配，可考虑使用强制刷写。
- (2) 若强制刷写仍然不行，可能是 ROM 芯片坏、GPU 空焊或者损坏。可通过打 ROM 1、2、5、6 脚数值来判断（需拆除相连的上拉电阻）。



```

Checking for matches between display adapter(s) and image(s)...

Adapter: GeForce 7300 GT      (IBDE:8393,0000,0000) H:--:NRM B:01,PCI,D:00,F:00
Current      - Version:05.73.22.33.43 ID:IBDE:8393:0000:0000
              GT3 Board - p456h1 (Normal Board)
Replace with - Version:05.73.22.33.43 ID:IBDE:8393:0000:0000
              GT3 Board - p456h1 (Normal Board)
Update display adapter firmware?
Press 'y' to confirm (any other key to abort): y
The display may go *BLANK* on and off for up to 10 seconds or more during the update process depending on your display adapter and output device.

Identifying EEPROM...
EEPROM ID (1F,0065) : Atmel AT25FS12A 2.7-3.6V 512Kx13, page
Clearing original firmware image...

Storing updated firmware image...
.....
Verifying update...
Update successful.

D:\NUGEN\BIOS>_

```

图 3-64 更新成功的界面

## 第 4 章

# 焊 接 技 巧

- ◎ 电解电容焊接
- ◎ PCB 断线修补
- ◎ 金手指修补
- ◎ TSOP 封装的焊接
- ◎ mBGA 封装的焊接
- ◎ GPU 加焊
- ◎ GPU 植株



若想修复显卡故障，需要扎实的动手能力和熟练的焊接技巧。对于贴片电容、电阻的焊接，可以使用热风枪。



### 注意

新手宜使用低风速，不要把零件吹跑了。

本章主要讲解常用的焊接技巧和注意事项。由于焊接方法和技巧多种多样，本文仅供新手参考之用。

## 4.1 电解电容焊接

直插式电解电容是显卡中最常见的元件。由于显卡工作环境比较差、温度高，部分质量不好的电容非常容易出现鼓包、爆裂等现象。

有的维修人员，对于电容的焊接都是使用吸锡器将锡孔吸空，然后插入电容焊接。这样的方法并不是不可取，只是有点繁琐，耗费时间而已。

其实，直插式电解电容的焊接有更简单的方法，步骤如下：

(1) 将电烙铁换上刀头，温度调节到 380℃，同时给电容的两个引脚加热，同时加一点锡。这样电容很轻松就可以拔下来了。

(2) 接下来取一只剪好脚的同规格电容，看清正负极，将显卡竖立，左手拿住电容并对准锡孔（见图 4-1）。



图 4-1 电容对准锡孔

(3) 右手持烙铁同时加热两个孔（如果锡不够可以稍微加一点，见图 4-2），即可顺利将电容插入。

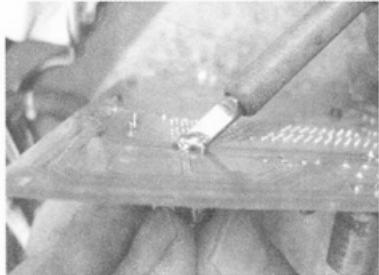


图 4-2 同时加热两个孔



(4) 焊接完毕后, 注意给电容脚分别加锡成45°圆锥状, 不要有连锡、锡尖、虚焊等。

## 4.2 PCB 断线修补

PCB 断线有的是由于电流突然变大把线烧断(见图 4-3), 也有的是因为相互摩擦碰撞的时候把线给碰断了。在拿到一块显卡的时候如果已经判断故障是 PCB 线路损坏的话, 就需要补线了, 具体步骤如下:

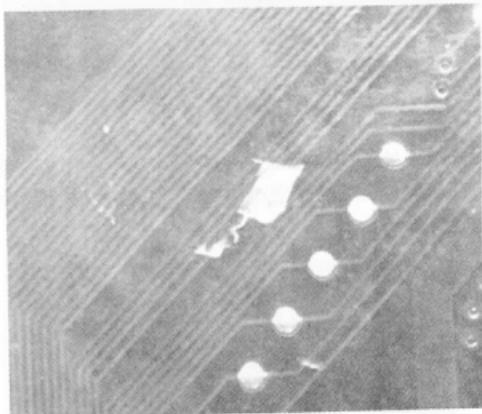


图 4-3 被烧断的 PCB 断线

(1) 使用刀片把断线表面的漆刮去, 露出铜线, 如图 4-4 所示。

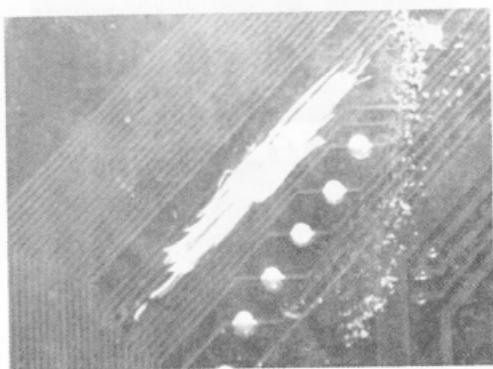


图 4-4 露出铜线

(2) 在铜皮上涂上焊膏并且使用烙铁在铜线上面进行加锡。由于金属是可以沾锡的。所以铜线如果加上锡的话表面就会变成银白色, 如图 4-5 所示。



图 4-5 给铜线上锡

(3) 找一根与 PCB 断裂处的线路粗细一致的铜丝（有专用飞线焊材，也可以使用吸锡线里的铜丝）用同样方法来把铜丝加上焊锡。把铜丝放在 PCB 断线处，使用烙铁加热就可以把断线修补上了，如图 4-6 所示。

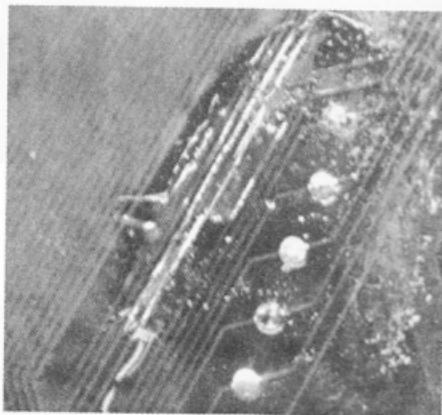


图 4-6 补好的线

(4) 最后清洗一下焊接处，涂上一层绝缘油起到绝缘作用即可。

### 4.3 金手指修补

显卡跟内存一样，如果多次反复从主板上拔插，方法力度不当，可能会导致金手指脱落，供电或接地的引脚也常会因为电流太大导致金手指烧坏。如果是有信号的金手指坏了，就要把金手指修补好，显卡/内存才能正常使用。

金手指的修补比较简单需要的工具有壁纸刀、镊子、细铜丝、502 胶水或者 AB 胶、电烙铁、废卡一片。具体步骤如下：



(1) 用刀把显卡或内存条坏金手指上的底盘刮干净, 如图 4-7 所示。

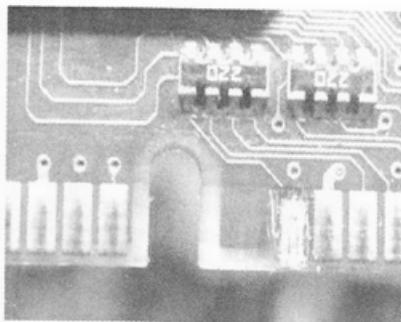


图 4-7 处理底盘

(2) 从报废的卡上用壁纸刀割下同样的金手指, 如图 4-8 所示。

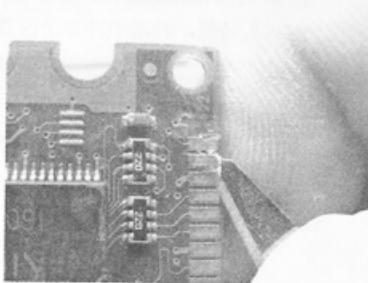


图 4-8 割取金手指

(3) 把割下的金手指背面处理干净后, 用胶水小心地把它对齐粘在待修复的地方, 用平整的硬物把它压平, 如图 4-9 所示。

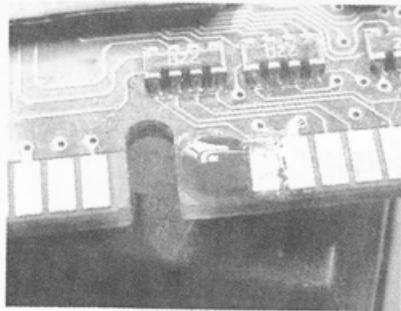


图 4-9 涂胶水



(4) 胶水凝固后, 用壁纸刀把新粘上去的金手指表面清理干净, 如图 4-10 所示。

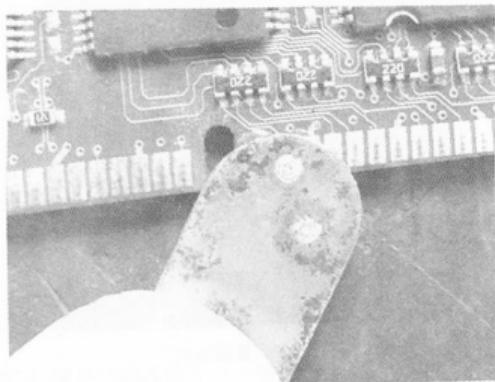


图 4-10 用力压平

(5) 再把原来连接金手指的 PCB 线路阻焊漆刮掉, 涂少量焊膏, 用电烙铁把细铜丝与断线连起来 (见图 4-11), 把多余的线头切断, 轻刮干净多余的胶, 最后清洗一下即可。

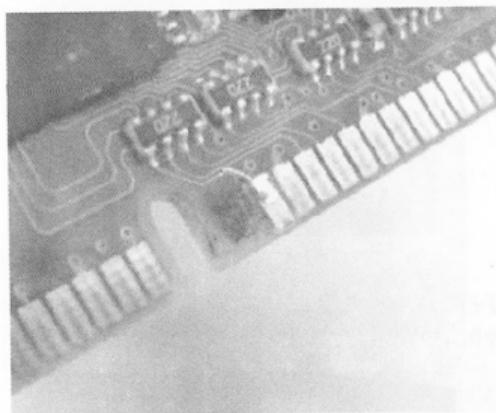


图 4-11 连接信号线

## 4.4 TSOP 封装的焊接

AGP 显卡的显存芯片几乎全部都是 TSOP 封装的, PCI-E 显卡的显存也有很多使用这种封装形式。对于这样封装的芯片, 一定要熟练掌握焊接技巧。焊接的方法有多种, 最终目标是将芯片焊好, 不出现空焊、虚焊、连锡等情况。这里只简单以实物图片的形式介绍一种焊接方法, 步骤如下:



(1) 使用热风枪将芯片吹下来。如图 4-12 所示。

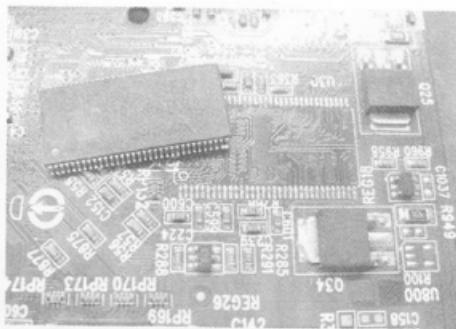


图 4-12 取下芯片

(2) 在芯片引脚上涂点焊膏，如图 4-13 所示。



图 4-13 引脚涂焊膏

(3) 将芯片引脚上的锡尖、连锡等清理干净，如图 4-14 所示。

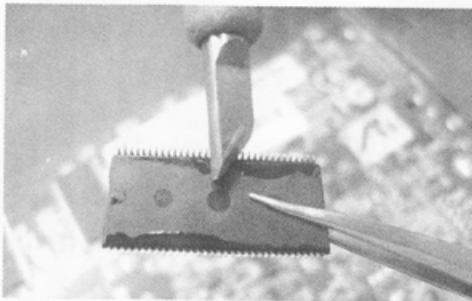


图 4-14 清理引脚



(4) 将焊盘涂少量焊膏，用烙铁把焊盘拖得光亮、饱满，如图 4-15 所示。

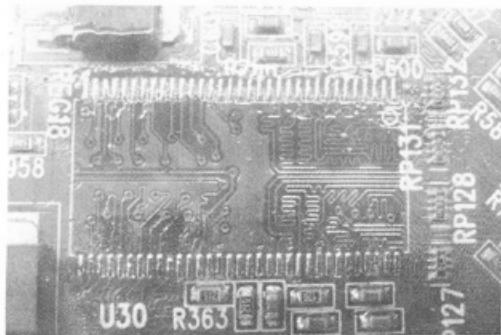


图 4-15 光亮饱满的焊盘

(5) 再次涂少量焊膏在芯片引脚上，放到焊盘上，对齐位置后固定一个脚，如图 4-16 所示。

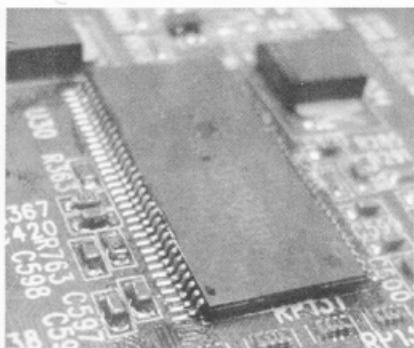


图 4-16 对齐位置

(6) 用镊子轻压芯片，使用烙铁按照一定方向开始焊接引脚，如图 4-17 所示。

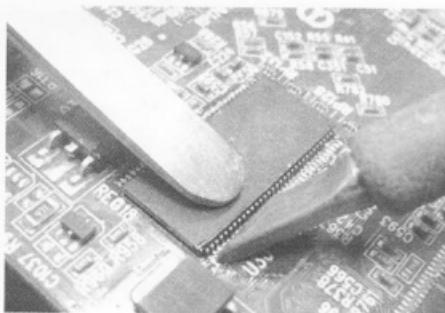


图 4-17 开始焊接



### 注意

此时不要加锡。

(7) 焊接完毕认真检查是否有虚焊、连锡等，若有虚焊，只需补焊一下就可以了。最后清洗干净，如图 4-18 所示。

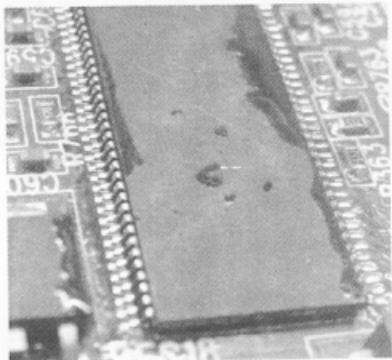


图 4-18 焊接完成

## 4.5 mBGA 封装的焊接

从 DDR2 开始，显存的封装形式不再是 TSOP，而是改为 mBGA 封装。对于这样的微型球栅阵列，焊接时需要采取整体加热的方法，可以使用 BGA 拆焊机，不过有点大材小用；使用热风枪焊接这样的显存，是比较方便，并且经济实惠的。具体步骤如下：

(1) 将热风枪风嘴取下，风速调至 4，温度调至 380℃，旋转加热显存，如图 4-19 所示。

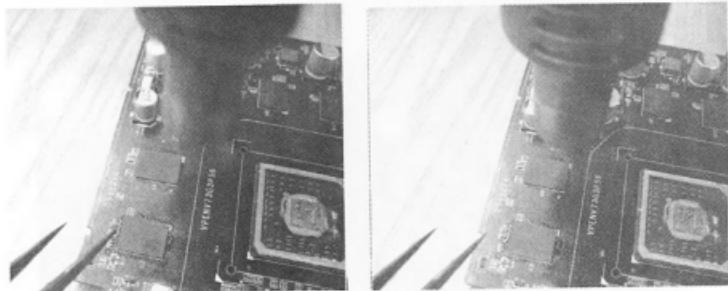


图 4-19 加热显存

(2) 待焊锡熔化后，使用镊子小心地夹起显存，不要碰到周边零件，如图 4-20 所示。

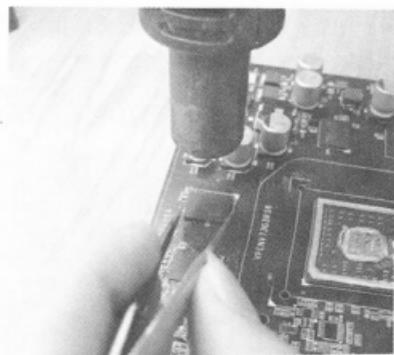


图 4-20 取下显存

(3) 涂少量焊膏在焊盘上，用烙铁将锡稍微拖平整，如图 4-21 所示。

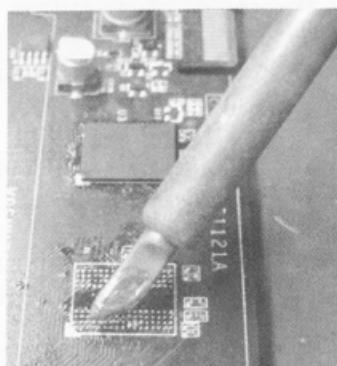


图 4-21 焊盘拖锡

(4) 使用吸锡线，将焊盘吸取干净，如图 4-22 所示。

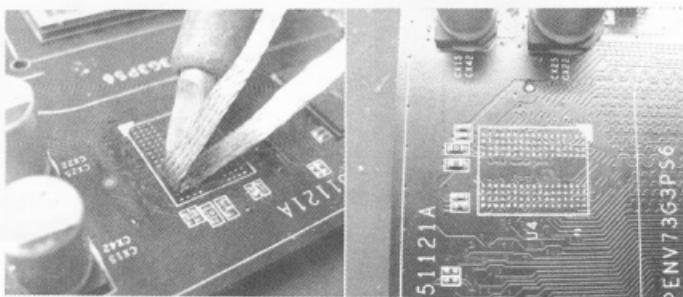


图 4-22 吸平焊盘

(5) 在焊盘和锡珠上都涂上适量的焊膏，如图 4-23 所示。

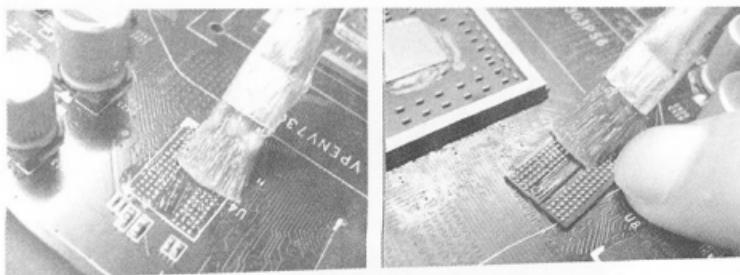


图 4-23 涂焊膏

(6) 把显存放到焊盘上，注意对准位置，如图 4-24 所示。

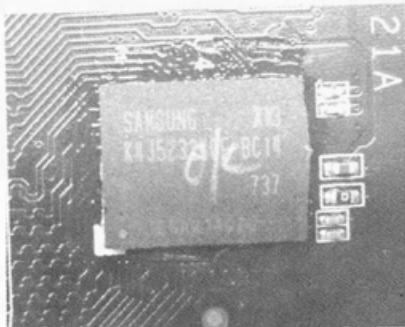


图 4-24 显存对准位置

(7) 快速旋转风枪加热显存及周边范围，如图 4-25 所示。

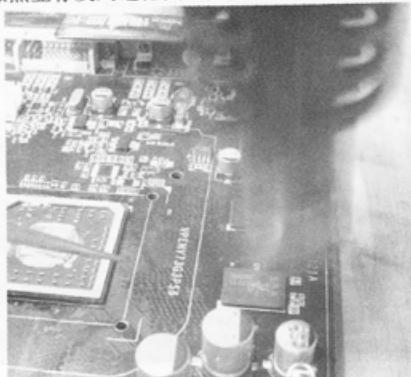


图 4-25 焊接显存



(8) 从侧面观察锡珠熔化程度，锡珠变得很光亮即可，如图 4-26 所示。

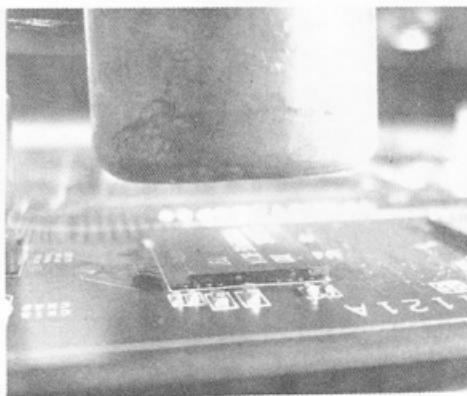


图 4-26 观察锡珠变化

mBGA 的焊接，需要多练习，多总结经验。焊接是否良好，需要实测才能判断。如果有空焊，需要重新加焊显存；若有连锡，那就只能取下显存重新植株了。

## 4.6 GPU 加焊

显卡由于发热量大、工作环境不好等原因，GPU 容易虚焊。尤其是 PCI-E 显卡，时间长了有大量的虚焊出现，会导致各种故障。这时不需要更换 GPU，只需要加焊即可修复。加焊 GPU 的具体步骤如下：

(1) 将显卡散热系统取下，清扫 GPU 周边的积灰，如图 4-27 所示。

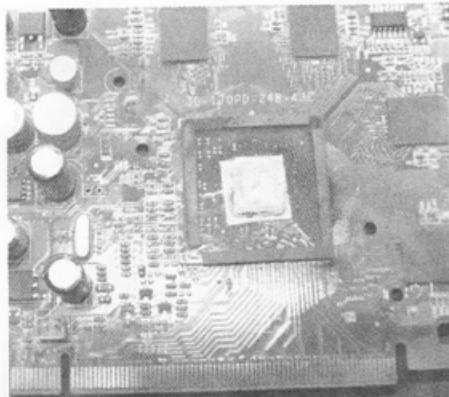


图 4-27 清扫积灰



(2) 涂适量 BGA 专用焊膏在 GPU 旁边，最好在 GPU 的左右两侧，不要涂在金手指边上或者对面，如图 4-28 所示。

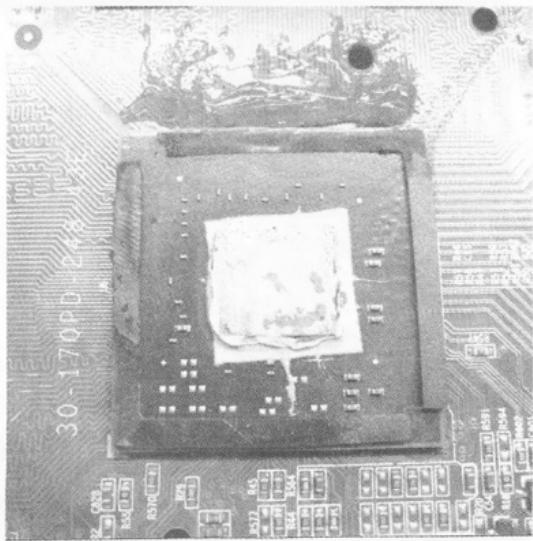


图 4-28 涂焊膏

(3) 将显卡斜放，如图 4-29 所示。

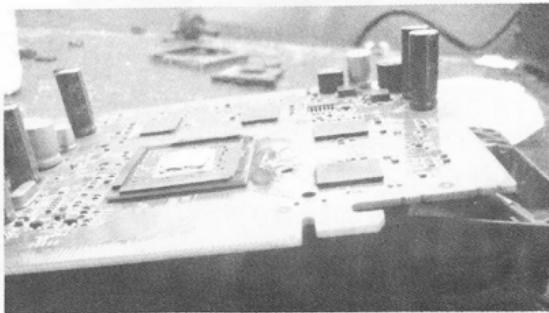


图 4-29 斜放显卡

(4) 风枪温度 300℃，风速 5，对准 GPU 旋转加热，如图 4-30 所示。让焊膏慢慢融化，流入 GPU 下面。



注意  
焊膏不要弄到金手指上。

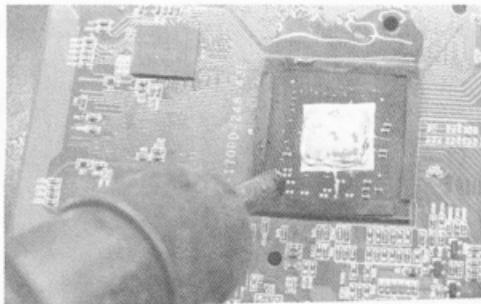


图 4-30 注入焊膏

(5) 将显卡放置在 BGA 拆焊机上，设置好温度曲线，开始加焊，如图 4-31 所示。

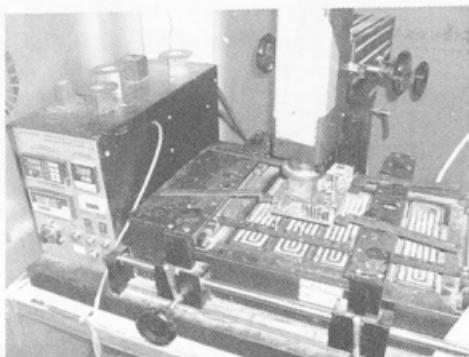


图 4-31 固定显卡

(6) 常用的焊锡分有铅和无铅，熔点分别是  $183^{\circ}\text{C}$  和  $217^{\circ}\text{C}$ 。机器温度运行到熔点时，使用镊子轻推 GPU（见图 4-32）。若能推动，15s 后即可停止加热并冷却，注意推力度不要太大力，否则移位就只能植株了。若不能推动，需要继续加热，直到能推动再恒温 15s 即可。无铅显卡建议使用三温区拆焊机。若使用两温区拆焊机加焊无铅产品，需要使用底部加热法，而且温度不是很好控制，需要多积累经验才行。

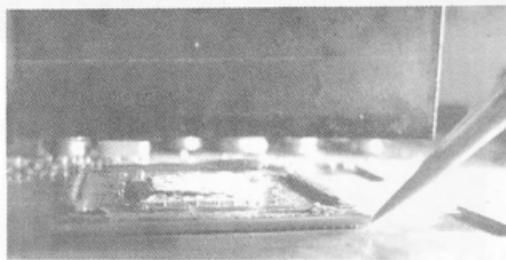


图 4-32 轻推 GPU



(7) 最后, 将 GPU 周边清洗干净, 并涂上散热膏, 装上风扇就可以上机测试了。

## 4.7 GPU 植株

有的故障显卡加焊完 GPU, 但仍旧有空焊; 或者加焊时不小心导致 GPU 连锡, 此时就需要取下重植植株。重植的具体步骤和方法如下:

(1) 使用 BGA 拆焊机小心地取下 GPU, 注意别碰乱周边的零件, 如图 4-33 所示。

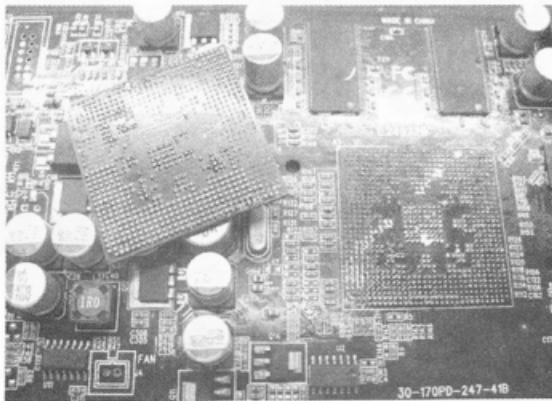


图 4-33 取下 GPU

(2) 将芯片和 PCB 焊点上的锡拖走, 如图 4-34 所示。

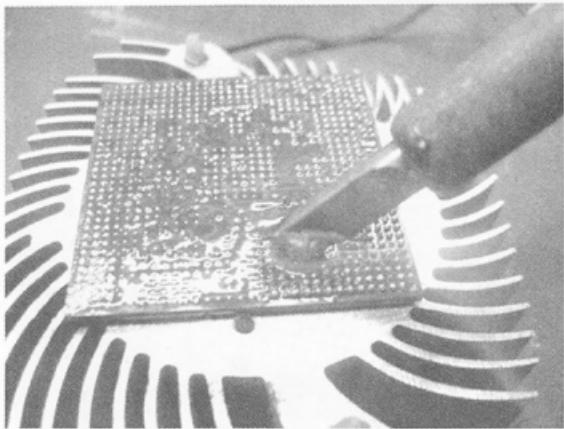


图 4-34 拖锡



(3) 使用吸锡线将焊点吸平并清洗干净, 如图 4-35、图 4-36 所示。

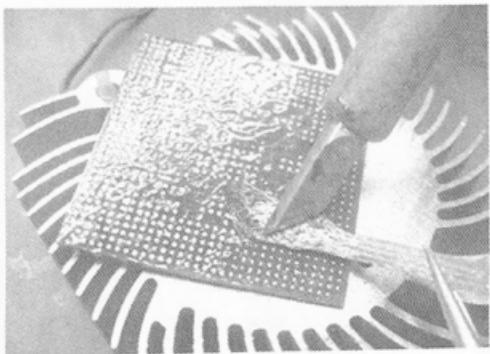


图 4-35 吸平焊点

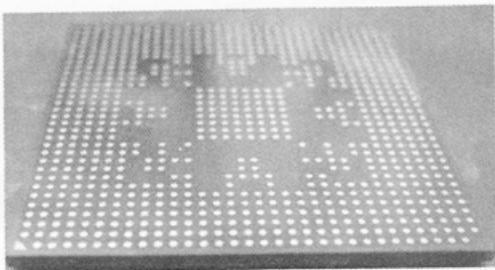


图 4-36 干净平整的芯片

(4) 在 GPU 上涂一层焊膏, 如图 4-37 所示。

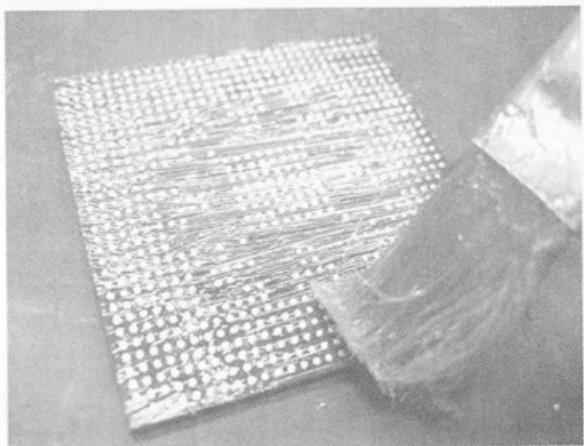


图 4-37 涂焊膏



(5) 将专用钢网放置在芯片上，对齐孔位，如图 4-38 所示。

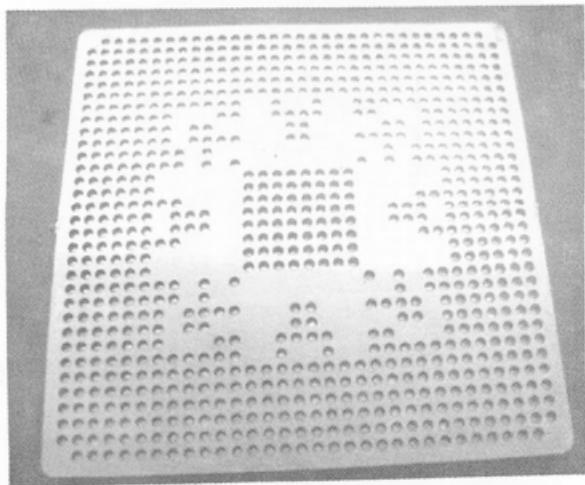


图 4-38 将专用钢网放量在芯片上

(6) 往钢网上慢慢倒锡珠，直到整个钢网都填满了，如图 4-39 所示。

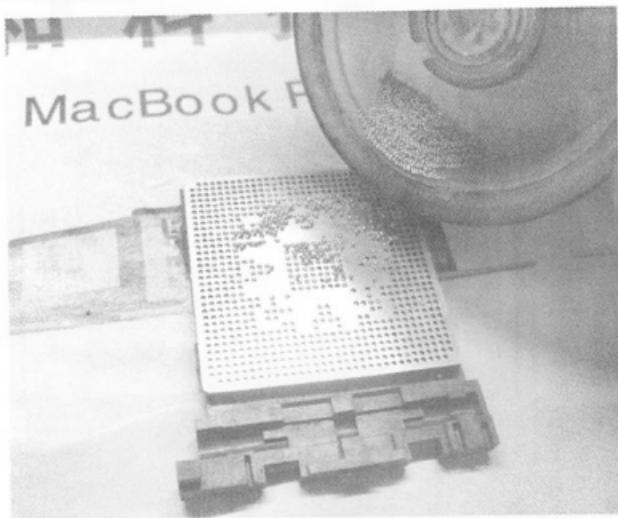


图 4-39 倒锡珠



### 注意

检查是否有遗漏，如图4-40所示。

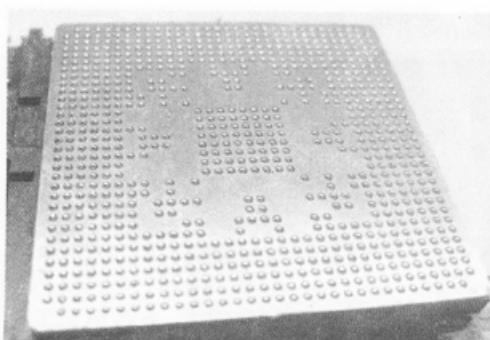


图 4-40 仔细检查

(7) 使用热风枪快速旋转加热 GPU 及周边范围。为了防止钢网变形翘起，可以使用镊子压住两边，如图 4-41 所示。



图 4-41 镊子压住开始吹

(8) 待锡珠熔化后，停止加热，冷却一会取下钢网，如图 4-42 所示。

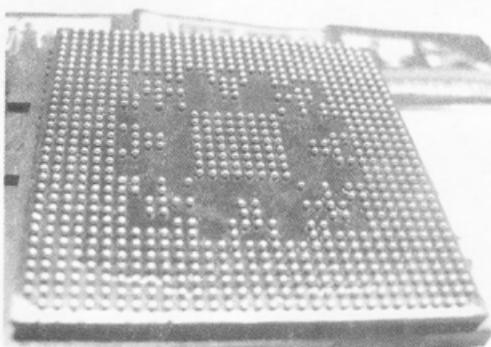


图 4-42 植株完成



(9) 植株完成后即可开始焊接 GPU。将显卡固定在 BGA 机上，如图 4-43 所示。

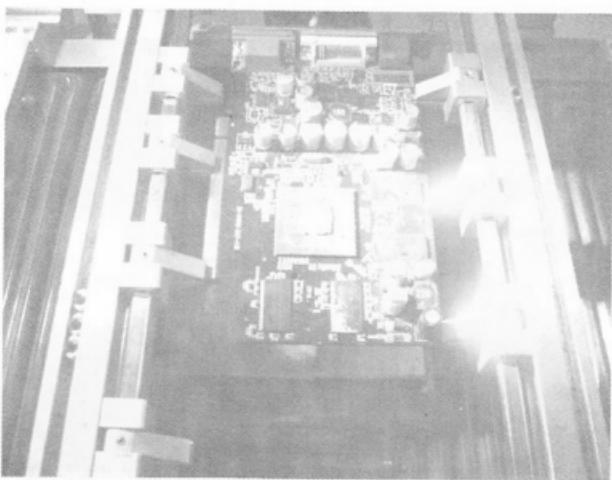


图 4-43 固定显卡

(10) GPU 四周对齐丝印，注意第一脚标志为如图 4-44 所示圆圈所示位置。

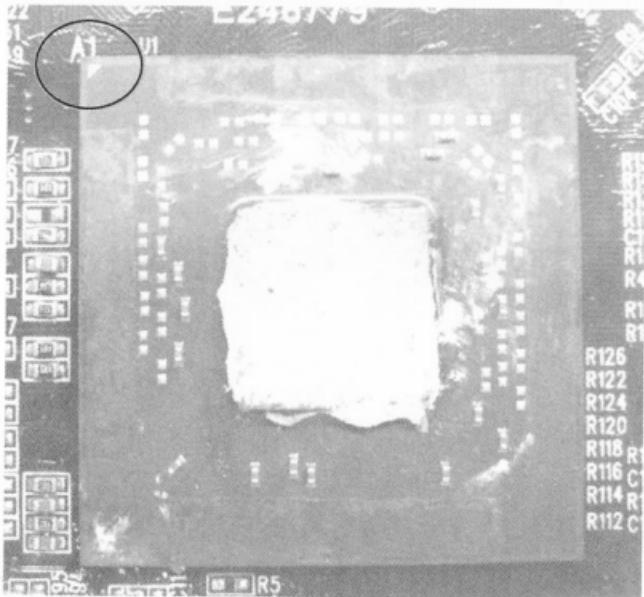


图 4-44 对准位置



(11) 调整好风嘴，开始加热。注意观察锡珠变化，锡珠完全熔化后即可停止加热，如图 4-45 所示。

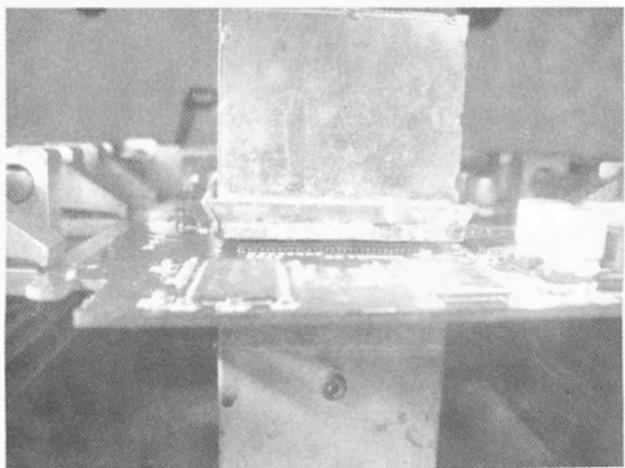


图 4-45 焊接中

(12) 最后取下显卡，清洗 GPU 周边残留焊膏，核心部分涂上散热膏。

# 第 5 章

## 维修实例

- 无显示故障的维修实例
- “花屏”故障的维修实例



## 5.1 无显示故障的维修实例

### 5.1.1 显卡无供电故障

显卡型号：微星 6600

故障现象：点不亮

故障分析：一块 PCI-E 接口微星 6600 显卡点不亮，如图 5-1 所示。



图 5-1 显卡点不亮

(1) 查供电，发现没有核心供电，如图 5-2 所示。



图 5-2 无核心供电



(2) 观察 PCB 正面，发现只有几个场管和线圈，没有 PWM 芯片，如图 5-3 所示。

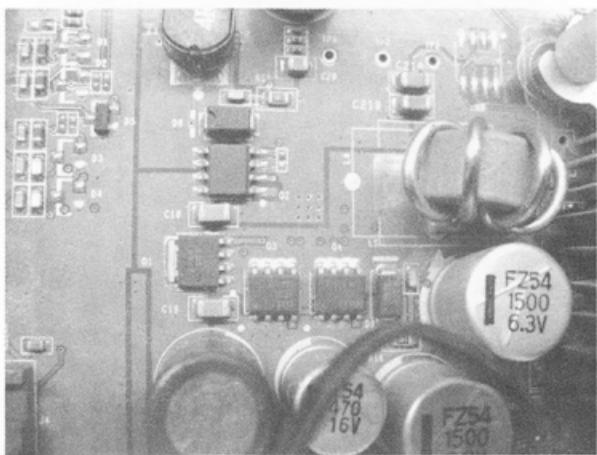


图 5-3 供电电路正面

(3) 反面有一个电源管理芯片，仔细一看，其边上掉了一个元件，如图 5-4 所示。

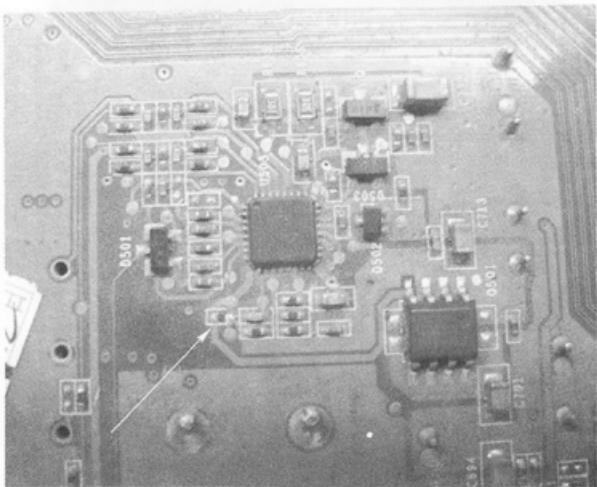


图 5-4 掉件

(4) 找个好的显卡对比一看，掉件是个电阻，测量一下为  $2.7k\Omega$ ，找个相同阻值的电阻补上，如图 5-5 所示。

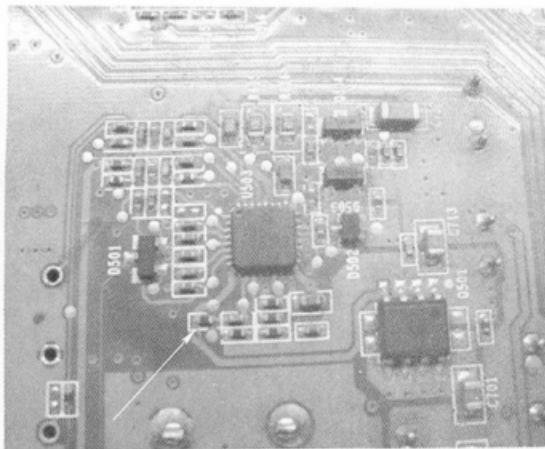


图 5-5 正常的显卡

(5) 再次通电测试，有了核心供电，显卡可以点亮，如图 5-6 所示。

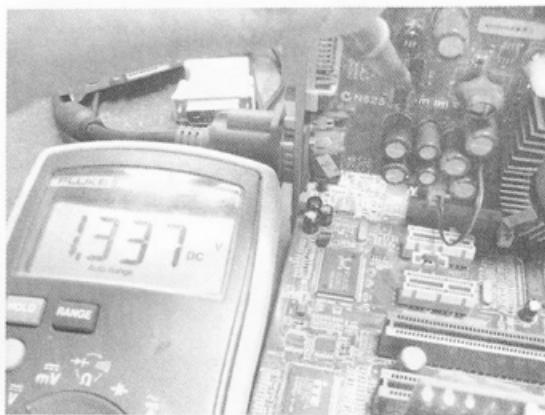


图 5-6 核心供电正常了

总结：一定要仔细观察外观。

### 5.1.2 显卡不亮，需刷 BIOS 解决的故障

显卡型号：七彩虹 6600

故障现象：点不亮

故障分析：正常的主板，只要插上这个七彩虹天行 6600-GD2 CT 超频版显卡（见图 5-7），就会挡在 2b 不动了（此显卡的风扇换了）如图 5-8 所示。使用 PCI 显卡可以显示。

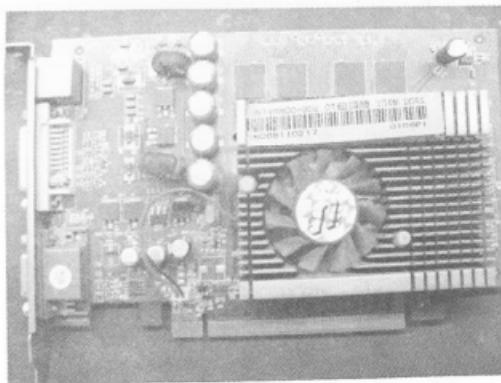


图 5-7 天行 6600 显卡

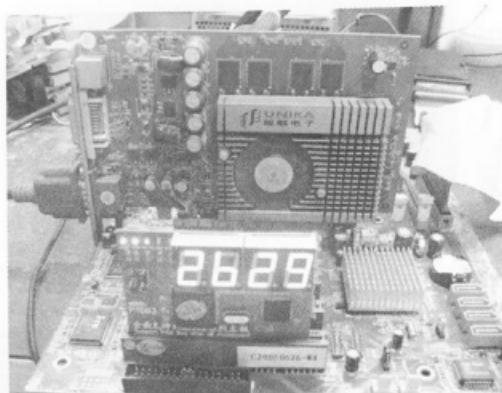


图 5-8 挡在 2b

(1) 启动进 DOS，输入“NV577 -C”，可以显示出核心型号和 BIOS 信息，如图 5-9 所示。

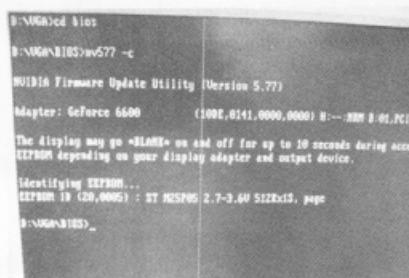


图 5-9 显卡参数



(2) 怀疑是 BIOS 资料损坏导致, 因测试硬盘中没有此显卡的 BIOS 文件, 只得焊下 ROM 芯片放到编程器(见图 5-10)上刷。从 [www.chinafix.com.cn](http://www.chinafix.com.cn) 下载一个七彩虹 6600 超频版 256MB 的 BIOS 刷进去。

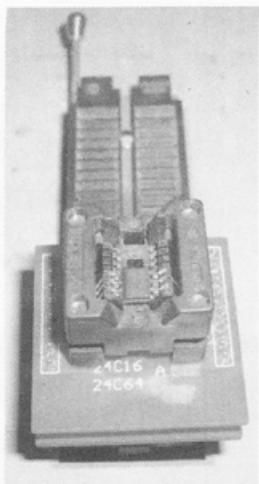


图 5-10 SPI 转接座

(3) 再次通电, 显卡可以顺利过 2b, 有显示了。选择进 DOS, 进入显卡测试程序选择的界面, 如图 5-11 所示。

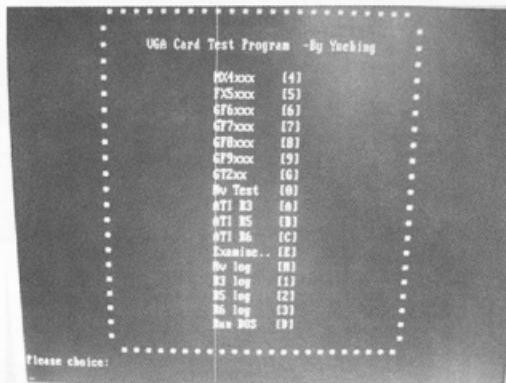


图 5-11 测试程序

(4) 选择 6, 测试 6600 系列显卡(这里设置了只测试 10%), 如图 5-12 所示。  
(5) 测试通过, 如图 5-13 所示。

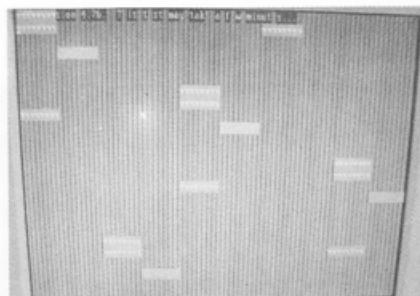


图 5-12 测试中

```

MTS version 4.76. This test may take a few minutes...
Tested from 0 MB to 256 MB.
      LAME   E_DAMO  ERRORS
      -----
FMD(31: 0)          0
FMD(3:32)          0
FCC(31: 0)          0
FCC(3:32)          0

External Bank @ Failing bits:
      None
      Read   Error Count: 0
      Write  Error Count: 0
      Unknown Error Count: 0
      Press any key to continue . . .
      -

```

图 5-13 测试通过

总结：一般挡 2b 多为 BIOS 损坏。使用 BIOS 刷新程序能显示出 BIOS 信息但无显示的多为 BIOS 损坏。

### 5.1.3 7300PCI-E 显卡 GPU 损坏故障

显卡型号：7300 PCI-E 显卡

故障现象：点不亮

故障分析：一片 7300 PCI-E 显卡，nVIDIA 核心，故障为点不亮。

(1) 使用 PCI 显卡启动，在 DOS 下输入“NV577-C”提示找不到显卡，如图 5-14 所示。

```

D:\>NV577-C
NV577  LAM  Z01.33Z  01-29-09  2:07
2 file(s)    728,556 bytes
2 dir(s)     3,021.59 MB free

D:\>NV577-C

NVIDIA Firmware Update Utility (Version 5.77)

ERROR: No NVIDIA Display adapters found
D:\>

```

图 5-14 找不到显卡



(2) 测量显卡的供电，时钟都没问题，开始打 PCI-E 总线的值（反面要量电容靠近 GPU 一端），正常值为 220，如图 5-15 所示。

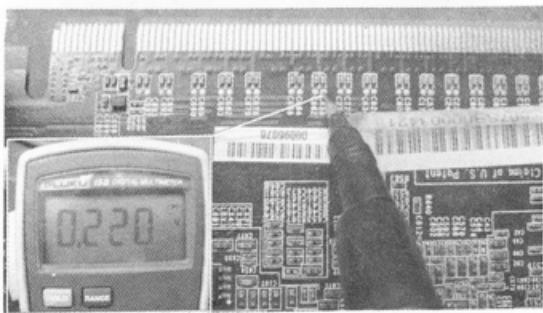


图 5-15 正常数值 220

(3) 测量到有一个点的值为无穷大，表示此点到核心部分有断路，如图 5-16 所示。

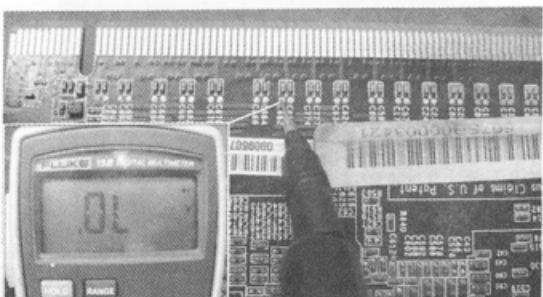


图 5-16 无值断路的测量

(4) 从耦合电容沿着线路跑到 GPU 后面的过孔，如图 5-17 所示。

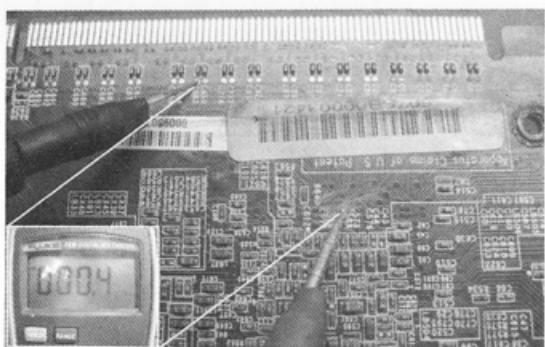


图 5-17 跑线



(5) 既然跑线到达了 GPU，就先把 GPU 拆下来，如图 5-18 所示。

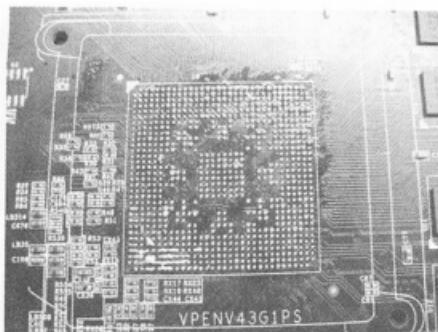


图 5-18 拆下 GPU

(6) 使用镊子，找出这个过孔在对面的相应点位，如图 5-19 和图 5-20 所示。

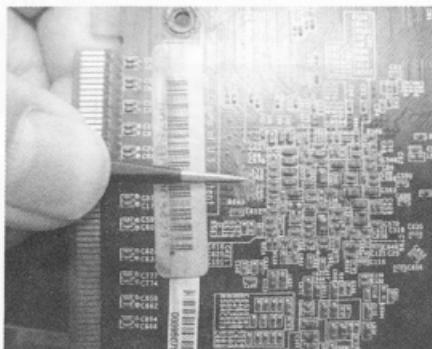


图 5-19 镊子跑线法①

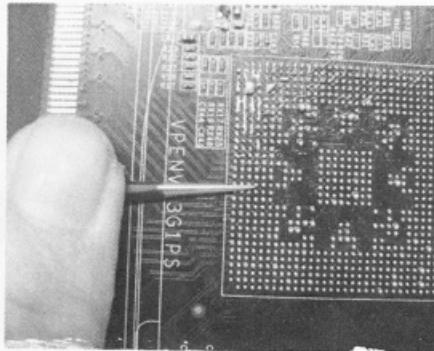


图 5-20 镊子跑线法②



(7) 点位找出来后，测量一下此过线孔，发现该过孔很正常，如图 5-21 所示。

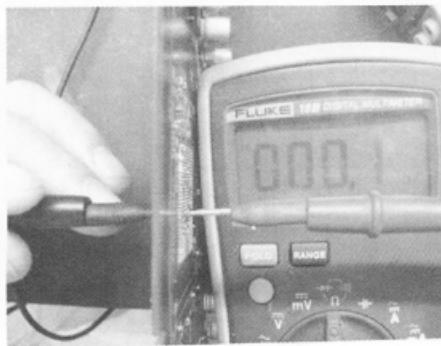


图 5-21 过孔是通的

(8) 既然从电容到 GPU 底下的焊点是通的，基本可以判断 GPU 是坏的。接下来验证我们的判断，看清楚这个点位的坐标位置：从下数第 14 横排第 4 个（见图 5-22）。

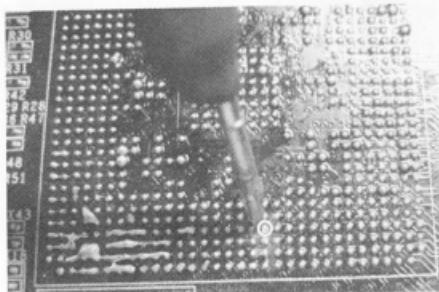


图 5-22 对应点位

(9) 把 GPU 位置对好，看清第一脚的位置，如图 5-23 所示。

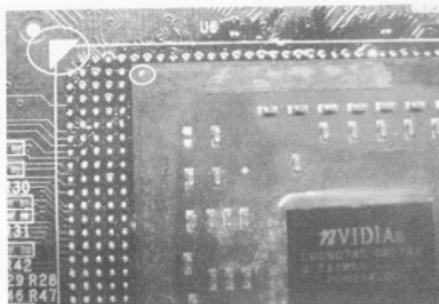


图 5-23 第一脚位置



(10) 把 GPU 翻过来，找出 GPU 对应的点位，如图 5-24 所示。

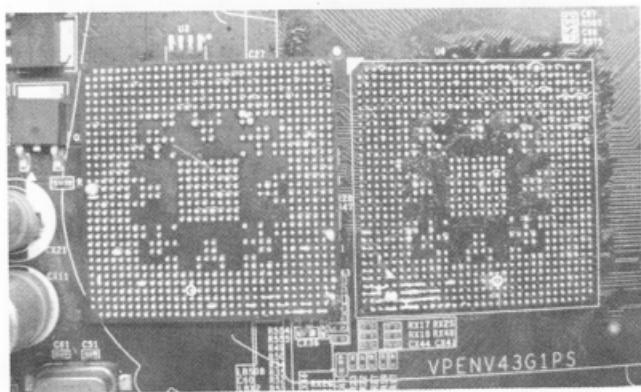


图 5-24 对应位置

(11) 通过以上方法，已经找出这个信号线在 GPU 的位置了。通常情况下，BGA 封装的芯片的中间部分都是地线，如图 5-25 所示。

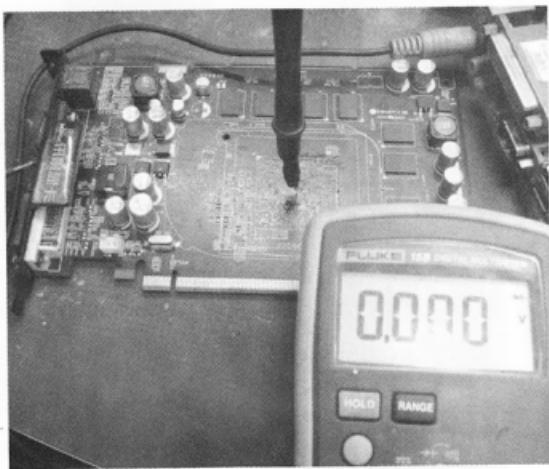


图 5-25 中间接地

(12) 万用表一针接地，一针接信号线，为无穷大，如图 5-26 所示，证明 GPU 损坏。更换 GPU 后，显卡正常。

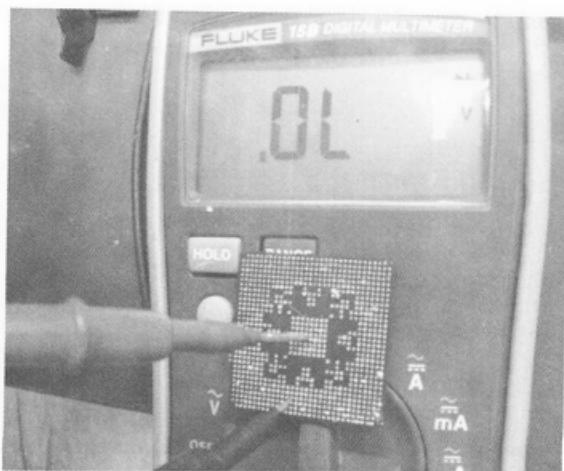


图 5-26 判定 GPU 坏

#### 5.1.4 七彩虹 GeForce 6500 显卡空焊故障

显卡型号：七彩虹 GeForce 6500

故障现象：无显示

故障分析：此显卡无显示，首先把金手指擦干净，依旧无显示。

(1) 使用 PCI 显卡进 DOS，输入“nv -c”不能识别出 GPU 型号，如图 5-27 所示。

```
D:\UGA\NATS>cd..
D:\UGA>cd bios
D:\UGA\BIOS>nv -c
NVIDIA Firmware Update Utility (Version 5.50)

ERROR: No NVIDIA display adapters found
D:\UGA\BIOS>
```

图 5-27 识别不到显卡

(2) 测量显卡主供电有 1.288V，如图 5-28 所示。

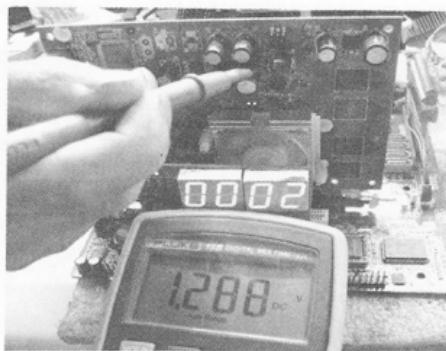


图 5-28 核心供电

(3) 测量显存供电为 2.0V，正常，如图 5-29 所示。



图 5-29 显存供电

(4) 测量 5V 供电也正常，如图 5-30 所示。



图 5-30 5V 供电



(5) 测量 27MHz 时钟正常 (注：示波器问题导致重影)，如图 5-31 所示。

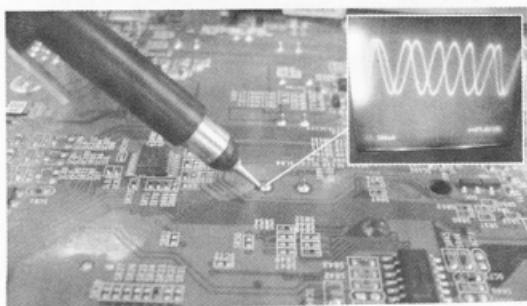


图 5-31 27MHz 波形

(6) 接下来开始打值了。PCI 显卡正反面细线都需要测量，如图 5-32 所示。



图 5-32 正面打值

(7) 反面测量耦合电容靠近 GPU 一端，值应该一致，如图 5-33 所示。

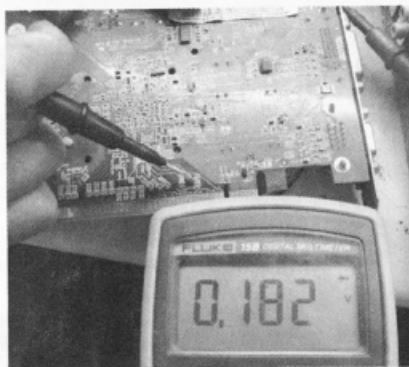


图 5-33 反面打值



(8) 刚量到第2颗电容就发现了有不对，如图 5-34 所示。

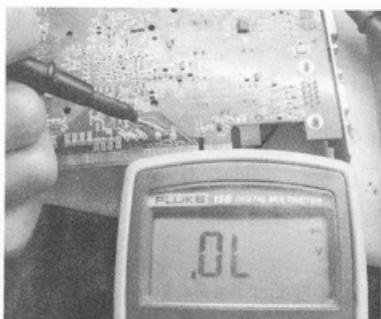


图 5-34 值无穷大

(9) 二极体值无穷大，表示有断路，检查线路没有断线，那就只可能是 GPU 损坏或空焊，或者 PCB 过孔不通，不管是哪种原因，都要先加焊 GPU。果然，加焊完 GPU 后阻值就正常了，如图 5-35 所示。

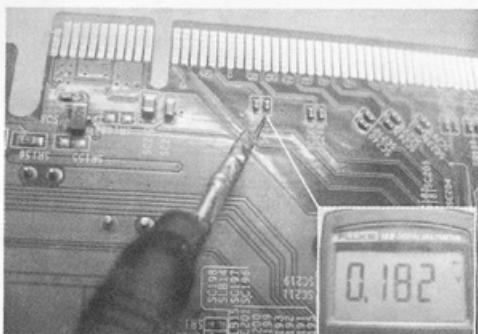


图 5-35 阻值正常了

(10) 使用“nv -c”命令检查，正常显示 GPU 和 BIOS 信息，如图 5-36 所示，说明 MATS 测试全部通过。

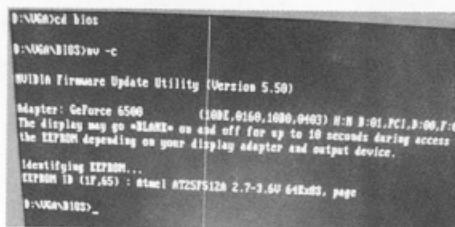


图 5-36 检测到显卡



总结：空焊导致检测不到显卡，很多可以通过测量金手指的阻值来找出来故障。

### 5.1.5 影驰 8500GT 显卡空焊故障

显卡型号：影驰 8500GT

故障现象：点不亮

故障分析：一片影驰 8500GT 显卡（见图 5-37），上机不显示，测量几大供电、时钟、复位、27MHz 晶振都正常，主板蜂鸣器报警提示检测不到显卡。

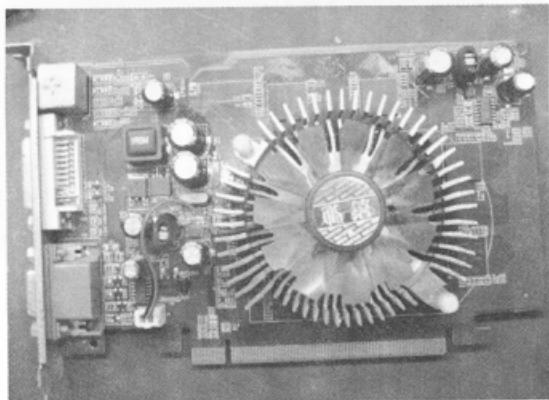


图 5-37 影驰 8500GT 显卡

(1) 用 PCI 显卡（见图 5-38）排除是否 BIOS 损坏导致检测不到显卡。

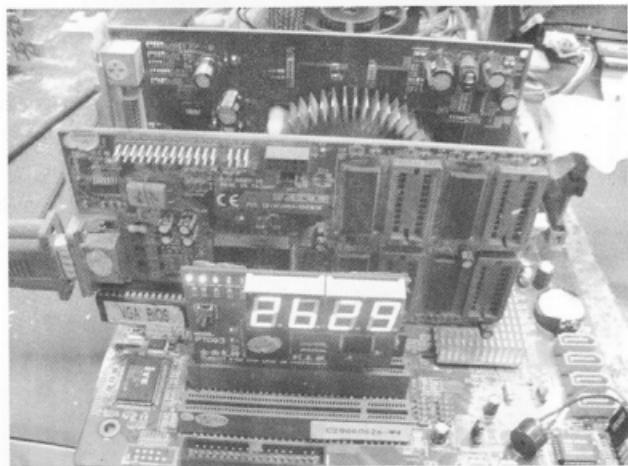


图 5-38 PCI 显卡（下面的显卡是 PCI 显卡）



(2) 进入 DOS，输入“nv577 -c”命令，如图 5-39 所示。

```
D:\>UGA\BIOS>dir
Volume in drive D is UGA
Volume Serial Number is 000A-002E
Directory of D:\UGA\BIOS

        0 file(s)      0 bytes free
D:\>UGA\BIOS>nv577 -c...
```

图 5-39 输入“nv577 -c”命令

(3) 返回结果为没有找到 nVIDIA 显卡，如图 5-40 所示。

```
D:\>UGA\BIOS>dir
Volume in drive D is UGA
Volume Serial Number is 000A-002E
Directory of D:\UGA\BIOS

        0 file(s)      0 bytes free
D:\>UGA\BIOS>nv577 -c
NVIDIA Firmware Update Utility (Version 5.77)

CRITICAL: No NVIDIA Display adapters found
D:\>UGA\BIOS>...
```

图 5-40 找不到显卡

(4) 工作条件都正常，却检测不到显卡，一般为插槽总线故障。检查没有外观掉件断线问题，送去加焊，回来再次检测，就能检测到显卡了，如图 5-41 所示。拔掉 PCI 显卡直接测试，通过测试，此卡修复。

```
D:\>UGA\BIOS>nv577 -c
NVIDIA Firmware Update Utility (Version 5.77)

Adapter: GeForce 8500 GT (000E,0421,100E,0415) H:--:MM:0:01,PCT,0:00,F:00
The display may go <BLANK> on and off for up to 10 seconds during access to the
EEPROM depending on your display adapter and output device.

Identifying EEPROM...
EEPROM ID (1F,00005) : Intel AT25PS128 2.7-3.6V 512Kx13, page
D:\>UGA\BIOS>...
```

图 5-41 检测到显卡



### 5.1.6 杂牌 GeForce7300 显卡无显示故障

显卡型号：杂牌 GeForce7300

故障现象：无显示

故障分析：故障为无显示，但显示器指示灯亮黄灯。

(1) 在使用主板蜂鸣器时发现有报警一声，应该是主板识别到了显卡。此类故障一般为显卡的输出电路部分问题导致。观察显卡的输出接口电路（见图 5-42），有个 7805 芯片，测量出其有 5V 输出，说明输出接口电路正常。

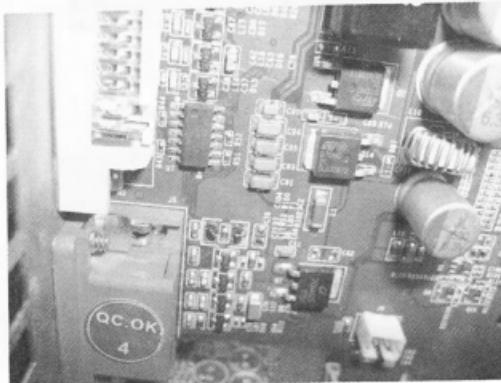


图 5-42 显卡接口供电 7805

(2) 接下来需要检测的是显卡的行、场同步信号，观察行、场信号的电路，发现是从 GPU 出来经过 08 门后到达显卡接口的。08 门的内部结构如图 5-43 所示，11、8、3、6 脚为输出脚。

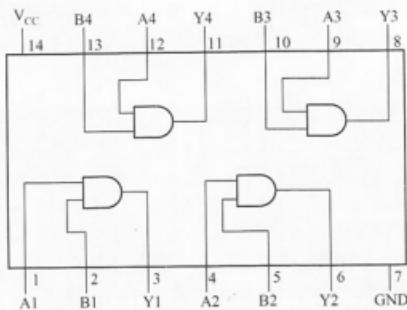


图 5-43 08 门的内部结构

(3) 使用示波器测量，只检测到行同步信号正常，如图 5-44 所示。

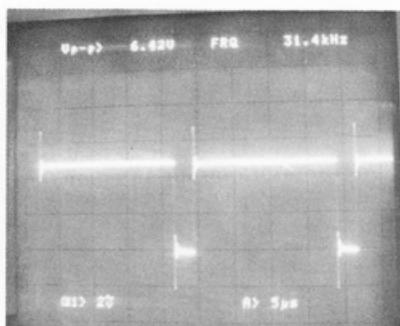


图 5-44 行同步信号

(4) 没有测量到场同步信号, 如图 5-45 所示。

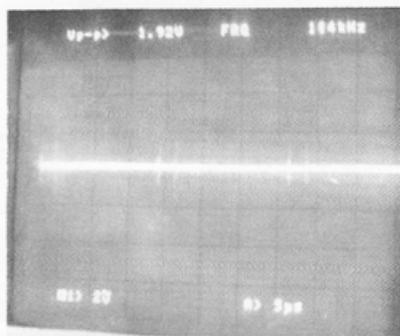


图 5-45 没有测量到场同步信号

(5) 既然只有行同步信号, 没有场同步信号, 可以通过对比测阻值找出问题。先测量行同步信号输入端对地值为 425, 如图 5-46 所示。



图 5-46 测量行同步信号



(6) 测量场同步信号的输入端，打值居然有 665，明显偏大，如图 5-47 所示。

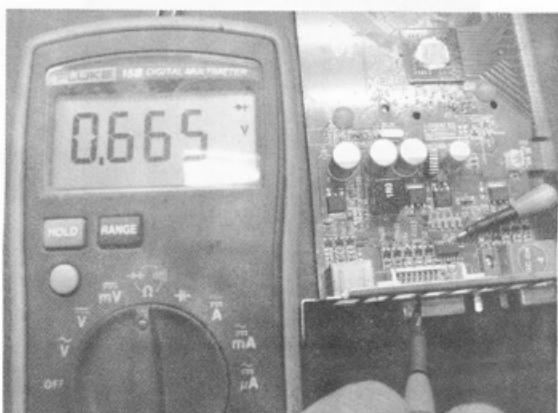


图 5-47 测量场同步信号

(7) 从 08 门的输入端开始跑线，经过一小段线路后，穿过 PCB 到达反面，此位置有 4 个过线孔，如图 5-48 所示。

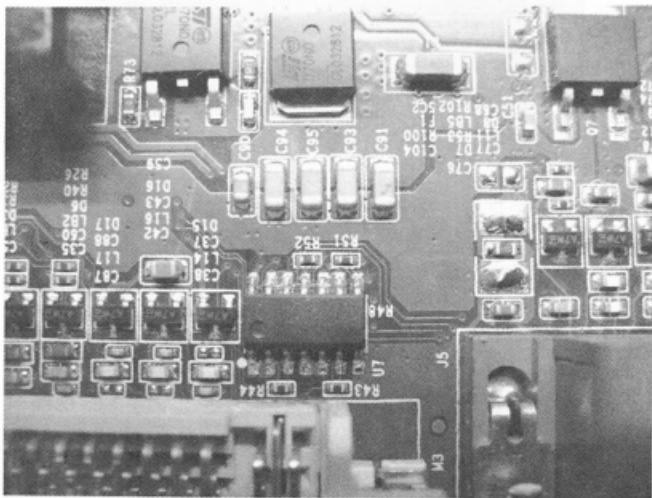


图 5-48 行场同步线路走向 1

(8) 反面的 4 个过孔也很明显，非常容易找到，如图 5-49 所示。

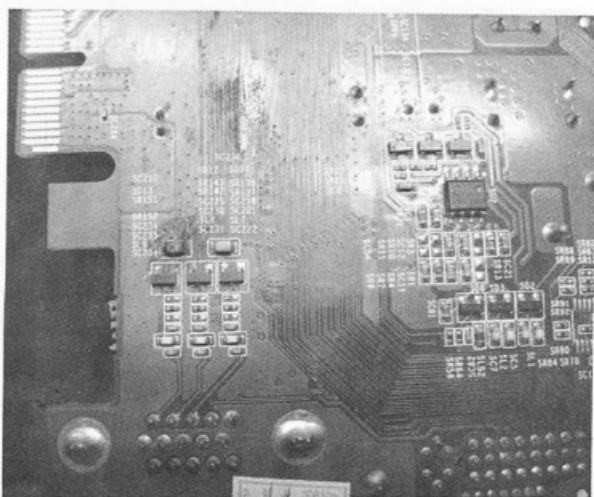


图 5-49 行场同步线路走向 2

(9) 沿着对应的过孔跑线，在靠近 GPU 的位置刮开线路打值，发现值为 428，接近正常，如图 5-50 所示。

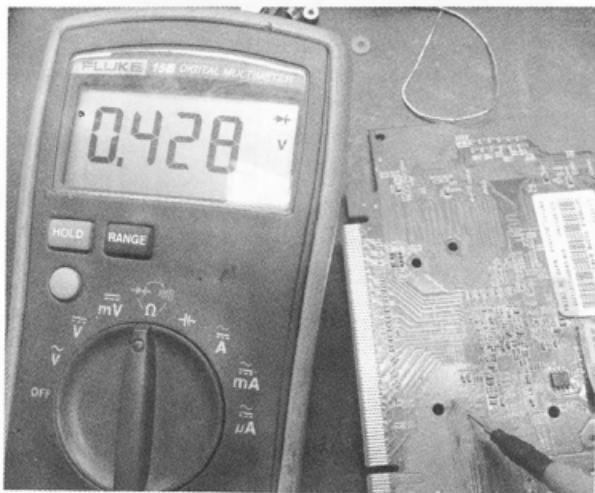


图 5-50 测量靠近 GPU 一端二极体值

(10) 用此可以怀疑是 GPU 到 08 门的输入端间有断路了，将 PCB 刮开，果然发现有轻微的断线，如图 5-51 所示。



图 5-51 PCB 有腐蚀

(11) 将故障位置放大的特写如图 5-52 所示。

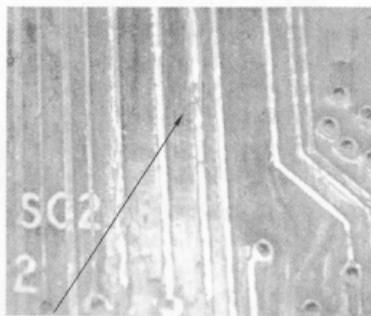


图 5-52 PCB 腐蚀断线

将线补好后，再次上机测试，顺利点亮。3D 也测试 OK，显卡修复。

## 5.2 “花屏”故障的维修实例

### 5.2.1 5200 显卡“小花”故障

显卡型号：七彩虹 5200

故障现象：“花屏”

故障分析：客户送修一个七彩虹 5200 显卡（见图 5-51），说是“花屏”。

(1) 上机测试发现开机有少许花屏，文字有彩色线条。使用测试程序，选择 5，测试 5200 系列的显卡，很快返回测试结果，报 C 通道 15 号数据位出错，如图 5-54 所示。

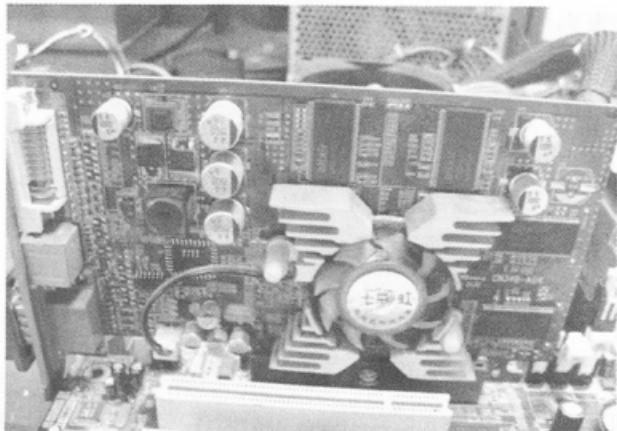


图 5-53 七彩虹 5200 显卡

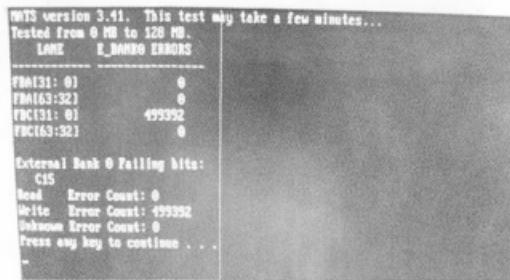


图 5-54 C15 报错

(2) 根据 5200 显卡的显存排列图, 找出大概位置在上面一排显存的左边, 然后使用短接法, 人为制造错误数据位(短接 5、6 脚), 如图 5-55 所示。

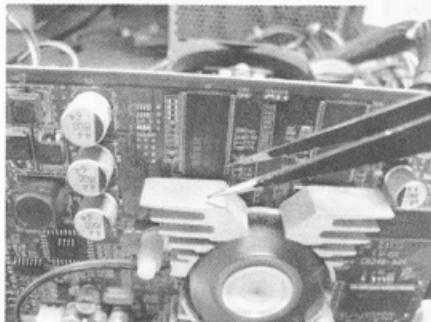


图 5-55 短接显存



(3) 结果出来了，多了个 C10 数据位出错，如图 5-56 所示。

```

MTS version 3.41. This test may take a few minutes...
Tested from 0 MB to 128 MB.
LANE   I_BANK0 ERRORS
FIFO[31: 0]      0
FIFO[63:32]      0
FBC[31: 0]      794935
FBC[63:32]      0

External Bank @ Falling bits:
C10 C15
Read   Error Count: 80
Write  Error Count: 794055
Unknown Error Count: 0
Press any key to continue ...

```

图 5-56 新增 C10 报错

(4) 由此可以断定 C15 一定在这个颗粒的这一排。打值即可找出问题原因。正常为 468 如图 5-57 所示。

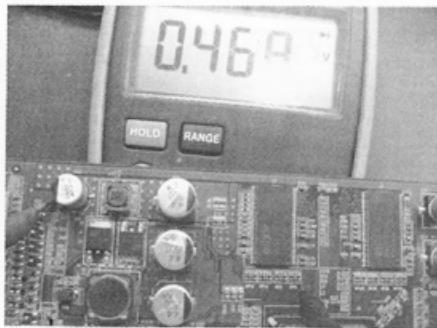


图 5-57 正常值 468

(5) 打到有一处为 22，说明有短路，如图 5-58 所示。

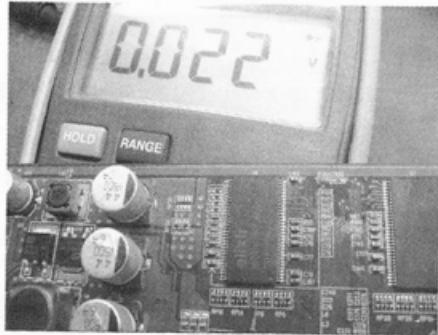


图 5-58 值小短路



(6) 量排阻靠近显存的一端，值更小，说明是显存短路，如图 5-59 所示。

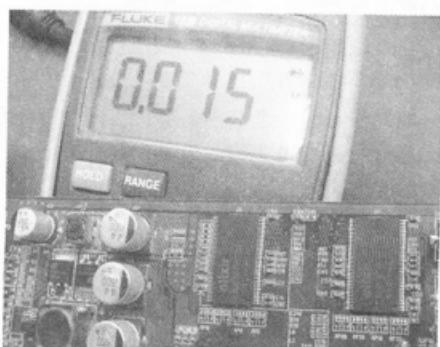


图 5-59 显存短路

(7) 更换一个显存颗粒后，打值正常，如图 5-60 所示。

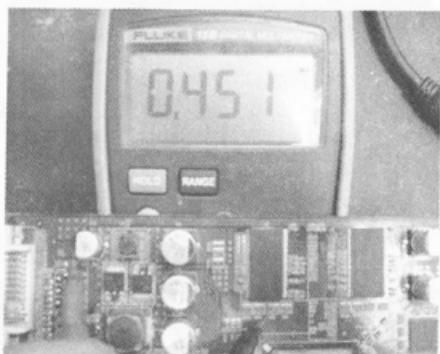


图 5-60 打值正常

(8) 上机不花了，使用 MATS 程序测试通过，如图 5-61 所示。

```
MATS version 3.41. This test may take a few minutes...
Tested from 0 MB to 128 MB.
LANE E_BAMO ERRORS
FBA[31: 0] 0
FBA[63:32] 0
FBC[31: 0] 0
FBC[63:32] 0

External Bank 0 Failing bits:
None
Read Error Count: 0
Write Error Count: 0
Unknown Error Count: 0
Press any key to continue . . .
```

图 5-61 测试通过



### 5.2.2 技嘉 6600 显卡空焊的“小花”故障

显卡型号：技嘉 GA-N66L128DP

故障现象：花屏（“小花”）

故障分析：收到此显卡，客户说是一个电容被撞了一下。然后就花屏了。

(1) 上机检测，MATS 程序显示 C39 报错，如图 5-62 所示。

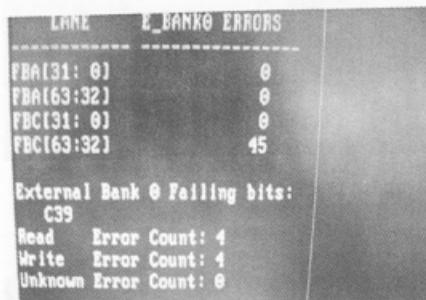


图 5-62 C39 报错

(2) 查看测试结果，此卡为 6600LE，显存分 A 和 C 两个通道，然后依次短接显存每个芯片的最后两个脚和 5、6 脚，得到如图 5-63 所示的排列图。

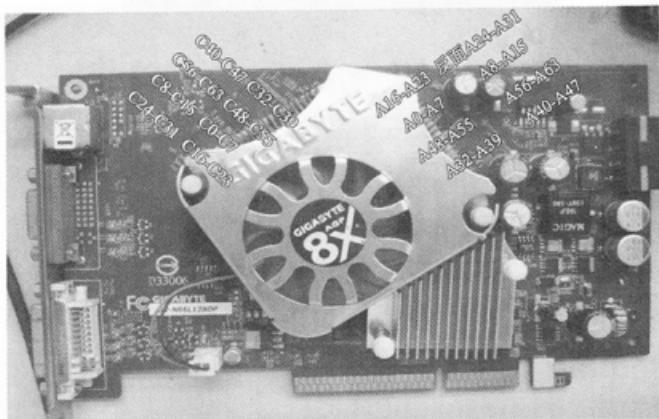


图 5-63 显存排列图

(3) 查此种显存芯片的脚位定义图，如图 5-64 所示。



	x16		x16
VDD	1	66	VSS
DQ0	2	65	DQ15
VDDQ	3	64	VSSQ
DQ1	4	63	DQ14
DQ2	5	62	DQ13
VSSQ	6	61	VDDQ
DQ3	7	60	DQ12
DQ4	8	59	DQ11
VDDQ	9	58	VSSQ
DQ5	10	57	DQ10
DQ6	11	56	DQ9
VSSQ	12	55	VDDQ
DQ7	13	54	DQ8
NC	14	53	NC
VDDQ	15	52	VSSQ
LDQS	16	51	UDQS
NC	17	50	NC
VDD	18	49	VREF
NC	19	48	VSS
LDM	20	47	UDM
/WE	21	46	/CK
/CAS	22	45	CK
/RAS	23	44	CKE
/CS	24	43	NC
NC	25	42	NC
BA0	26	41	A11
BA1	27	40	A9
A10/AP	28	39	A8
A0	29	38	A7
A1	30	37	A6
A2	31	36	A5
A3	32	35	A4
VDD	33	34	VSS

图 5-64 DDR 显存脚位图

(4) 然后使用万用表二极管挡打显存的数据位，正常值为 260，如图 5-65 所示。

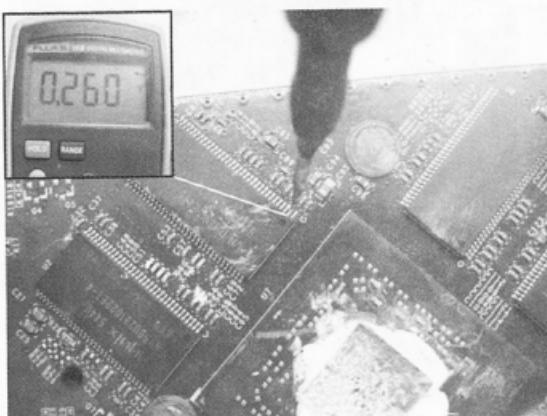


图 5-65 正常值 260



(5) 打到有一脚为 440, 如图 5-66 所示。

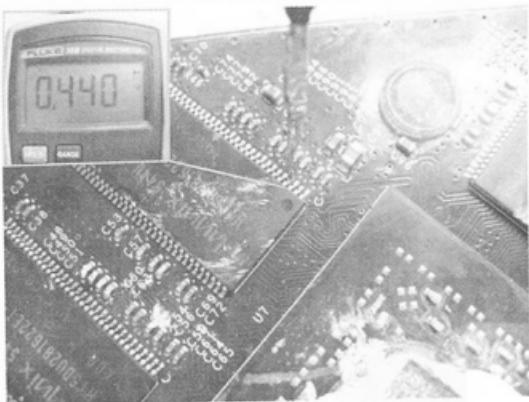


图 5-66 值偏大

(6) 仔细观察显存, 此脚没有虚焊, 轻压 GPU, 此脚数值马上变为 260。

(7) 确定 GPU 空焊, 加焊 GPU 后, 故障解决, 最后用 MATS 程序测试通过, 如图 5-67 所示。

```

MATS version 4.76. This test may take a few minutes...
Tested from 0 MB to 128 MB.
LANE   E_BANKING ERRORS

F00[31: 0]      0
F00[63:32]      0
F0C[31: 0]      0
F0C[63:32]      0

External Bank 0 Failing bits:
None
Read  Error Count: 0
Write Error Count: 0
Unknown Error Count: 0
Press any key to continue . . .
-
```

图 5-67 测试通过

### 5.2.3 9550 显卡花屏故障

显卡型号: 杂牌 9550

故障现象: 花屏

故障分析: 接修一片杂牌 9550 显卡 (见图 5-68), GPU 被人加焊过。

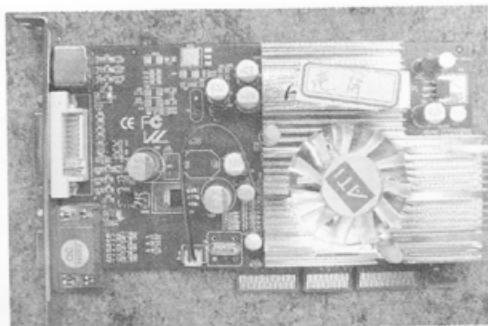


图 5-68 故障显卡 9550

- (1) 首先外观检查没有发现掉件烧坏等外观故障。  
 (2) 使用 R3MEMID 测试，程序显示 B 通道 56~63 数据位出错，如图 5-69 所示。

```

R3MEMID Version 1.07, (c) Copyright ATI Technologies Inc., 2003
TEST RESULT SUMMARY:
-----[REDACTED]-----
M9550 (0x4153) detected.
128M video memory.
Test suite ran 1 of 1 times.
Checking test status array ...
11 3 FAIL : FAIL
    Error ID 0x00001
    1024 x 768 - 32 bpp (< 60 Hz): TEST FAILURE
    failing bit : M9550 56 57 58 59 60 61 62 63
12 3 Data line toggle (GUI)
    Error ID 0x00023
    1024 x 768 - 32 bpp (< 60 Hz): TEST FAILURE
    failing bit : M9550 56 57 58 59 60 61 62 63
Failure detected.
Press '1' key to continue ...
  
```

图 5-69 测试报错

- (3) 使用短接数据线法找出此卡的显存数据位分布图，如图 5-70 所示。

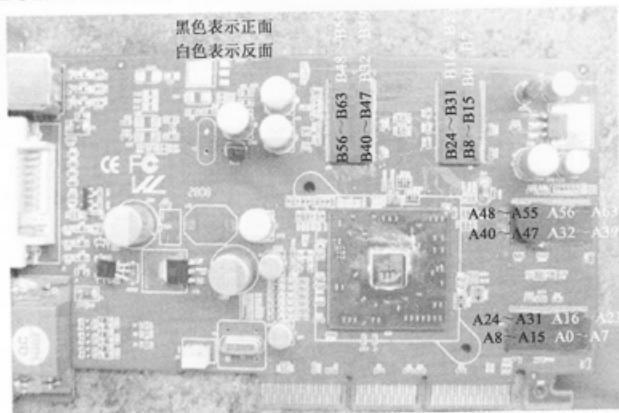


图 5-70 显存分布图



(4) 由于此卡出错的数据位为 B56~B63, 根据 R3MEMID 的使用说明以及 DDR 显存颗粒的脚位定义图可以把排查的范围缩小到 47 脚 (UDM)、51 脚 (UDQS) 以及 8 个数据位全部出错 (概率很小吧, 呵呵)。于是对两个控制线打值, 47 脚为 341, 如图 5-71 所示。



图 5-71 41 脚正常值 341

(5) 打 51 脚值为 443, 有异常了, 如图 5-72 所示。



图 5-72 51 脚打值不正常

(6) 由于旁边这个显存没有报错, 可以对比打值, 发现其 51 脚为 334, 如图 5-73 所示。



图 5-73 对比测阻值



(7) 就是此 51 脚有问题导致 8 个数据位全部出错，仔细看线路发现连接一个 000 电阻，量电阻另一头值为 335，如图 5-74 所示。



图 5-74 51 脚打值为 335

(8) 使用欧姆挡量测此电阻阻值，确认电阻损坏，如图 5-75 所示。

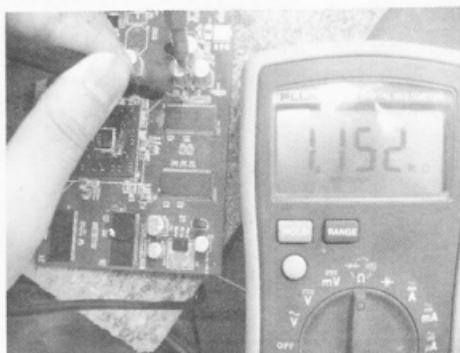


图 5-75 通过测量判断电阻坏

(9) 更换电阻后，51 脚打值正常，如图 5-76 所示。

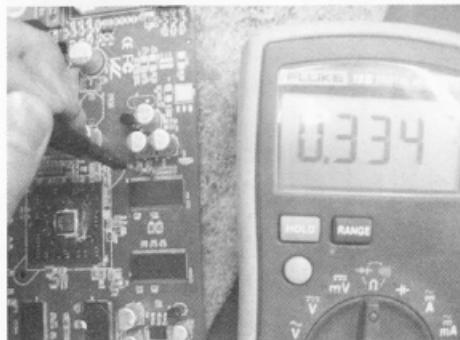


图 5-76 51 脚打值正常



(10) 运行 R3MEMID 测试正常通过。

### 5.2.4 铭瑄 8500GT 显卡空焊故障

显卡型号：铭瑄 8500GT

故障现象：花屏

故障分析：今天收到一片铭瑄 8500GT 显卡（见图 5-77），拿到手一看，发现电容爆了。

(1) 先给上机测试故障重现一下，如图 5-78 所示。这么花，基本看不到了，只能先换电容了。

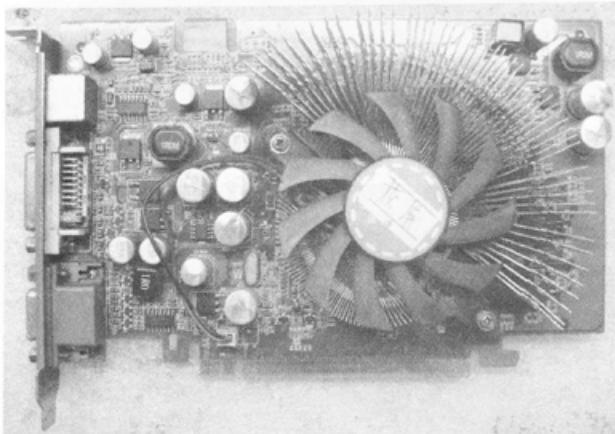


图 5-77 爆电容

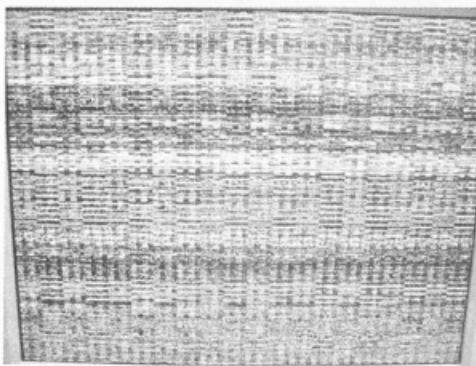


图 5-78 “大花”

(2) 把电容换完，再次测试，没想到依然花屏，只是没那么严重了，还能看清字。于是使用 MATS 测试，如图 5-79 所示。

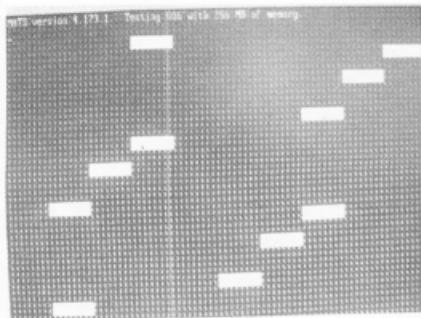


图 5-79 使用 MATS 测试中

(3) 测试结果显示 A20 出错，如图 5-80 所示。

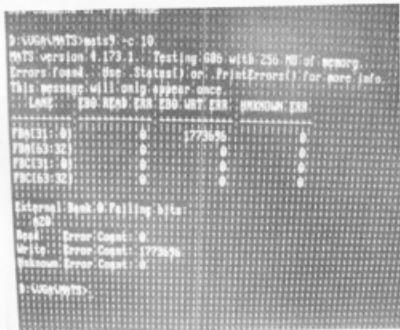


图 5-80 A20 报错

(4) PCI-E 显卡容易发生空焊，那就先给它加焊吧。送到返修台固定起来就开始焊接了，如图 5-81 所示。



图 5-81 固定显卡



(5) 加焊完上机测试，不花屏了，运行 MATS 进行全面测试，如图 5-82 所示。

```
D:\USA\MATS>mats9
MATS version 4.173.1. Testing G86 with 256 MB of memory.
  LANE   EBB READ ERR EBB WRITE ERR UNKNOWN ERR
FBA[31: 0]      0      0      0
FBA[63:32]      0      0      0
FBC[31: 0]      0      0      0
FBC[63:32]      0      0      0

External Bank 0 Failing bits:
  None
  Read   Error Count: 0
  Write  Error Count: 0
  Unknown Error Count: 0

D:\USA\MATS>_
```

图 5-82 测试完毕

(6) 测试完毕，返回的结果真令人开心，没有报错。进入 Windows 系统跑个 3D 游戏也没问题，确认显卡修复。

### 5.2.5 微星 X550 显卡花屏故障

显卡型号：微星 X550 修罗王

故障现象：花屏

故障分析：此 X550 修罗王卡（见图 5-83）为 PCI-E 接口，DDR1 显存颗粒。

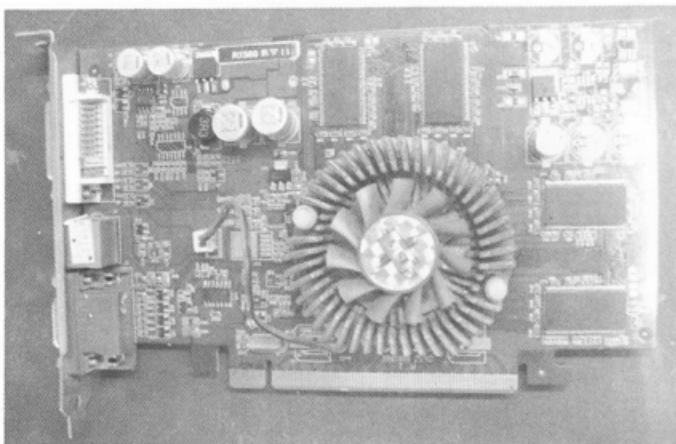


图 5-83 X550 显卡

(1) 开机画面会花屏，如图 5-84 所示。



图 5-84 花屏

(2) 黑白画面不花屏, 如图 5-85 所示。

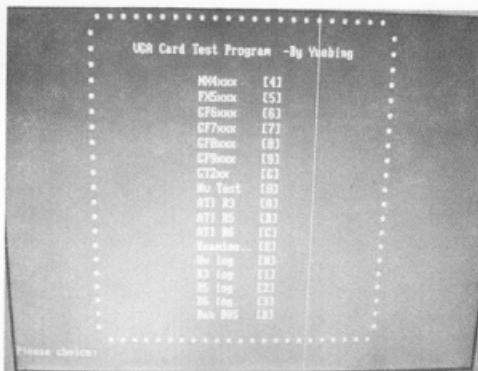


图 5-85 黑白画面不花屏

(3) 在程序选择界面按 A, 使用 R3 测试。首先启动是 R3 1.07 版本, 提示不支持该显卡, 如图 5-86 所示。

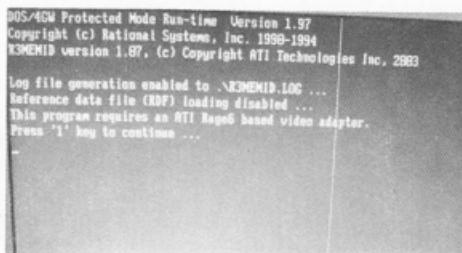


图 5-86 程序不支持



(4) 按 1 继续, 启动下一个版本的 R3memid.exe, 这次可以测试了, 如图 5-87 所示。



图 5-87 测试中

(5) 这个版本是 R3 1.10 版本。测试完后, 显示错误的数据位为 B 通道 40~47, 如图 5-88 所示。

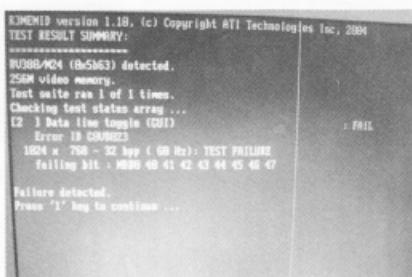


图 5-88 测试 FAIL

(6) 观察 B 通道的电路分布, 有 4 个排阻, 应该是布数据线, 还有两个电阻连着细线, 应该为控制线, 如图 5-89 所示。因为刚才的测试结果显示 B40~B47 有错, 而一般整组出错的一般为控制线故障。

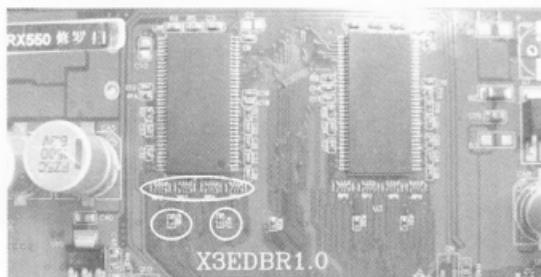


图 5-89 排阻和电阻



(7) 打这两个控制线的值, 左边电阻靠近显存一端值为 413, 如图 5-90 所示。

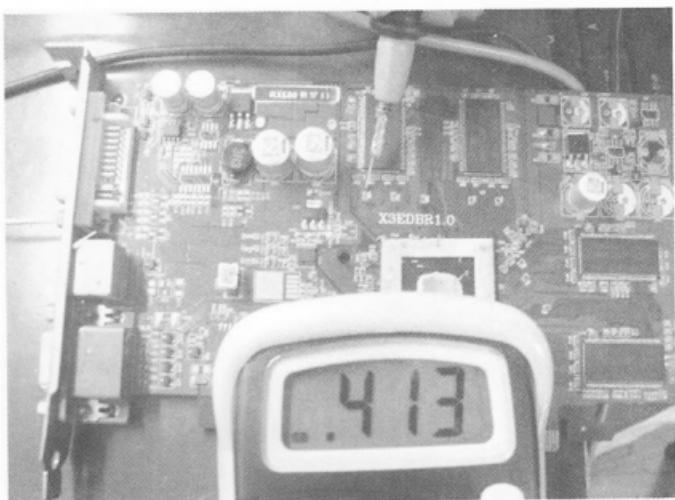


图 5-90 值 413 正常

(8) 右边电阻靠近显存端值为 594, 值偏大, 如图 5-91 所示。

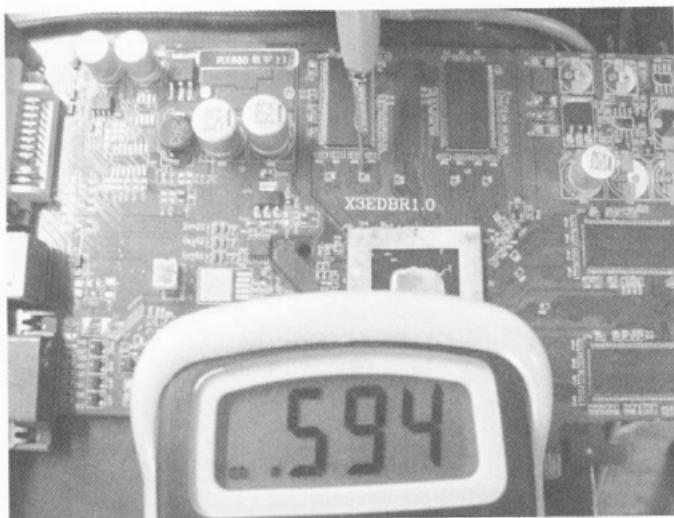


图 5-91 值偏大



(9) 有一个不正常，接着打电阻的靠近 GPU 一端，左边值为 356，如图 5-92 所示。

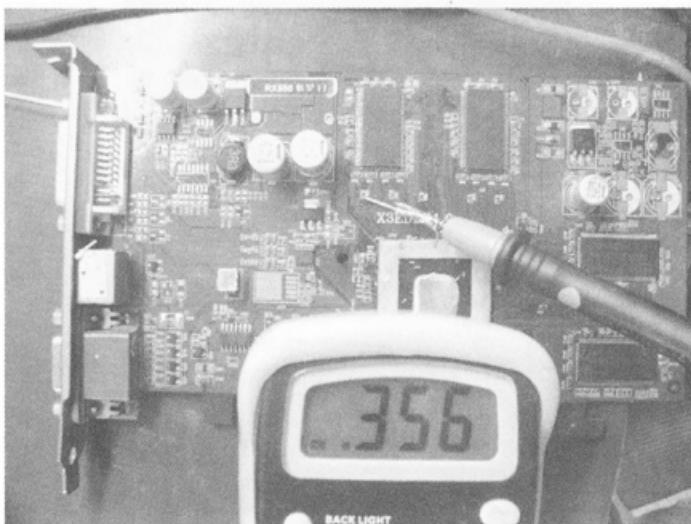


图 5-92 一端值 356

(10) 右边值为 358，如图 5-93 所示。左、右值差不多，表示 GPU 这端没有问题。

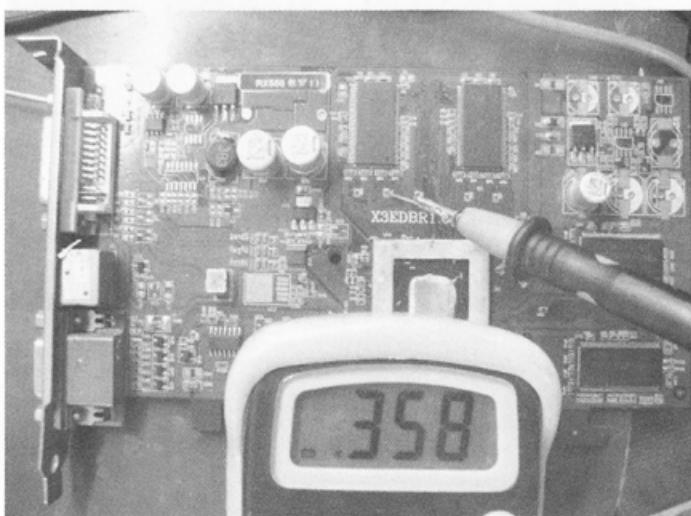


图 5-93 值正常



(11) 由此可以怀疑是电阻问题，量左边的电阻值为  $56\Omega$ ，如图 5-94 所示。

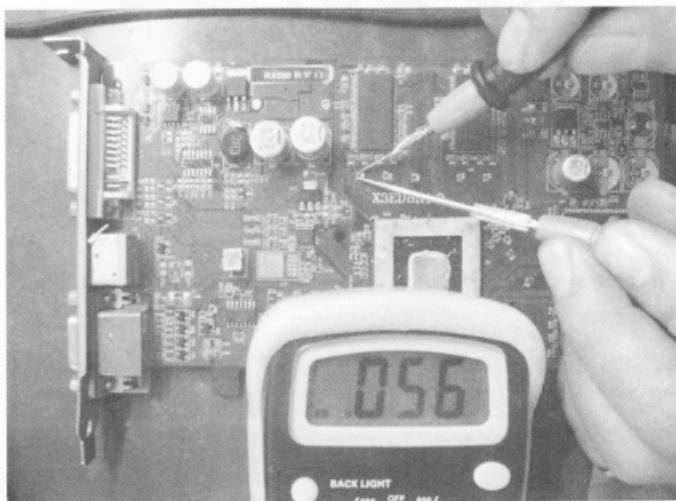


图 5-94 正常电阻  $56\Omega$

(12) 量右边的电阻为  $1130\Omega$ ，如图 5-95 所示。

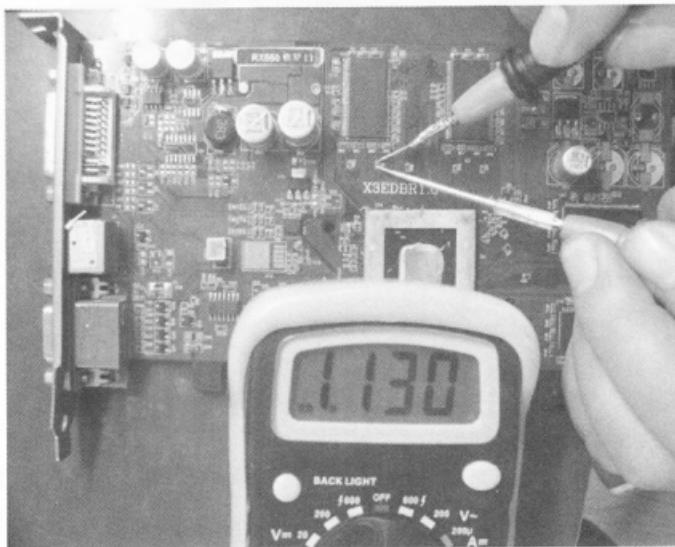


图 5-95 电阻坏了



(13) 判断这个电阻坏了，更换一个后，检测通过，如图 5-96 所示。

```

K3MEM1D version 1.10, (c) Copyright ATI Technologies Inc., 2004
TEST RESULT SUMMARY:
*****
RIVA880/M24 (B563) detected.
256M video memory.
Test suite ran 1 of 1 times.
Checking test status array ...
E2 3 Data line toggle (GLD)
No failures detected.
Press any key to continue.

```

图 5-96 测试通过

### 5.2.6 讯景 7600GT 显卡空焊故障

显卡型号：讯景 7600GT

故障现象：花屏

故障分析：一片讯景 7600GT 显卡（见图 5-97）花屏。

图 5-97 讯景 7600GT 显卡

(1) 上机测试，发现花得不算严重，勉强可以辨认，如图 5-98 所示。

图 5-98 小花



(2) 运行 MATS 测试，结果显示有报错，但看得不太清，如图 5-99 所示。

Mats version 1.40 - This test will take a few minutes.					
LANE	EBO READ	ERR EBO	WRT EBO	ERR EBO	UNKNOWN EBO
I <sub>BGA</sub> (31: 0)	0	0	0	0	0
I <sub>BGA</sub> (63: 32)	0	0	0	0	0
I <sub>BGA</sub> (31: 0)	0	0	0	0	0
I <sub>BGA</sub> (63: 32)	0	1236623	0	123569	0
 External Bank 0 Failing bits:					
C48 C49 C4B C4B C49 C49 C49 C49 C50 C50 C50 C50 C51 C51 C51 C51	0	0	0	0	0
C52 C52 C52 C52 C53 C53 C53 C53 C54 C54 C54 C54 C55 C55 C55 C55	0	0	0	0	0
 External Bank 1 Failing bits:					
C48 C4B C4B C4B C49 C49 C49 C49 C50 C50 C50 C50 C51 C51 C51 C51	0	0	0	0	0
C52 C52 C52 C52 C53 C53 C53 C53 C54 C54 C54 C54 C55 C55 C55 C55	0	0	0	0	0
 Read Error Count: 0					
Write Error Count: 2472321					
Unknown Error Count: 0					
Press any key to continue . . .					

图 5-99 测试结果看不清

(3) 用好的显卡启动，查看清晰的测试结果，显示 C 通道数据位 48~55 出错，如图 5-100 所示。

File Edit Search View Options Help					
D:\UGA\MATS\REPORT.TXT					
LANE	EBO READ	ERR EBO	WRT EBO	ERR EBO	UNKNOWN EBO
I <sub>BGA</sub> (31: 0)	0	0	0	0	0
I <sub>BGA</sub> (63: 32)	0	0	0	0	0
I <sub>BGC</sub> (31: 0)	0	0	0	0	0
I <sub>BGC</sub> (63: 32)	0	1236623	0	123569	0
 External Bank 0 Failing bits:					
C48 C4B C4B C4B C49 C49 C49 C49 C50 C50 C50 C50 C51 C51 C51 C51	0	0	0	0	0
C52 C52 C52 C52 C53 C53 C53 C53 C54 C54 C54 C54 C55 C55 C55 C55	0	0	0	0	0
 External Bank 1 Failing bits:					
C48 C4B C4B C4B C49 C49 C49 C49 C50 C50 C50 C50 C51 C51 C51 C51	0	0	0	0	0
C52 C52 C52 C52 C53 C53 C53 C53 C54 C54 C54 C54 C55 C55 C55 C55	0	0	0	0	0
 Read Error Count: 0					
Write Error Count: 2472321					
Unknown Error Count: 0					
 1:17 FRONT WRITE FRONT READ BACK WRITE BACK READ UNKNOWN					
10A0	219712	0	219712	0	0
[ El-Help ] [ Line 1 ] [ Cell 1 ]					

图 5-100 C 通道报错

(4) PCI-E 显卡 GPU 容易空焊。加焊前先拆除散热片，然后上焊膏。放到 BGA 反修台，调好位置，风嘴对准，温度设定好，如图 5-101 所示。

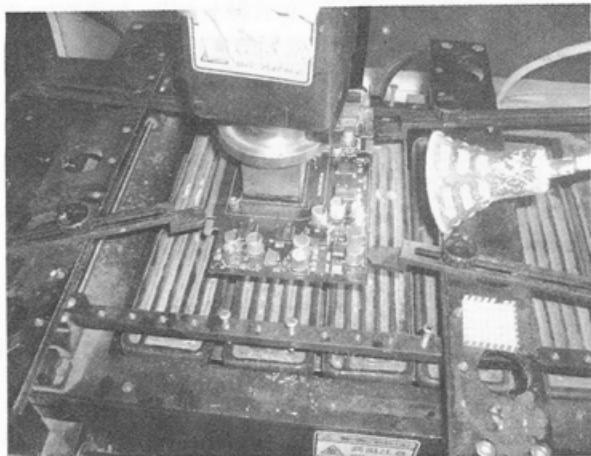


图 5-101 固定显卡

(5) 5 分钟过去，焊接完成，并且程序测试通过，如图 5-102 所示。

LANE	EBO READ ERR	EBO WRT ERR	UNKNOWN ERR
FBA[31: 0]	0	0	0
FBA[63:32]	0	0	0
FBC[31: 0]	0	0	0
FBC[63:32]	0	0	0
 External Bank 0 Failing bits:			
None			
Read Error Count: 0			
Write Error Count: 0			
Unknown Error Count: 0			
D:\UGA\WATS>_			

图 5-102 测试通过

总结：PCI-E 显卡空焊的问题太严重了。在显卡工作条件和基本信号都正常的情况下，如果能保证焊接成功率，可以优先加焊 GPU。